

集成电路型号速查手册

许振江 张立新 主编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

集成电路型号速查手册 / 许振江, 张立新主编. —北京:
人民邮电出版社, 2008.5
ISBN 978-7-115-17455-0

I. 集… II. ①许…②张… III. 集成电路—型号—手册
IV. TN4-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 000476 号

集成电路型号速查手册

- ◆ 主 编 许振江 张立新
责任编辑 张兆晋
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京艺辉印刷有限公司印刷
新华书店总店北京发行所经销
- ◆ 开本: 850×1168 1/32
印张: 11.875
字数: 356 千字 2008 年 5 月第 1 版
印数: 1—5 000 册 2008 年 5 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-17455-0/TN

定价: 25.00 元

读者服务热线: (010)67129258 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

内 容 提 要

本书收集了约 200 家国外主要集成电路生产厂商的集成电路命名方法，给出了各厂家的英文、中文名称，网址和商标标志及器件命名规则，读者可根据集成电路的型号对其性能、用途进行初步识别。本书附录收集了集成电路引脚功能及电路英文常用缩写词约 3000 条。

本书内容新颖，资料丰富，可供广大集成电路使用、采购和销售人员进行参考使用。

前 言

随着微电子技术的飞速发展和产品价格的快速下降，集成电路的应用已遍及电子技术的各个领域，电子技术人员几乎每天都要和集成电路打交道，因此如何快速识别集成电路就显得尤为重要。由于集成电路的型号中包含了诸如生产厂商、芯片类型、封装形式、使用温度等重要信息，所以通过芯片型号就可对集成电路的性能、用途进行初步识别。但由于集成电路的生产厂商众多，集成电路型号多达几十万种，并且其数量每天都在快速增加，而各厂家对自己生产的芯片型号命名方法又自成体系，互不相同，相关资料也很难查找，无论是集成电路的使用者还是销售、采购人员都深感不便。

为了解决这个问题，本书收集了国外约 200 家主要集成电路生产厂商的集成电路命名方法，以为广大集成电路使用、采购和销售带来一定的方便。此外，本书还在附录中收集了集成电路引脚功能及电路英文常用缩写词约 3000 条，可供广大集成电路使用人员参考。

由于编者水平有限，加之集成电路生产厂商合并重组频繁，资料收集困难，因此书中一定存在错误和疏漏之处，还望广大读者、专家批评指正。

编 者

目 录

国外集成电路生产厂商及器件命名方法.....	1
Actel Corporation(Actel)	
阿卡特公司（美）	1
Advanced Micro Devices, Inc.(AMD)	
超威半导体公司（美）	2
Advanced Analogic Technologies Inc. (AnalogTech)	
研诺逻辑科技有限公司（美）	8
Advanced Linear Devices,Inc(ALD)	
高级线性电子器件公司（美）	9
Advanced Electronic Packing	
高级电子封装公司（美）	10
Altera Corporation(Altera)	
奥特莱公司（美）	11
American Microsystems Inc.(AMI)	
美国微系统公司（美）	12
AMI Semiconductor(AMIS)	
AMI 半导体公司（美）	12
Amperex Electronic Corp.	
安普雷斯电子公司（美）	12
Amptex Inc.	
安弗泰克斯公司（美）	13
Analog Device,Inc. (ADI)	
模拟器件公司（美）	13

ANADIGICS,Inc(ANADIGICS)	
爱奈狄克公司 (美)	15
Analogue Systems	
模拟系统公司 (美)	16
Apex Microtechnology Corporation(Apex)	
顶点微技术公司 (美)	17
AT&T	
AT&T 公司 (美)	18
Atmel Corporation(ATMEL)	
爱特梅尔公司 (美)	19
Bel Fuse,Inc.(Bel)	
贝尔保险丝公司 (美)	20
Bharat Electronics Ltd.(BEL)	
伯哈特电子有限责任公司 (印)	20
Bipolar Integrated Technology(Bipolar)	
双极集成技术公司 (美)	21
Brooktree Corporation(Brooktree)	
溪树公司 (美)	21
Burr-Brown Corporation(Burr-Brown)	
伯尔-布朗公司 (美)	23
California Micro Devices Corp. (CMD)	
加利福尼亚微器件公司 (美)	26
Calmos Semiconductor,Inc.(Calmos)	
加利福尼亚 MOS 半导体公司 (美)	27
Catalyst Semiconductor, Inc.(Catalyst)	
凯特利斯特半导体公司 (美)	28
Cherry Semiconductor Corporation(Cherry)	
齐瑞半导体公司 (美)	29
Comlinear Corporation(CLC)	
共线性器件公司 (美)	30

Conexant Systems, Inc.	
科胜讯系统公司.....	30
Cirrus Logic Inc.(Cirrus)	
凌云逻辑公司（美）.....	30
CML Microcircuits(USA) Inc(CML)	
CML 微电路公司（美）.....	31
Crystal Semiconductor(Crystal)	
克瑞斯涛半导体公司（美）.....	32
CTS Corporation(CTS)	
CTS 公司（美）.....	33
Custom Micro Systems,Inc.	
克斯特姆微系统公司（美）.....	33
Cybernetic Micro System(Cybernetic)	
西伯奈蒂克微系统公司（美）.....	34
Cypress Semiconductors(Cypress)	
赛普拉斯半导体公司（美）.....	34
Dallas Semiconductor(Dallas)	
达拉斯半导体公司（美）.....	35
Datel, Inc.(Datel)	
丹特电子公司（美）.....	37
Delco Electronics,Inc.(Delco)	
德科电子公司（美）.....	39
DPAC Technologies Corp.(DPAC)	
DPAC 技术公司（美）.....	39
EG&G Reticon Corp.	
EG&G 雷狄康公司（美）.....	42
Elantec Semiconductor(Elantec)	
依兰泰克半导体公司（美）.....	43
Electronic Arrays,Inc.	
电子阵列公司（美）.....	45

Ericsson Components AB (Ericsson)	
爱立信元件公司 (瑞典)	46
Exar Integrated Systems, Inc(Exar)	
埃克萨集成系统公司	47
EXEL Microelectronics Inc. (EXEL)	
爱克西尔微电子有限公司 (美)	48
Fairchild Semiconductor Corp.(Fairchild)	
飞兆半导体公司 (美)	49
Freescale Semiconductor, Inc	
飞思卡尔半导体公司	52
Fujitsu Components America, Inc(Fujitsu)	
富士通元件美国公司 (美)	52
Fujitsu Limited(Fujitsu)	
富士通有限公司 (日)	53
Fujitsu Microelectronics, Inc.(Fujitsu)	
富士通微电子有限公司 (美)	54
F.W.Bell	
F.W.贝尔公司 (美)	57
GE SOLID STATE (GE)	
通用电气固态公司 (美)	57
GE Intersil, Inc.(GE)	
通用电气英特矽尔公司 (美)	59
General Instrument Corporation(GI)	
通用仪器公司 (美)	61
General Instrument Microelectronics (GI)	
通用仪器微电子有限公司 (美)	65
Gennum Corporation(Gennum)	
智勒姆公司 (加)	66
GigaBit Logic, Inc. (GBL)	
吉盖比特逻辑公司 (美)	67

Goldstar Semiconductor(Goldstar)	
金星半导体公司 (韩)	68
Gould Semiconductor Division(Gould)	
古尔德半导体分部 (美)	69
Grant Technology Systems	
格雷特技术系统公司 (美)	70
GTE Microcircuits Div. (GTE)	
GTE 微电路公司 (美)	70
Harris Semiconductor(Harris)	
哈里斯半导体公司 (美)	71
Harris Microwave Semiconductor(Harris)	
哈里斯微波半导体公司 (美)	73
Hitachi Ltd. (Hitachi)	
日立公司半导体事业部 (日)	74
Honeywell,Inc.(Honeywell)	
霍尼韦尔公司 (美)	75
Hughes Aircraft Company(Hughes)	
休斯飞机公司 (美)	77
Hybrid System Corp.	
混合系统公司 (美)	78
Hybrid Memory Products Limited	
混合存储器有限公司 (英)	79
Hynix Semiconductor Inc.(Hynix)	
海力士半导体公司 (韩)	79
Data Device Corp.(DDC)	
数据器件公司 (美)	80
Industria Mexicana Toshiba S.A.(Toshiba)	
东芝墨西哥工业公司 (墨西哥)	82
Inmos Corp.(Inmos)	
英莫斯公司 (英)	83

Inova Microelectronics Corp.(Inova)	
奥沃微电子公司 (美)	84
Integrated Device Technology(IDT)	
IDT 公司 (美)	85
Intel Corp.(Intel)	
英特尔公司 (美)	86
International CMOS Technology.Inc. (ICT)	
国际 CMOS 技术公司 (美)	87
International Microcircuits, Inc. (IMI)	
国际微电路公司 (美)	88
International Rectifier(IR)	
IR 公司 (美)	89
Intersil Corporation(Intersil)	
英特矽尔公司 (美)	90
IXYS Corp.(IXYS)	
IXYS 公司 (美)	92
JAN Nomenclature(JNC)	
JAN 术语公司 (美)	93
Lansdale Semiconductor, Inc. (Lansdale)	
兰斯达勒公司 (美)	94
Lambda Americas, Inc.(Lambda)	
兰姆达美国 (美)	95
Lattice Semiconductor Corp.(Lattice)	
莱迪思半导体公司 (美)	96
LG Electronics(LG)	
LG 电子公司 (韩)	97
Linear Technology Corporation(Linear)	
凌力尔特公司 (美)	97
Logic Devices Inc.	
逻辑器件公司 (美)	98

LSI Logic Corporation(LSI)	
LSI 公司 (美)	99
Marconi Electronic Devices,Inc.(Marconi)	
马可尼电子器件公司 (美)	100
Matra-Harris Semiconductor SA(MHS)	
麦特莱-哈里斯半导体公司 (法)	101
Master Logic	
马斯特逻辑公司 (美)	106
Matsushita Electronic Industrial Co.Ltd. (Panasonic)	
松下电器产业株式会社 (日)	107
Maxim Integrated Products ,Inc.(Maxim)	
美信集成产品公司 (美)	107
MCE Semiconductor, Inc.(MCE)	
MCE 半导体公司 (美)	112
Micrel Semiconductor, Inc.(Micrel)	
麦瑞半导体公司 (美)	112
Micra Corp.	
密克莱公司 (美)	113
Micro Linear Corp.(Micro-Linear)	
微线性器件公司 (美)	113
Micro Networks Corp.(MNC)	
微网络公司 (美)	114
Micropac Micropac Industries,Inc. (MICROPAC)	
微派斯工业公司 (美)	115
Micro Power Systems, Inc.	
微型电源系统公司 (美)	116
Micron Technology,Inc. (Micron)	
美光科技公司 (美)	116
Mikro Elektronik	
米克罗电子公司 (德)	117

Mitel Semiconductor(Mitel)	
敏迪半导体公司 (加)	118
Mitsubishi Electric Corp.(Mitsubishi)	
三菱公司 (日)	119
Mitsubishi Mitsubishi Electric America,Inc.(Mitsubishi)	
美国三菱电子公司 (美)	121
Monolithic Memories Inc.(MMI)	
单片存储器公司 (美)	122
Mosel Vitelic Corp.(MVC)	
茂矽电子公司 (美)	125
Motorola Semiconductor Products,Inc.(Motorola)	
摩托罗拉公司半导体部 (美)	127
Mostek	
莫斯泰克公司 (美)	129
Mullard Ltd.(Mullard)	
大盾公司 (英)	130
MX-COM,Inc.(MX-COM)	
MX-COM 公司 (美)	131
National Semiconductor (NS)	
国家半导体公司 (美)	132
NCM Corporation(NCM)	
NCM 公司 (日)	139
NCR Corporation(NCR)	
NCR 公司 (美)	140
NEC Corporation(NEC)	
NEC 公司 (日)	141
NEC Electronics,Inc. (NEC)	
NEC 电子公司 (美)	142
NMB Technologies corporation(NMB)	
NMB 技术公司 (日)	144

New Japan Radio Co., Ltd.(JRC)	
新日本无线株式会社 (日)	145
Oki Electric Industry Co., Ltd.	
日本冲电气电子株式会社 (日)	145
Nortec Communications, Inc.(Nortec)	
诺泰克公司 (美)	146
Omnirel Corp.(Omnirel)	
欧涅莱公司 (美)	147
Optical Electronics,Inc.(OEI)	
光电公司 (美)	148
Panasonic Industrial Company(Panasonic)	
松下工业公司 (美)	149
Performance Semiconductor Corporation(Performance)	
弗尔曼斯半导体公司 (美)	150
Philips Components(Philips)	
菲利普公司 (荷)	151
Plessy Semiconductors Ltd. (Plessy)	
普莱赛半导体公司 (英)	152
Precision Monolithics,Inc. (PMI)	
精密单片公司 (美)	155
Pro Electron	
欧洲电子联盟.....	156
Raytheon Company(Raytheon)	
雷神公司 (美)	158
Renesas Technology Corp.(Renesas)	
瑞萨科技公司 (日)	160
RS Components Ltd.(RS)	
RS 器件公司 (英)	160
RCA Corp.Sold State Div.(RCA)	
RCA 公司固态电路分部 (美)	161

Ricoh Co.,Ltd. (Ricoh)	
理光公司（日）	162
Ricoh Corporation	
理光公司电子器件分部（美）	162
Rockwell International Corp.(Rockwell)	
罗克威尔公司半导体部（美）	163
Rohm Co.Ltd.(Rohm)	
罗姆公司（日）	164
Samaung Semiconductor,Inc.(Samaung)	
三星半导体公司（韩）	165
SANYO Electric Co.,Ltd(Sanyo Electric Co.,Ltd)	
三洋电机公司（日）	167
Saratoga Semiconductor(Saratoga)	
赛伦半导体公司（美）	168
SEEQ Technology(SEEQ)	
SEEQ 技术公司（美）	169
Sensym ICT(Sensym)	
赛西姆公司（美）	170
SGS-ATES Component Electronic SpA (SGS-ATES)	
SGS-亚特斯电子元件公司（意大利）	170
SGS-Thomson Microelectronics (SGS-Thomson)	
SGS-汤姆逊公司（意、法）	172
Sharp Electronics Corporation of American (SHARP)	
美国夏普电子公司（美）	176
Siemens Aktiengesellschaft (Siemens)	
西门子公司（德）	177
Simens Corp.(Simens)	
美国西门子公司（美）	179
Sierra Semiconductor Corp.(Sierra)	
西雷半导体公司（美）	180

Signetics Corp.	
西格尼蒂克公司 (美)	180
Silicon Systems,Inc.	
硅系统公司 (美)	182
Silicon MicroSystems Inc.	
硅微系统公司 (美)	184
Siliconix,Inc.(Siliconix)	
硅尼克斯公司 (美)	185
Solid State Devices,Inc(SSDI)	
固态器件公司 (美)	186
Solitron Devices,Inc. (Solitron)	
索列特朗公司 (美)	187
S-MOS Systems Inc.(S-MOS)	
S-MOS 系统公司 (美)	188
Sony Corp.(Sony)	
索尼公司 (日)	189
Sorep SA(Sorep)	
索莱弗-赛公司 (法)	190
Space Reaearch Technology	
空间研究技术公司 (美)	190
Sprague Electric Co.(Sprague)	
美国史普拉格电子公司	191
Sprague Semiconductor Group(Sprague)	
史普拉格半导体集团 (美)	193
STMicroelectronics N.V.(ST)	
意法半导体 (意、法)	195
Standard Microsystems Corporation(SMSC)	
标准微系统公司 (美)	196
Stantel Components, Inc.	
斯坦泰尔器件公司 (美)	196

Synertek System Corp.(Synertek)	
辛纳泰克系统公司（美）	197
Supertex,Inc. (Supertex)	
超科公司（美）	198
Teledyne Semiconductor Corp. (Teledyne)	
德律戴恩半导体公司（美）	199
Telefunken Electronic GmbH(Telefunken)	
特洛芬肯电子公司（德）	201
Teledyne Philbrick(Teledyne)	
德律戴恩菲尔布里克公司（美）	202
Teltone Corporation(Teltone)	
泰尔通公司（美）	202
Texas Instruments, nc.(TI)	
得州仪器公司（美）	203
Texas Instruments Ltd.(TI)	
得州仪器有限责任公司（英）	210
Thaler Corporation(Thaler)	
萨勒公司（美）	212
Third Domain,Inc.	
第三产业公司（美）	213
Thomson CSF	
汤姆逊半导体公司（法）	213
Toko America,Inc.(Toko)	
Toko 美国有限公司（美）	217
Topaz Semiconductor Inc.(Topaz)	
黄晶半导体公司（美）	217
Toshiba America,Inc.(Toshiba)	
东芝美国有限公司（美）	218
Toshiba Corp.(Toshiba)	
东芝公司（日）	220

Toyocom USA,Inc. (Toyocom)	
美国东洋通信机美国有限公司 (美)	222
TRW LSI Products, Inc.(TRW)	
TRW 大规模集成电路产品公司 (美)	223
United Technologies Microelectronics Center(UTMC)	
微电子技术联合中心 (美)	225
Unitrode Corp.(Unitrode)	
尤尼罗德公司 (美)	226
Valvo GmbH(Valvo)	
沃奥格姆巴公司 (德)	227
Vitesse Semiconductor Corporation(Vitesse)	
威泰斯半导体公司 (美)	227
VLSI Technology,Inc.(VLSI)	
VLSI 技术公司 (美)	228
VTC Incorporated(VTC)	
VTC 公司 (美)	229
Walmsley Microsystems Ltd.(WML)	
沃姆斯莱微系统公司 (英)	230
Waferscale Integated,Inc. (WSI)	
晶片集成电路公司 (美)	230
Weitek Corp.(Weitek)	
威泰克公司 (美)	231
Western Design Center(WDC)	
西方设计中心 (美)	232
Western Digital Corp.(WD)	
西部数据公司 (美)	233
White Electronic Designs Corporation(WEDC)	
怀特电子设计公司 (美)	233
White Microelectronics	
怀特微电子公司 (美)	236

Xicor,Inc. (Xicor)	
辛卡公司 (美)	237
Zilog,Inc. (ZiLOG)	
齐洛格公司 (美)	238
Zyrel,Inc.(Zyrel)	
西奈尔公司 (美)	239
附录 集成电路引脚功能及电路常用英文缩写词汇编	241

国外集成电路生产厂商及器件命名方法

每个集成电路生产厂商都有自己独特的集成电路型号命名方法，但一般集成电路的型号基本上由三大部分组成，即前缀、器件标号和后缀，每部分又可细分，分别用来表示集成电路的功能、使用温度范围、封装形式等。使用者通过器件型号可大致了解集成电路的功能等信息。本部分收集了约 200 家国外集成电路生产厂商的器件命名方法，并按厂商名称的英文字母顺序排列，它们均为知名度较高、市场占有率高、规模较大的厂商。文中分别给出了厂家的中文名称、网址和商标标识及器件命名方法。为方便读者使用，对标识因种种原因发生变化者，均尽量给出了原用和现用标识。

Actel Corporation(Actel)

阿卡特公司（美）

<http://www.actel.com>



该公司产品型号由 6 部分组成，例如：

M7AFS600 **-1** **FG** **G** **256** **I**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 器件标号，表示器件功能。

② 速度等级：

F 比标准速度慢 20%

空 标准

1 比标准速度快 15%

2 比标准速度快 20%

③ 封装形式：

QN 四方扁平无引脚封装

PQ 塑料四方扁平封装

FG 微间距球栅阵列

④ 无铅封装选项:

空 标准封装

G 无铅封装

⑤ 引脚数。

⑥ 使用温度范围:

空 商业级 (0~+70℃)

I 工业级 (-40~+85℃)

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

超威半导体公司 (美)

<http://www.amd.com.cn>



该公司的产品有 5 类命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 7 部分组成, 例如:

AM 29 L 509 P C B
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商。

② 表示芯片的电路功能或类别:

21	MOS 存储器
25	中规模集成电路
26	计算机接口
27	双极型存储器和 EPROM
28	MOS 存储器
29	双极型微处理器
57、74	中规模集成电路
60、61、66	双极型模拟电路
79	通信电路
80	MOS 微处理器

81、82	MOS 和双极型外设电路
90、92、94	MOS 电路
91	MOS RAM 电路
93	双极型逻辑电路, 存储器
95	MOS 外设电路
98	EEPROM
99	CMOS 存储器
104、1004	ECL 存储器

③ 表示芯片系列:

B	标准系列
C	CMOS 系列
L	低功耗系列
LS	低功耗肖特基系列
S	肖特基电路系列

④ 器件标号。

⑤ 封装形式:

P	塑料 DIP, 膜状 DIP
D	陶瓷 DIP, 陶瓷膜状 DIP
J	引脚芯片载体封装
L	无引脚芯片载体封装
G	引脚栅格排列封装
W	陶瓷封装
F	扁平封装
S	小间距外引脚封装

⑥ 使用温度范围:

C	商业级 (10~-70℃)
I	工业级 (-40~+85℃)
L	扩展使用 (-55~+100℃或-30~+85℃)
M、E	军品级 (-55~+125℃)

⑦ 筛选方法:

空 标准筛选方法

B 老化

2. 第2类产品型号命名规则

该类产品型号由9部分组成，例如：

6 **3** **S** **32** **8** **1** **A** **N** **STD**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

各部分字母和数字含义如下。

① 使用温度范围：

6 商业级（0~+70℃）

5 军品级（-55~+125℃）

② 表示芯片功能类别：

3 PROM

③ 表示芯片系列：

S 肖特基系列

RA 非同步寄存器系列

RS 同步寄存器系列

D 诊断程序系列

DA 非同步诊断程序系列

④ 表示存储器容量：

0 256bit

1 1024bit

2 2048bit

4 4096bit

8 8192bit

16 16384bit

32 32768bit

64 65536bit

⑤ 表示输出端数。

⑥ 表示输出形式：

0 集电极开路输出

- 1 三态输出
- 2 三态（交替方式）输出
- 3 双态输出
- 5 交替输出
- ⑦ 表示芯片性能：
 - 空 标准型
 - A 改进型
- ⑧ 封装形式：
 - N 塑料 DIP
 - NS 塑料膜 DIP
 - J 陶瓷 DIP
 - JS 陶瓷膜 DIP
 - Q 窗口式 DIP
 - QS 窗口膜式 DIP
 - NL 引脚芯片载体封装
 - FN 有引脚芯片载体塑封
- ⑨ 筛选方法：
 - STD 采用标准筛选方法
 - ×××× 其他方法

3. 第3类产品型号命名规则

该类产品型号由5部分组成，例如：

67 **C** **4033** - **15** **NL**
 ① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 使用温度范围：
 - 67 商业级（0~+70℃）
 - 57 军品级（-55~+125℃）
- ② 表示工艺类别：
 - C CMOS
 - L 低功耗

空 双极型

③ 器件标号。

④ 表示最大存取时间：

10 100 ns

15 150 ns

⑤ 封装形式：

N 塑料 DIP

NS 塑料膜 DIP

J 陶瓷 DIP

JS 陶瓷膜 DIP

Q 窗口式 DIP

QS 窗口膜式 DIP

NL 引脚芯片载体封装

FN 有引脚芯片载体塑封

4. 第 4 类产品型号命名规则

该类产品型号由 9 部分组成，例如：

PAL **16** **L** **8** **B** - **2** **C** **N** **STD**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片系列：

PAL 可编程序逻辑阵列

HAL 硬逻辑阵列

ZHAL 零功耗硬逻辑阵列

10HPAL ECL 10KH 阵列

② 表示阵列输入端数。

③ 表示输出单元状态：

L 低有效

H 高有效

C 互补

P 可编程序极性

- RP 寄存器可编程序极性
- S 共享
- RS 寄存器可编程序极性
- X 异或
- A 算术
- VX 可变异或
- RA 非同步寄存器
- RX 带异或的寄存器
- ④ 表示输出端数。
- ⑤ 表示芯片速度：
 - 空 标准速度
 - A 高速
 - B 甚高速
 - D 超高速
- ⑥ 表示芯片功耗：
 - 空 标准功耗
 - 2 1/2 功耗
 - 4 1/4 功耗
- ⑦ 使用温度范围：
 - G 商业级 (0~+70℃)
 - I 工业级 (-40~+85℃)
 - M 军品级 (-55~+125℃)
- ⑧ 封装形式：
 - N 塑料 DIP
 - NS 塑料膜 DIP
 - J 陶瓷 DIP
 - JS 陶瓷膜 DIP
 - Q 窗口式 DIP
 - QS 窗口膜式 DIP
 - NL 引脚芯片载体封装

FN 有引脚芯片载体塑封

⑨ 筛选方法:

STD 采用标准筛选方法

×××× 高可靠性筛选

5. 第 5 类产品型号命名规则

该类产品型号由 7 部分组成, 例如:

PAL **C** **20** **R** **8** **Z** - **35**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

① 可编程序逻辑阵列。

② 表示工艺类别:

C CMOS

空 双极型

③ 表示输入端数。

④ 表示输出类型:

P 可编程

R 寄存器

⑤ 表示输出端数。

⑥ 表示芯片功耗:

Z 零功耗

H 1/2 功耗

Q 1/4 功耗

空 全功耗

⑦ 表示最大传输延迟时间 (单位为 ns)

Advanced Analogic Technologies Inc. (AnalogTech)

研诺逻辑科技有限公司 (美)

<http://www.analogictech.com>

该公司的产品型号由 4 部分组成,

例如:



DAC 390 J R

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 器件标号。

③ 使用温度范围：

J 0~70℃

K 0~70℃

S -55~125℃

T -55~125℃

④ 筛选方法：

B 军品级筛选方法

Advanced Linear Devices, Inc (ALD)

高级线性电子器件公司（美）

<http://www.aldinc.com>



该公司的产品型号由 4 部分组成，例如：

ALD 555 P A

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 器件标号。

③ 封装形式：

P 塑料 DIP

C 边铜焊陶瓷封装

Z 芯片小方块包封

L 无引脚芯片载体封装

S 小尺寸引脚封装

M 带金属翼 TO 型外壳封装

④ 表示外引脚数：

A	8
B	14
C	16
D	18
E	20
F	22
G	24
H	28
I	36
J	40
K	44
L	48
M	64
N	68

Advanced Electronic Packing

高级电子封装公司（美）

该公司的产品型号由 9 部分组成，例如：

AED **S** **S** **512K** **8** **A** **1** - **12H** - **HC**
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 表示芯片电路类别：

S SRAM

D DRAM

B 缓冲器

R 调节器

T 收发机

③ 封装形式：

S 垂直 SIP

- H 水平 SIP
- Z 分支交叉直插式封装
- ④ 表示存储器容量：
 - K 千字节
 - M 兆字节
- ⑤ 比特数/字。
- ⑥ 基片标志。
- ⑦ 基片变化标志。
- ⑧ 表示提货时间。
- ⑨ 附加说明。

Altera Corporation(Altera)

奥特莱公司(美)

<http://www.altera.com>



该公司的产品型号由 6 部分组成，例如：

ED **1210** **D** **I** **2** **883B**
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 封装形式：
 - D 陶瓷 DIP
 - P 塑料 DIP
 - J 陶瓷 J-引脚芯片载体封装
 - L 引脚芯片载体塑料封装
 - G 引脚阵列排列陶瓷封装
- ④ 使用温度范围：
 - C 商业级 (0~+70℃)
 - I 工业级 (-40~+85℃)
 - M 军品级 (-55~+125℃)

⑤ 表示芯片速度。

⑥ 表示筛选等级：

空 标准工艺

B 老化筛选

883B 按 MIL-STD-883 修正 C、B 级标准筛选

American Microsystems Inc. (AMI)

美国微系统公司 (美)



由于所有权变更, American Microsystems Inc. (美国微系统公司) 已改名为 AMI Semiconductor (AMI 半导体公司)。请参见 AMI Semiconductor。

AMI Semiconductor (AMIS)

AMI 半导体公司 (美)

<http://www.amis.com>



该公司的产品型号由 4 部分组成,例如:

S 6821 A-1 P

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商。

② 4 位或 5 位数, 器件标号。

③ 表示改进型。

④ 封装形式:

P 塑料封装

E 陶瓷 DIP

C 陶瓷封装 (3 层)

T TO 型外壳封装

Amperex Electronic Corp.

安普雷斯电子公司 (美)

该公司产品型号由 2 部分组成, 例如:

BCV 61

- ① ②

各部分字母和数字含义如下。

- ① 表示芯片的电路功能或类别：

BCV 晶体管阵列

LTA 放大器

OM 放大器

TCA 放大器

TAA 放大器

BCV 放大器

- ② 器件标号。

Amptex Inc.

安弗泰克斯公司（美）

该公司产品型号由 3 部分组成，例如：

A 250 RH

- ① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① A 或 D，前缀，表示生产厂商。

- ② 器件标号。

- ③ 筛选方法：

空 MIL-STD-883B 标准

RH MIL-STD-883B 辐射加固标准

Analog Device, Inc. (ADI)

模拟器件公司（美）

<http://www.analog.com>



该公司的产品型号由 6 部分组成，例如：

AD 536 A S D / 883B

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示功能系列：

AD	模拟器件
HA	混合模数转换器
HD	混合数模转换器
AG	变换器
HOS	放大器
ADSP	数字信号处理器

② 器件标号。

③ 附加说明：

A	改进型
DI	介质隔离
Z	工作电压 $\pm 12V$

④ 使用温度范围：

I、J、K、L、M	商业级（ $0\sim 70^{\circ}C$ ）
A、B、C	工业级（ $-25\sim +85^{\circ}C$ ）
S、T、V	军品级（ $-55\sim +125^{\circ}C$ ）

⑤ 封装形式：

D	陶瓷或金属气密性 DIP
E	无引脚芯片载体封装
F	陶瓷扁平封装
H	金属壳气密性密封
M	金属壳气密性密封 DIP
N	塑料 DIP
Q	陶瓷 DIP
R	小间距外引脚封装
P	无引脚芯片载体塑料封装
GHIPS	单片封装

⑥ 筛选等级

空 标准产品按 MIL-STD-883 标准筛选

- 883B 按 MIL-STD-883D 标准筛选
883 按 MIL-STD-883-500B 标准筛选

ANADIGICS, Inc (ANADIGICS)

爱奈狄克公司 (美)

<http://www.anadigics.com>



该公司产品型号由 4 部分组成，例如：

ADA **25001** **F1** **M**
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 芯片系列前缀，表示芯片的电路功能或类别：

ADA	直流放大器
AOP	单位增益运放
ADV	微波分频器
AWA	宽波段 MMIC 放大器
ASH	取样-保持电路
ACD	比较器
AAD	模数转换器
AWM	宽带混频器
AMX	多路调制器
ADX	多路解调器

② 器件标号：

25001	2.5GHz
1510X	150MHz (单位增益稳定)
304X	3.0GHz (最大特性)

③ 封装形式：

F1	8 条外引脚扁平封装
F2	8 条外引脚扁平 (18GHz) 封装
J3	16 条外引脚 DIP
D1	芯片小方块包封

CI 16 端无引脚芯片载体 (40 密耳*) 封装

CC 老化封装

④ 使用温度范围和筛选方法

空或 D 标准法筛选

B 商业级 (0~+70℃), 民品规则筛选并老化

C 商业级 (0~+70℃), 民品规则筛选

I 工业级 (-20~+85℃), 民品规则筛选

N 工业级 (-20~+85℃), 民品规则筛选并老化

D 工业级 (-20~+85℃), 按军品筛选

E 军品级 (-55~+125℃), 民品筛选

R 军品级 (-55~+125℃), 民品筛选并老化

M 军品级 (-55~+125℃), 军品筛选

J 军品级 (-55~+125℃), 按 JAN 质量标准筛选

Analogue Systems

模拟系统公司 (美)

<http://www.analoguesystems.co.uk>

该公司产品型号由 5 部分组成, 例如:

M **A** **374** **C** **P**

① ② ③ ④ ⑤



各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商。

② 芯片系列, 表示芯片的电路功能或类别:

A 放大器、运算放大器

K 比较器

S 传感器电路

V 电压转换器

Z 电流放大器

* 1 密耳=0.0254mm

D 数字电路

- ③ 器件标号。
- ④ 使用温度范围：
 - C 商业级 (0~+70℃)
 - I 工业级 (-25~+85℃)
 - M 军品级 (-56~+125℃)
- ⑤ 封装形式：
 - P 塑料 DIP
 - C 无引脚陶瓷芯片载体封装
 - D 陶瓷 DIP (密封)
 - H 金属壳 (密封) 封装
 - S 外引脚小间距 DIP

Apex Microtechnology Corporation (Apex)

顶点微技术公司 (美)

<http://www.apexmicrotech.com>



该公司现已并入凌云逻辑公司 (Cirrus Logic Inc.)，其产品型号由 4 部分组成，例如：

WA 01 A - 11

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示产品系列：
 - WA 宽波段放大器
 - PA 功率运放
- ② 器件标号。
- ③ 筛选方法：
 - A 电筛选
 - M 军品级筛选
 - Q 工业筛选
- ④ 表示特殊加工。

AT&T

AT&T 公司 (美)

1996 年, AT&T 公司被分拆为 3 个公司, 其中从事设备制造业务的部门重组为朗讯公司 (Lucent Technologies Inc.)。AT&T 的产品有 2 类命名规则。



1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成, 例如:

M **79018** **DX** **15**
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 封装形式:

DX 引脚芯片载体封装

PX DIP 封装

- ④ 表示最大取数时间, 单位 ns。

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 6 部分组成, 例如:

L **B** **R** **051** **A** **B**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

- ① 表示芯片的电路功能和类别

L 线性电路

T 通信电路

- ② 表示工艺类别:

B 互补双极型集成电路 (CBIC)

- ③ 表示芯片系列:

R 调节控制电路系列

- ④ 器件标号。

- ⑤ 电气变化:

- A $\pm 1\%$ 调节器电压
- B $\pm 1.5\%$ 调节器电压
- C $\pm 2\%$ 调节器电压
- D $\pm 0.5\%$ 调节器电压

⑥ 封装形式:

- A 薄片 (基座 8) 封装
- B 8 条引脚 DIP
- C 16 条引脚 DIP
- K 16 条引脚表面贴装 (内引脚弯曲呈 J 型)
- X 薄片 (基座 16) 封装

Atmel Corporation (ATMEL)

爱特梅尔公司 (美)

<http://www.atmel.com>



该公司产品型号由 6 部分组成, 例如:

AT **28C64** - **5** **P** **M** **B**
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
 - C CMOS
 - HC 高速 CMOS
- ② 器件标号。
 - ③ 表示最大传输延迟时间, 单位 ns。
 - ④ 封装形式:
 - P 塑料 DIP
 - D 陶瓷 DIP
 - J 带 J 引脚芯片载体封装
 - L 无引脚芯片载体陶瓷封装
 - ⑤ 使用温度范围:
 - C 商业级 (0~+70°C)

- I 工业级 (-40~+85℃)
- M 军品级 (-55~+125℃)

⑥ 筛选方法:

- 空 标准筛选
- B 高可靠筛选

Bel Fuse, Inc. (Bel)
 贝尔保险丝公司 (美)
<http://www.belfuse.com>



该公司产品型号由 3 组数字组成, 其中第 1 组数字表示芯片的电路功能和类别, 后 2 组数字器件标号, 例如:

0452 - **005** - **01**
 ① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片的电路功能和类别:

- 0447 延迟线
- 0451 传输延迟组件
- 0452 函数发生器
- 0455 微定时器

② 器件标号。

③ 器件标号。

Bharat Electronics Ltd. (BEL)
 伯哈特电子有限责任公司 (印)
<http://www.bel-india.com>



该公司产品型号由 3 部分组成, 例如:

BEL **550** **B**
 ① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片的电路功能或类别:

BEL 电压基准源

BM 调制器

CA 放大器

② 器件标号。

③ 改型标志。

Bipolar Integrated Technology (Bipolar)

双极集成技术公司 (美)

该公司产品型号由 5 部分组成，例如：

B x x - xxx x
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 表示芯片系列：

2 TTL 系列

3 ECL 10K 系列

③ 表示芯片类型：

0 整数

1 浮点

2 存储器

④ 器件标号。

⑤ 表示筛选或老化方法：

空 加标准散热器

S 不加散热器

B 加散热器并老化

E 不加散热器并老化

Brooktree Corporation (Brooktree)

溪树公司 (美)

Brooktree

该公司产品型号由 4 部分组成，例如：

BT 401 K G

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 表示芯片系列：

100~109 数模转换器

200~299 模数转换器

300~399 视频放大器

400~449 外围设备

450~499 RAMDAC

600~699 ATE

③ 使用温度范围：

A 早期等级

B 通用（-25~+85℃）

C 低级

J 早期等级

K 通用（0~+70℃）

L 低级（对于 100K ECL 电路：0~+85℃）

R 早期等级

S 通用

T 低级

④ 封装形式：

C 陶瓷或陶瓷边铜焊 DIP

F 陶瓷扁平封装

G 引脚阵列排列陶瓷封装

P 塑料 DIP

L 无引脚芯片载体陶瓷封装

M 金属封装

Burr-Brown Corporation (Burr-Brown)

伯尔-布朗公司 (美)

<http://www.burr-brown.com>



伯尔-布朗公司已被德州仪器公司收购。该公司的产品有 3 类。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

INA **105** **A** **A** **M**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 表示产品类别：

OPA	运算放大器
INA	仪器用放大器
PGA	可编程增益放大器
ISC	隔离放大器
MFC	多功能转换器
MPY	乘法器
DIV	分频器、信号调节器
LOG	对数放大器
VFC	电压—频率转换器
UAF	通用有源滤波器
ADC	模数转换器
ADS	带取样保持的模数转换器
DAC	数模转换器
MPC	乘法器
PCM	模数和数模转换器
SOM	系统数据组件
SHC	取样-保持电路
PWS	电源
PWR	电源

PEF 参考源

XTR 发射机

RCV 接收机

② 器件标号。

③ 表示改型标志。

④ 使用温度范围：

H 商业级（最低性能）

J 商业级（0~+70℃）

K 商业级（0~+70℃）

L 商业级（最高性能）

A 工业级（最低性能）

B 工业级（-25~+125℃）

C 工业级（最高性能）

R 军品级（最低性能）

S 军品级（-55~+125℃）

T 军品级（最高性能）

⑤ 封装形式：

M 金属封装（密封）

P 塑料 DIP（非密封）

G 陶瓷（气密或非气密）封装

N 有引脚芯片载体塑料封装

L 无引脚芯片载体陶瓷封装

D 芯片小方块包封

H 陶瓷（密封）

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成，例如：

OPA **633** **P** **H**

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 表示产品类别，与第 1 类产品相同。

② 器件标号。

③ 封装形式：

- M 金属（密封）封装
- P 塑料 DIP（密封）
- G 陶瓷（气密或非气密）封装
- V 窄间距封装
- N 有引脚芯片载体塑料封装
- D 芯片小方块包封
- H 陶瓷（气密）

④ 使用温度范围，与第 1 类产品相同。

3. 第 3 类产品型号命名规则

该类产品型号由 6 部分组成，例如：

ADC 803 x x x x
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 表示产品类别，与第 1 类产品相同。

② 器件标号。

③ 一般说明：

- A 改进型
- L 固定
- Z ±12V 电源
- HT 温度范围宽

④ 使用温度范围，与第 1 类产品相同。

⑤ 封装形式，与第 1 类产品相同。

⑥ 老化（筛选）方法：

- Q 提高可靠性
- IQM 按 MIL-STD-883 标准筛选

California Micro Devices Corp. (CMD)

加利福尼亚微器件公司 (美)

<http://www.calmicro.com>



该公司产品型号有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

G **8870** **A** **D** **I**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 改型标志。
- ④ 封装形式：

P 塑料 DIP
D 陶瓷 DIP
E 无引脚芯片载体封装
X 小方块芯片封装
S 边铜焊陶瓷 DIP

- ⑤ 使用温度范围：

空 商业级 (0~+70℃)
S 商业级 (0~+70℃)
I 工业级 (-40~+85℃)
W 工业级 (-25~+85℃)
M 军品级 (-55~+125℃)

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 6 部分组成，例如：

G **65SC×××** **A** **P** **I** **2**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀：

- C 特殊
- G 标准
- ② 器件标号。
- ③ 改进型标志。
- ④ 封装形式，与第 1 类产品相同。
- ⑤ 使用温度范围：
 - 空 0~+70℃
 - I -40~+85℃
- ⑥ 速度/功耗改变。

Calmos Semiconductor, Inc. (Calmos)

加利福尼亚 MOS 半导体公司（美）

该公司产品分为 CMOS 和双极型电路 2 种型号命名规则，现分别叙述如下：

1. CMOS 电路型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

CA **80C85B** × × ×
 ① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 表示芯片速度。
- ④ 使用温度范围：
 - C 商业级（0~+70℃）
 - I 工业级（-40~+85℃）
 - E 扩展（-55~+125℃）
 - M 军品级（-55~+125℃），按 MIL-STD-883 标准老化筛选
- ⑤ 封装形式：
 - D 陶瓷（边铜焊）封装
 - J 陶瓷浸渍封装

- L 陶瓷无引脚芯片载体封装
- M 小间距塑封
- N 无引脚芯片载体塑封
- P 塑料 DIP 封装

2. 双极型电路型号命名规则

该产品型号由 4 部分组成，例如：

CA 2854 L 24

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 封装形式，同第 1 类产品相同。
- ④ 表示外引脚数。

Catalyst Semiconductor, Inc. (Catalyst)

凯特利斯特半导体公司（美）

<http://www.catsemi.com>

该公司产品型号由 5 部分组成，例如：

CAT 22C12 D I 20

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 封装形式：
 - D 陶瓷 DIP
 - P 塑料 DIP
 - K 小间距封装
 - J 有引脚芯片载体封装
 - L 无引脚芯片载体封装
- ④ 使用温度范围：



空/C 商业级 (0~+70℃)

I 工业级 (-40~+85℃)

⑤ 表示存取时间:

20 200ns

30 300ns

Cherry Semiconductor Corporation (Cherry)

齐瑞半导体公司 (美)

<http://www.onsemi.com/>



该公司已被安森美半导体 (ON Semiconductor) 收购, 并入该公司, 其产品型号由 5 部分组成, 例如:

CS **61534** **A** **I** **P**

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商或芯片电路结构:

CS 表示生产厂商

D 倒装片二极管

P 倒装片 PNP

N 倒装片 NPN

② 器件标号。

③ 改型标志。

④ 使用温度范围:

C 商业级 (0~+70℃)

I 工业级 (-40~+85℃)

M 军品级 (-55~+125℃)

⑤ 封装形式:

H、F、D、N 环氧树脂 DIP 封装

J 陶瓷 DIP

P 自插入封装

O 芯片小方块封装

T TO 型圆壳封装

注：在⑤中有时也包含电源选择标志，如：

- B 标准双电源
- S 非标准双电源

Comlinear Corporation (CLC)

共线性器件公司 (美)

<http://www.national.com>

该公司已被美国国家半导体公司
(National Semiconductor) 收购合并。

其产品型号由 3 部分组成，例如：

CLS **104A** **M**

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号，其中字母 A 表明改型。
- ③ 使用温度范围：

I 工业级 (-40~+85℃)

M 军品级 (-55~+125℃)



Conexant Systems, Inc.

科胜讯系统公司

<http://www.conexant.com>

该公司由原洛克威尔公司 (Rockwell International Corp.) 半导体部独立而
来。其型号命名方法请参见洛克威尔公司的命名法。



C O N E X A N T

Cirrus Logic Inc. (Cirrus)

凌云逻辑公司 (美)

<http://www.cirrus.com>

该公司产品型号由 3 部分组成，例如：



CS 43 62 A

- ① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 芯片功能系列：
 - 30 工业级放大器
 - 33 音量控制器
 - 42 音频编解码器
 - 42L 便携式音频转换器
 - 43 音频数模转换器
 - 45 数字音频放大器
 - 48 音频处理器
 - 49 音频处理器、PC 音频、视频转化器
 - 50 工业级模数转换器
 - 52 模数转换器
 - 53 音频模数转换器
 - 54 功率表
 - 55 数模转换器
 - 61 T1/E1/J1 LIU
 - 64 红外线和回声减消器
 - 84 接口和采样率转换器
- ③ 器件标号，为 2 位或 3 位数字。
- ④ 表示改进型。

CML Microcircuits(USA) Inc(CML)

CML 微电路公司(美)

<http://www.cmlmicro.com>



CML Microcircuits

该公司原名 MX-COM 公司 (MX-COM,Inc.)，部分产品命名方法请参照 MX-COM 公司。

Crystal Semiconductor (Crystal)

克瑞斯涛半导体公司 (美)

<http://www.cirrus.com>

CRYSTAL
Semiconductor Corporation

该公司已和凌云逻辑公司 (Cirrus Logic Inc.) 合并, 其产品型号由 7 部分组成, 例如:



CS 61574 I L I N H/R
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 器件标号, 其中器件标号第 1 个数字 (仿制品除外) 含义为:
 - 3 数据支持电路
 - 5 模数转换器
 - 6 通信电路
 - 7 信号调节电路
 - 8 数据通信电路
- ③ 使用温度范围:
 - J 商业级 (0~+70°C)
 - K 商业级 (较好)
 - L 商业级 (最好)
 - A 工业级 (-40~+85°C)
 - B 工业级 (较好)
 - C 工业级 (最好)

注: 对于信号调节/通信类产品, 采用下列温度规范:

- I 工业级 (-40~+85°C)
- M 军品级 (-55~+125°C)
- 空 商业级 (0~+70°C)

- ④ 封装形式:
 - L J 引脚芯片载体塑料封装
 - P 塑料 DIP

- C 陶瓷边铜焊 DIP
 - D 陶瓷 DIP
 - E 无引脚芯片载体陶瓷封装
- ⑤ 电性能或芯片速度。
- ⑥ 特殊处理工艺。
- ⑦ 改型标志。

CTS Corporation (CTS)

CTS 公司 (美)

<http://www.ctscorp.com>

CTS

该公司产品型号由 4 部分组成，例如：

CTS **0024** **G** **B**

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 表示器件的外形尺寸：
 - G 圆壳封装，直径 0.2 ± 0.005 英寸
 - X 同上
 - Z TO-3 型金属壳封装
- ④ 表示外引脚处理方式：
 - A 热焊
 - B 标准
 - C 镀金

Custom Micro Systems, Inc.

克斯特姆微系统公司 (美)

该公司的产品型号由 3 部分组成，例如：

CMS **1020** **I**

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 使用温度范围：
 - I 工业级 (-40~+85℃)
 - 空 商业级 (0~+70℃)

Cybernetic Micro System(Cybernetic)

西伯奈蒂克微系统公司(美)

<http://www.controlchips.com>

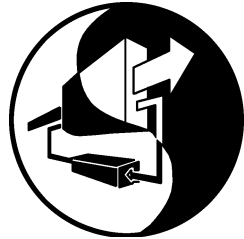
该公司的产品型号由 4 部分组成，例如：

CY **600** **C** **ML**

- ①
- ②
- ③
- ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 表示电路类型：
 - CY 芯片
 - CYB 研制电路
 - CYP 程序电路
 - CYS 程序接口电路
- ② 器件标号。
- ③ 字母“C”，表示 CMOS 电路。
- ④ 字母“ML”为军品标志，空表示商业级 NMOS 产品。



Cypress Semiconductors(Cypress)

赛普拉斯半导体公司(美)

<http://www.cypress.com>

该公司的产品型号由 6 部分组成，例如：

CY **7C128** - **45** **D** **M** **B**

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥

各部分字母和数字含义如下。



- ① CY 或 PALC, 前缀, 表示生产厂商。
- ② 器件标号, 其中“C”表示 CMOS, 如器件标号再加 L, 则表明是低功耗。
- ③ 表示最大延迟时间, 单位 ns。
- ④ 封装形式:
 - D 陶瓷 DIP
 - F 扁平封装
 - G 引脚阵列排列封装
 - J 有引脚芯片载体塑料封装
 - K 玻璃扁平封装
 - L 无引脚芯片载体封装
 - P 塑料 DIP
 - Q 窗式无引脚芯片载体封装
 - S 小间距外引脚封装
 - T 窗式玻璃扁平密封
 - V 小尺寸 (J 引脚) 封装
 - W 窗式陶瓷 DIP
 - X 小方块式封装
- ⑤ 使用温度范围:
 - C 商业级 (0~+70℃)
 - M 军品级 (-55~+125℃)
- ⑥ 筛选方法:
 - B 高可靠, 按 MIL-STD-883C (军品) 筛选
 - 空 商业级产品, 按 II 类筛选

Dallas Semiconductor (Dallas)

达拉斯半导体公司 (美)

<http://www.maxim-ic.com>

该公司已被美信集成产品公司



(Maxim Integrated Products, Inc) 收购, 成为其全资子公司。2007 年后只使

用 Maxim 商标。该公司产品有 5 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成，例如：

DS **1225** **AB** - **150**
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 器件标号。

③ 工作电压范围：

AB 5(1±5%)V

AD 5(1±10%)V

Y 5(1±10%)V

④ 表示芯片存取时间，单位 ns。

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成，例如：

DS **5000** **32** - **12**
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 同第 1 类产品。

② 同第 1 类产品。

③ 表示存储器比特数。

④ 表示芯片的频率特性，单位 MHz。

3. 第 3 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成，例如：

DS **1231** **20**
① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 同第 1 类产品。

② 同第 1 类产品。

③ 表示滞后电压，单位 mV。

4. 第 4 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成，例如：

DS **1000** - **500**
① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 同第 1 类产品。
- ② 同第 1 类产品。
- ③ 表示总延迟时间，单位 ns。

5. 第 5 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成，例如：

DS **1260** - **250**
① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 同第 1 类产品。
- ② 同第 1 类产品。
- ③ 表示容量 (×10mAh)。

Datel, Inc. (Datel)

丹特电子公司 (美)

<http://www.cd4power.com>



该公司于 2004 年并入 C&D 科技公司 (C&D Technologies) 电源电子事业部，2007 年日本株式会社村田制作所 (Murata Manufacturing Co., Ltd) 又将其收购，以 Murata Power Solutions 名义开始运营。

该公司的产品有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成，例如：

AM **490** **2** **A**
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 表示芯片功能系列：

AM	放大器
ADC	模数转换器
ADS	模数转换器（取样）
DAC	数模转换器
FLJ、FLT	滤波器
DAS	数据采集系统
MV、MX	多路调制器
SHM	取样-保持电路
VF	电压-频率转换器
VR	电压参考值
VI	反相器

② 器件标号。

③ 封装形式（单片）：

- 1 14 条外引脚 DIP
- 2 TO-99 型外壳封装

④ 表示可选择。

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成，例如：

DAC **HZ12B** **G** **C**
 ① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 同第 1 类产品。
- ② 同第 1 类产品。
- ③ 封装形式（合成组件）：
 - G 环氧树脂封装
 - M 气密性封装
- ④ 使用温度范围：
 - C 0~+70℃
 - M -55~+125℃
 - R -25~+85℃

Delco Electronics, Inc. (Delco)

德科电子公司 (美)

<http://delphi.com>

DELPHI

该公司现属于德尔福 (Delphi) 公司, 其产品型号由 7 部分组成, 例如:

DM **0256** **N** **4** **A** **100** **C**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示 DRAM 存储器。

② 器件标号。

③ 表示存储方式:

N 4bit 式 (半字节)

P 页面式

④ 表示存储器字长。

⑤ 改型标志。

⑥ 表示最大存取时间, 单位 ns。

⑦ 使用温度范围:

C 商业级 (0~+70°C)

I 工业级 (-40~+85°C)

M 军品级 (-55~+125°C)

DPAC Technologies Corp. (DPAC)

DPAC 技术公司 (美)

<http://www.dpactech.com>



DPAC
TECHNOLOGIES

公司原名顿斯-派克微系统公司 (Dense- Pac Microsystems Inc.), 其产品有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品有 6 部分组成, 例如:

DP **S** **92256** **G** **85** **M**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 器件类型：

- S SRAM
- D DRAM
- E EEPROM
- V EPROM
- N NOVRAM
- O 视频 RAM
- P 双口 RAM
- Z 快速 EEPROM
- F 先入先出

③ 器件标号。

④ 封装形式：

- G 无引脚芯片载体封装
- P 塑料封装

⑤ 表示芯片速度。

⑥ 使用温度范围：

- C 商业级 (0~+70℃)
- I 工业级 (-40~+85℃) 并老化
- M 军品级 (-55~+125℃) 筛选
- B 军品级 (-55~+125℃)，按 5004 和 5005 军品级标准筛选

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 7 部分组成，例如：

DP **xx** **xx** **41** **71** **V** **M**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 表示芯片的位数/速度 (MO)。其中第 1 位数字代表位数：

- 0 8K×8 SRAM
- 1 32K×8 SRAM

- 2 128K×8 SRAM
- 3 8K×8 SRAM
- 4 32K×8 EEPROM
- 5 128K×8 EEPROM
- 6 8K×8 EPROM
- 7 32K×8 EPROM
- 8 128K×8 EPROM

第 2 位数字表示速度：

	SRAM	EEPROM	UVPRAM
0	150ns	300ns	300ns
1	120ns	250ns	250ns
2	100ns	200ns	200ns
3	85ns	150ns	170ns
4	70ns	120ns	150ns
5	55ns	90ns	120ns
6	45ns	70ns	90ns
7	35ns	55ns	70ns
8	25ns	45ns	55ns
9	20ns	35ns	45ns

③ 位数/速度 (M1)，其中两位数字含义均同②。

④ 位数/速度 (M2)，其中两位数字含义均同②。

⑤ 位数/速度 (M3)，其中两位数字含义均同②。

⑥ 改型标志。

⑦ 使用温度范围：

C 商业级 (0~+70℃)

I 工业级 (-40~+85℃) 加老化

M 军品级 (-55~+125℃)，MIL 标准筛选

B 军品级 (-55~+125℃)，按 5004 和 5005MIL 标准筛选

EG&G Reticon Corp.

EG&G 雷狄康公司 (美)

<http://www.egginc.com>



该公司为美国优斯 (URS) 公司的子公司, 其产品型号命名规则如下。

1. 模拟器件型号命名规则

该类产品型号由 7 部分组成, 例如:

R **M** **5604** **A** **N** **P** - **011**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商。

② 芯片类型:

- D 延迟线
- M 调制解调滤波器
- F 开关容量器滤波器
- U 通用有源滤波器
- T 截止式滤波器
- C 组件产品

③ 器件标号。

④ 改进型标志。

⑤ 表示模拟器件。

⑥ 封装形式:

- P 塑料封装
- C 陶瓷浸渍封装
- B 边铜焊封装
- L 无引脚 (密封)
- S 有引脚芯片载体封装
- D 小方块包封
- W 方块包封
- E 环氧树脂封装

⑦ 表示特殊和选择标志。

2. 传感器型号命名规则

该类产品型号由 7 部分组成，例如：

R **L** **1234** **C** **D** **E** - **567**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

- ① 同模拟器件。
- ② 同模拟器件。
- ③ 同模拟器件。
- ④ 表示芯片系列，共分为 A、C、H 三个系列。
- ⑤ 表示芯片开口宽度。
- ⑥ 表示芯片窗口形状。
- ⑦ 表示特殊和选择等标志。

Elantec Semiconductor (Elantec)

依兰泰克半导体公司（美）

<http://www.intersil.com/>

该公司已被英特矽尔 (Intersil) 公司收购，其产品主要为高性能模拟集成电路，有 2 种命名规则。



1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如

EH **A** **2** **-2520** **/883B**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 芯片功能：
 - A 模拟电路
 - EP PNP 管阵列
 - EN NPN 管阵列

③ 封装形式:

- 1 14 条外引脚陶瓷 DIP
- 2 TO-99 金属壳封装
- 3 塑料 DIP
- 4 无引脚芯片载体封装
- 7 8 条外引脚陶瓷 DIP
- 9 扁平封装
- 0 小方块包封

④ 器件标号。

⑤ 质量保证等级:

- 1 0~+70°C
- 2 军品级 (-55~+125°C)
- 4 -25~+85°C
- 5 商业级 (0~+70°C)
- 6 100%25°C 抽样测试, 仅适用于小方块包封电路
- 9 工业级 (-40~+85°C)
- 883 按 MIL-STD-883 标准筛选 (军品)

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 6 部分组成, 例如:

E **L** **2006** **A** **G** / **E+**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商。

② 表示芯片系列:

- LH NSC 交流源
- L 公司特有的线性电路
- DH NSC 交流源
- P PNP 阵列
- N NPN 阵列
- SCD 小方块包封电路

③ 器件标号。

④ 使用温度范围：

A 电性能选择

C 工业级 (-25~+85℃)

空 军品 (-55~+125℃)

⑤ 封装形式：

D 陶瓷封装

F 扁平封装

G TO-8 金属壳封装

H TO-5 或 TO-99 外壳封装

J 陶瓷 DIP

K TO-3 金属壳封装

L 无引脚芯片载体封装

N 塑料 DIP

PL 有引脚芯片载体塑料封装

⑥ 表示可靠性：

-8 单片电路逐块筛选

/E+ 良品高可靠

883B 全部按 MIL-STD-883B 标准筛选

Electronic Arrays, Inc.

电子阵列公司 (美)

<http://www.nec.com>

NEC

该公司现属日本电气电子公司 (NEC Electronics Corporation)，其产品型号由 4 部分组成，例如：

EA **32xx** **D** **M**

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 表示芯片系列。

③ 封装形式:

- D 密封 DIP
- P 灌封 DIP
- X 管芯包封

④ 使用温度范围:

- C 0~+70℃
- I -55~+85℃
- L -55~+100℃
- M -55~+125℃
- X 其他

Ericsson Components AB (Ericsson)

爱立信元件公司 (瑞典)

<http://www.ericsson.com>



该公司的产品型号由 4 部分组成, 例如:

P BL 3719 N
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 表示分类:
 - BA 混合电路
 - BD 双极型数字电路
 - BL 双极型线性电路
 - BM MOS 电路
 - BR 电阻网络, 定制/标准器件
 - RR 电阻网络, 半定制或标准器件
- ③ 器件标号。
- ④ 封装形式:
 - N 塑料 DIP
 - J 陶瓷 DIP

CC	无引脚芯片载体封装
QN	无引脚芯片载体塑料封装
QC	四边玻璃扁平封装
MC	金属壳封装
CP	玻璃扁平封装
PG	引脚阵列排列封装
SO	小尺寸（小间距）外引脚封装
SL	SIP
QL	四列直插式封装

Exar Integrated Systems, Inc (Exar)

埃克萨集成系统公司

<http://www.exar.com>



该公司的产品型号由 4 部分组成，例如：

XR -2216 CN N
 ① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 器件标号。

③ 表示分类等级：

M 军品，仅用于陶瓷封装

N 优品，陶瓷封装

P 优品，塑料封装

CN 商业级，陶瓷封装

CP 商业级，塑料封装

K 包装袋

④ 封装形式：

N 陶瓷 DIP

P 塑料 DIP

T 金属圆壳封装

- D 芯片（切割开）封装
- A 包装改形
- B 包装改形
- W 大圆片

EXEL Microelectronics Inc. (EXEL)

爱克西尔微电子公司（美）



该公司的产品型号由 6 部分组成，例如：

XL S 2816A C 250 E2
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 使用温度范围：
 - S 商业级（0~+70℃）
 - E 工业级（-40~+85℃）
 - A 工业级（-40~+105℃）
 - M 军品级
- ③ 器件标号，其中字母表示工艺类别：

- C CMOS
- HC 高速 CMOS
- A 改型

B、C 新产品。

- ④ 封装形式：
 - C 陶瓷 DIP
 - D 有引脚芯片载体塑料封装
 - L 无引脚芯片载体陶瓷封装
 - P 塑料 DIP
 - S 边铜焊陶瓷 DIP
- ⑤ 存取时间，单位 ns。
- ⑥ 特殊性能。

Fairchild Semiconductor Corp. (Fairchild)

飞兆半导体公司 (美)

www.fairchildsemi.com



该公司中文名称原译为仙童半导体公司，其产品型号有 4 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号的命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

μ A 741 A H M
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商和产品系列。

F 仙童公司
SH 混合组件
 μ A 线性电路

② 器件标号。

③ 电性能。

④ 封装形式：

D 陶瓷 DIP
E 塑料封装
F 扁平封装
H 金属壳封装
J TO-66 金属壳封装
K TO-3 金属壳封装
P 塑料 DIP
R 陶瓷小型 DIP
S 陶瓷 DIP (F6800 系列)
T 小型 DIP
U TO-220 外壳封装
W 塑封 (TO-92 外壳)

⑤ 使用温度范围：

C	0~+70℃ (CMOS -40~+85℃)
L	MOS (-55~+85℃)
混合组件	-20~+85℃
M	-55~+125℃

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

F **1600** **D** **M** **55**
 ① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 器件标号。

③ 封装形式：

P	塑料 DIP
SP	小型塑料 DIP
D	陶瓷 DIP
SD	小型陶瓷 DIP
F	扁平封装
LI	无引脚芯片载体陶瓷封装
Q	有引脚芯片载体塑料封装
S	小尺寸（小间距）外引脚封装

④ 使用温度范围：

C 商业级（0~+70℃）

M 军品级（-55~+125℃）

⑤ 表示最大存取时间：

25 25ns

35 35ns

55 55ns

3. 第 3 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

1601 **A** **L** **C** **25**
 ① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 器件标号。
- ② 改型标志。
- ③ 封装形式：

P 塑料 DIP
L 无引脚芯片载体陶瓷封装
D 陶瓷 DIP

- ④ 使用温度范围，同第 2 类产品。
- ⑤ 最大存取时间，同第 2 类产品。

4. 第 4 类产品型号命名规则

该类产品型号由 6 部分组成，例如：

74 **H** **xxx** **P** **C** **XR**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

- ① 表示芯片系列：

74 商业级
54 军品级
29 商业级或军品级
93 军品级

- ② 表示工艺类别：

F ASTTL (FAST)
S 肖特基 TTL
H TTL
L 低功耗 TTL
AC 先进 CMOS
ACT TTL 和先进 CMOS 兼容

- ③ 器件标号。
- ④ 封装形式，同第 2 类产品。
- ⑤ 使用温度范围，同第 2 类产品。
- ⑥ 筛选方法：

- QR 商业级等级, 经老化
- QB 军品级等级, 经老化
- XR, TR 商业级等级, 经老化

Freescale Semiconductor, Inc
 飞思卡尔半导体公司
<http://www.freescale.com>



该公司由原摩托罗拉公司半导体部 (Motorola Semiconductor Products, Inc.) 分拆而来。产品型号命名方式参见摩托罗拉产品。

Fujitsu Components America, Inc (Fujitsu)
 富士通元件美国公司 (美)
<http://www.fujitsu.com>

该公司的产品型号由 4 部分组成, 例如:

MBM **2764** - **30** **Z**
 ① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

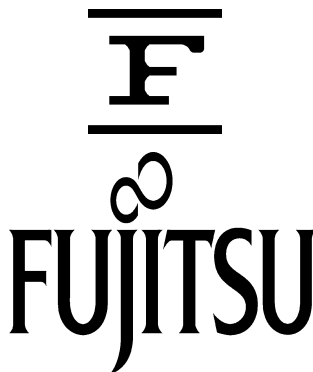
① 前缀, 表示生产厂商和产品系列:

- MB 公司内部产品
- MBM 工业级标准存储器
- MBL 标准器件

② 器件标号。

③ 芯片特性:

70	70ns, 最大存取时间 (下同)
80	80ns
10	100ns
12	120ns
20	200ns
25	250ns
30	300ns



35	350ns
40	400ns
50	500ns
L	低功耗
E、H、-	其他存取时间
④ 封装形式:	
C	陶瓷材料或陶瓷 DIP
M	塑封
B	塑料 DIP 或塑料封装
Z	DIP
V	无引脚芯片载体封装
PF	小间距外引脚塑料封装
PJ	J 引脚塑料 DIP
CJ	J 引脚陶瓷 DIP
CZ	陶瓷 DIP
CV	无引脚芯片载体陶瓷封装
TV	无引脚芯片载体陶瓷封装
PZ、PSZ	Z 字形串连封装

Fujitsu Limited(Fujitsu)

富士通有限公司(日)

<http://www.fujitsu.com>

该公司产品型号共有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成, 例如:

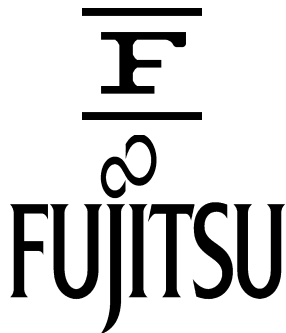
MBM **27C512** - **30** **Z**

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义皆与富士通元件美国公司相同。

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成, 例如:



MB 7144 H Z

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 同第 1 类产品。

② 同第 1 类产品。

③ 芯片特性:

E、H、B 存取时间或传输延迟时间

L 低功耗

④ 封装形式:

C 陶瓷封装

P 塑封

Z 陶瓷 TJIP

M 塑封 (老产品)

V 无引脚芯片载体封装

PF 小间距外引脚塑封

Fujitsu Microelectronics, Inc. (Fujitsu)

富士通微电子有限公司 (美)

<http://www.fujitsu.com>

该公司产品型号有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成, 例如:

MBM 2764 -30 Z

① ② ③ ④

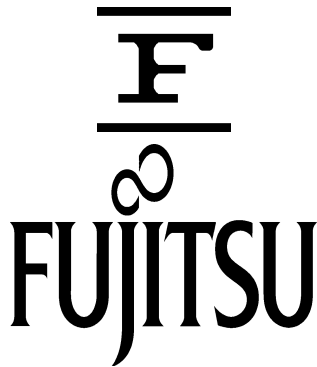
各部分字母和数字含义皆与富士通元件
美国公司相同。

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 7 部分组成, 例如:

IM 6654 A M J G / 883B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦



各部分字母和数字含义如下。

① 器件类型：

D	驱动器，电平转换器
DGM	单片数字（DG）模拟开关替换器
ICL	线性电路
ICM	微机外设电路
ICH	混合电路
IM	微控制器和外设电路
MM	高压模拟开关
DG	模拟开关
IH	模拟开关

② 器件标号。

③ 改型标志。

④ 使用温度范围（D 和 DG 器件类型除外）：

M	军品级（-55~+125℃）
I	工业级（-25~+85℃）
C	商业级（0~+70℃）

对于 D 和 DG 器件类型：

A	军品级
B	工业级
C	商业级

⑤ 封装形式：

A	TO-237 外壳封装
B	小间距外引脚封装
C	TO-220 外壳封装
D	陶瓷 DIP
E	小型 TO-8 外壳封装
F	陶瓷扁平封装
H	TO-66 外壳封装
I	16 条引脚（0.6×0.7 间距）封装

- J 玻璃 DIP
- K TO-3 外壳封装
- L 无引脚芯片载体陶瓷封装
- P 塑料 DIP
- S TO-52 外壳封装
- T TO-5 型 (包括 TO-78, TO-99, TO-100 型) 外壳封装
- U TO-72 (包括 TO-18, TO-71 型) 外壳封装
- V TO-39 外壳封装
- Z TO-92 外壳封装
- /W 薄片封装
- /D 小方块包封

⑥ 外引脚数:

- A 8
- B 10
- C 12
- D 14
- E 16
- F 22
- G 24
- H 42
- I 28
- J 32
- K 25
- L 40
- M 48
- N 18
- P 20
- Q 2
- R 3
- S 4

T	6
U	7
V	8[周长 0.508cm (0.2 英寸*), 绝缘壳]
W	10[周长 0.5842cm (0.23 英寸), 绝缘壳]
Y	8[周长 0.508cm (0.2 英寸)]
Z	10[周长 0.5842cm (0.23 英寸)]

⑦ 筛选方法:

空	按标准法筛选
/883B	按 MIL-STD-883B 标准筛选
1 HR	高可靠方法筛选
1 BI	老化

F. W. Bell

F. W. 贝尔公司 (美)

[http:// www.sypris.com](http://www.sypris.com)

该公司先已并入美国 Sypris 公司,
其产品型号由 3 部分组成, 例如:

FH 301 - 20

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, FH、BHA、BHT, 表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 表示最大输入阻抗, 单位 Ω 。



GE SOLID STATE (GE)

通用电气固态公司 (美)

<http://www.ge.com>

该公司产品型号有 2 种命名规则, 现分别举例如下:



* 1 英寸=2.54 厘米

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

CD **40208** **B** **D** **x**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，CD、MW 或 GP。

② 器件标号。

③ 表示电源电压极限：

A 15V

B 20V（缓冲器）

UB 20V（非缓冲器）

④ 封装形式：

E 塑料 DIP

EN 窄间距 24 条外引脚 DIP

F 玻璃烧结的陶瓷 DIP

M 小型封装

K 扁平封装

D 陶瓷 DIP

Q 有引脚芯片载体塑料封装

⑤ 筛选方法：

X 老化

空 标准工艺

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

CD **74HCT40105** **A** **M** **x**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示先进 CMOS 电路。

② 器件标号。

③ 电源电压极限值，与第 1 类相同。

- ④ 封装形式，与第 1 类相同。
- ⑤ 筛选方法，与第 1 类相同。

GE Intersil, Inc. (GE)

通用电气英特矽尔公司(美)

该公司的产品型号由 7 部分组成，例如：

ICL 7622 A C J D / 883B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

① 器件类型：

- D 驱动器/电平转换器
- DGM 单片 DG 模拟开关替换
- ICL 线性电路
- ICM 微机外设电路
- ICH 混合电路
- IM 微控制器
- MM 高压模拟开关

② 器件标号。

③ 电特性/改型标志。

④ 使用温度范围：

- A 军品级
- B 工业级
- C 商业级
- 其他：M 军品级（-55~+125℃）
- I 工业级（-25~+85℃）
- C 商业级（0~+70℃）

⑤ 封装形式：

- A TO-237 外壳封装
- B 小间距外引脚封装
- C TO-220 外壳封装



intersil

D	陶瓷 DIP
E	小型 TO-8 外壳封装
F	陶瓷扁平封装
H	TO-66 外壳封装
I	16 条外引脚 (0.6×0.7 间距) 封装
J	陶瓷浸渍 DIP
K	TO-3 外壳封装
L	无引脚芯片载体陶瓷封装
P	塑料 DIP
S	TO-52 外壳封装
T	TO-5 (包括 TO-78、TO-99 和 TO-100 型) 外壳封装
U	TO-72 (包括 TO-18, TO-71 型) 外壳封装
V	TO-39 外壳封装
Z	TO-92 外壳封装
/W	薄片封装
/D	芯片小方块包封

⑥ 外引脚数:

A	8	B	10
C	12	D	14
E	16	F	22
G	24	H	42
I	28	J	32
K	35	L	40
M	48	N	18
P	20	Q	2
R	3	S	4
T	6	U	7
V	8[周长 (0.2 英寸), 绝缘壳]		
W	10[周长 (0.23 英寸), 绝缘壳]		
Y	8[周长 (0.2 英寸), 绝缘壳]		

Z 10[周长 (0.23 英寸), 绝缘壳]

⑦ 筛选方法:

空 标准法
/883B MIL-STD-883B 标准
1HR 高可靠
1BR 成本等同的高可靠器件
1BI 老化

General Instrument Corporation(GI)

通用仪器公司(美)

<http://www.vishay.com/company/brands/semiconductors/>

该公司现并入威世(Vishay)公司,其产品型号共有3种命名规则,现分别举例叙述如下:

1. 第1类产品型号命名规则

该类产品型号共由4部分组成,例如:

AY 5 WXYZ xx
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 器件系列和类别:

CU 阵列
AY 阵列
DL 移位寄存器, 动态, ≥ 50 位
DS 移位寄存器, 动态, < 50 位
LC 线性电路
MEN N与P沟FET
LG 逻辑单元
MU 多路转换器
RA 随机存储器
RO 只读存储器



SL 移位寄存器, 静态, >50 位

SS 移位寄存器, 静态, <50 位

② 使用温度范围与工艺:

0 MTOS, $-55\sim 85^{\circ}\text{C}$

1 MTOS, $0\sim 70^{\circ}\text{C}$

4 N 沟道

5 MTNS, $0\sim 70^{\circ}\text{C}$

6 $-55\sim 125^{\circ}\text{C}$

7 MTNS

8 硅栅, $-55\sim 125^{\circ}\text{C}$

9 硅栅, $0\sim 70^{\circ}\text{C}$

③ W、X、Y、Z 分别代表 4 个数字, 其含义如下。

对于多路转换器, W 和 X 这 2 位数字表示典型的输入阻抗:

01 $\leq 100\Omega$

02 $\leq 200\Omega$

03 $\leq 300\Omega$

YZ 这 2 位数字表示总的沟道数。

对于存储器, WXYZ 表示总的比特数。

对于移位寄存器:

W 表示冗余数, 如:

1 单重

2 双重

3 三重

4 四重

XYZ 每种结构的总位数

对于阵列/线性/逻辑, WXYZ 表示指定的任意数。

④ 封装形式:

01 管芯

12 8 条外引脚 DIP 封装

14 4 条外引脚 TO-5 外壳封装

- 15 8 条外引脚 TO-78 外壳封装
- 16 8 条外引脚 TO-5 外壳封装
- 17 8 条外引脚 TO-5 外壳高剖面封装
- 21 10 条外引脚 TO-5 外壳封装
- 22 10 条外引脚 TO-5 外壳隔离封装
- 23 10 条外引脚 TO-100 外壳封装
- 29 DIP 24 条外引脚塑料封装
- 30 14 条外引脚双列直插式塑料封装
- 31 16 条外引脚 DIP 塑料封装
- 32 24 条外引脚 DIP 塑料封装
- 33 40 条外引脚 DIP 塑料封装
- 35 36 条外引脚扁平塑料封装
- 51 12 条外引脚 TO-8 外壳低剖面封装
- 55 16 条外引脚 DIP 封装
- 60 10 条外引脚扁平封装
- 61 14 条外引脚扁平封装
- 62 16 条外引脚扁平封装
- 63 20 条外引脚扁平封装
- 64 24 条外引脚扁平封装
- 65 40 条外引脚扁平封装
- 66 36 条外引脚扁平封装
- 68 44 条外引脚扁平封装
- 69 14 条外引脚 DIP 封装
- 71 16 条外引脚 DIP 封装
- 72 24 条外引脚 DIP (6 密耳中心) 封装
- 73 24 条外引脚 DIP (5 密耳中心) 封装
- 74 40 条外引脚 DIP (6 密耳中心) 封装
- 75 40 条外引脚 DIP (1.05 密耳中心) 封装
- 76 28 条外引脚 DIP 封装
- 77 18 条外引脚 DIP 封装

79 24 条外引脚 DIP (6 密耳中心) 封装

80 14 条外引脚陶瓷 DIP 封装

81 16 条外引脚 DIP 陶瓷封装

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 6 部分组成, 例如:

28C64 **F** **15** **M** **R** / **D**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 器件标号, 其中字母 C 表示 CMOS 器件。

② 选择:

F $t_{wc}=200\mu s$

X $t_{wc}=1ms$

空 $t_{wc}=1ms$

③ 最大存取时间:

12 125ns

15 150ns

17 170ns

④ 使用温度范围:

空 0~+70℃

I 工业级 (-40~+85℃)

M 军品级 (-55~+125℃)

⑤ 筛选方法:

空 标准法

R 按 MIL-STD-883, 5004 法筛选

⑥ 封装形式:

空 塑封封装

/J 陶瓷 DIP

/D 陶瓷封装

/L 有引脚芯片载体塑料封装

/K 无引脚芯片载体陶瓷封装

/W 薄片小方块封装

/S 薄片小方块封装

3. 第 3 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成，例如：

RO9256 A DS

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 器件标号。

② 改进型。

③ 最大存取时间。

B 450ns

CS 350ns

C 300ns

DS 250ns

D 200ns

General Instrument Microelectronics (GI)

通用仪器微电子有限公司（美）

<http://www.vishay.com/company/brands/semiconductors>

该公司现并入威世（Vishay）公司，其产品型号共由 4 部分组成，例如：

27C256 15 I J

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 器件标号，字母 C 表示 CMOS，HC 表示高速 CMOS。

② 存取时间：

45 45ns

55 55ns



70	70ns
10	100ns
12	125ns
15	150ns
17	170ns
20	200ns
25	250ns

③ 使用温度范围:

空	商业级 (0~+70℃)
I	工业级 (-40~+85℃)
M	军品级 (-55~+125℃)

④ 封装方式:

空或 P	塑封
J	陶瓷 DIP
D	陶瓷封装
L	有引脚芯片载体塑料封装
K	无引脚芯片载体陶瓷封装
S	薄片小方块包封
W	薄片小方块包封
KA	无引脚芯片载体封装
KB	无引脚芯片载体封装

Gennum Corporation (Gennum)

智勒姆公司 (加)

<http://www.gennum.com>



GENNUM
CORPORATION

该公司的产品型号由 4 部分组成, 例如:

GP **605** **C** **D**
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商, 可为 GP、LS、LP、WS、LC、LF、WC、WV、

LE、LB、LT、LD、GX、LR。

- ② 器件标号。
- ③ 使用温度范围：
 - C 商业级 (0~+70℃)
 - I 工业级 (-25~+85℃)
 - M 军品级 (-55~+125℃)
- ④ 封装方式：
 - D 塑料 DIP
 - K 小间距外引脚封装
 - R DIP
 - S SIP

GigaBit Logic, Inc. (GBL)

吉盖比特逻辑公司 (美)

<http://www.tqs.com>

该公司现已并入 TriQuint 半导体公司 (TriQuint Semiconductor, Inc., 简称 TQS), 其产品型号共由 6 部分组成, 例如:

 GigaBit Logic

 TriQuint
SEMICONDUCTOR

16G **040** **A** **K** **2** **L**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

- ① 表示芯片系列：
 - 10G 纳逻辑系列
 - 12G 毫微 RAM
 - 14G 毫微 ROM
 - 16G 模拟和接口电路
 - 80G ASIC
 - 90G 样机和支撑件
- ② 器件标号。
- ③ 改型标志。

④ 使用温度范围:

空 商业级 (0~+70℃)

K 工业级 (-40~+80℃)

⑤ 速度:

2 2.7GHz

⑥ 封装形式:

CI 68 引脚芯片载体封装

C 40 端无引脚芯片载体封装

L 40 端无引脚芯片载体封装

F 36 端无引脚芯片载体封装

L36 36 端无引脚芯片载体封装

H 混合封装

Goldstar Semiconductor (Goldstar)

金星半导体公司 (韩)

<http://www.lge.com>



该公司于 1995 年改名为 LG 电子公司 (LG Electronics)。其产品型号共有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成, 例如:

GD **54LS395A** **J**
① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 器件标号, 字母 A 为改型标志。
- ③ 封装方式:

空 塑料 DIP

F 陶瓷扁平封装

J 陶瓷 DIP

D 小间距外引脚封装

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成，例如：

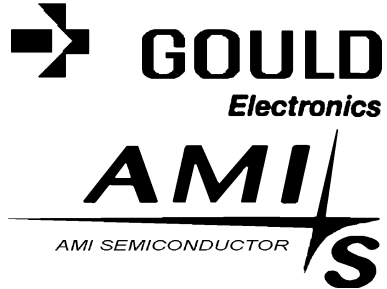
GM **76C164** - **25**
① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商，可为 GM、GD、SM。
- ② 器件标号，其中字母表明工艺：
C CMOS
HC 高速 CMOS
- ③ 最大读取时间。

Gould Semiconductor
Division (Gould)
古尔德半导体分部 (美)
<http://www.amis.com>

该公司已并入 AMI 半导体公司
(AMI Semiconducto)，其产品型号共有
3 种命名规则。



1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成，例如：

S **3528A** **P**
① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，标准电路。
- ② 器件标号，字母 A 表明改进型。
- ③ 封装方式：
P 塑料封装
C 陶瓷封装 (3 层)
T TO 外壳封装
L 无引脚芯片载体封装

E、D 陶瓷封装

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

PEEL **17CV8** **D** **I** **25**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示 EEPLD。
- ② 器件标号。
- ③ 封装形式：（同上述第 1 类产品）
- ④ 使用温度范围：
空 商业级（0~+70℃）
I 工业级（-20~+85℃）
- ⑤ 最大传输延迟，单位 ns。

Grant Technology Systems

格雷特技术系统公司（美）

该公司的产品型号由 4 部分组成，例如：

GD **54LS299** **A** **J**
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号，其中 LS 代表低功耗 54 系列。
- ③ 改型标志。
- ④ 封装方式：
J 陶瓷 DIP

GTE Microcircuits Div. (GTE)

GTE 微电路公司（美）

该公司的产品型号由 6 部分组成，例如：

G **8860** **A** **P** **I** - **2**



- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 电路类别：

C 专用电路

G 标准电路

② 器件标号。

③ 改型标志。

④ 封装形式：

P 塑料封装

C 陶瓷封装

D 陶瓷浸渍封装

E 无引脚芯片载体封装

X 芯片

⑤ 使用温度范围：

空 0~+70℃

I 民品 (-40~+85℃)

M 军品 (-55~+125℃)

B -55~+125℃, (MIL-STD-883, B级)

⑥ 特性标志。

Harris Semiconductor (Harris)

哈里斯半导体公司 (美)



该公司于1999年改名为英特矽尔

(Intersil) 公司, 其产品型号由5部分组成, 例如:

H A 2 - 5141A - 2

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商, 可为 H、HA、HI、ADG、HS、HD、HPL、ID、IR、MD、CD、MR、MP、IP、HC。

② 产品系列或电路类别:

- A 模拟电路
- C 通信电路
- D 数字电路
- F 滤波器
- I 接口电路
- M 存储器
- PL 可编程逻辑
- S CICD
- V 模拟（高压）电路
- Y 模拟混合电路

③ 封装形式：

- 0 芯片
- 01 陶瓷 DIP
- 1B 铜焊封装
- 2 TO-5 外壳封装
- 3 塑料 DIP
- 4 无引脚芯片载体封装
- 5 陶瓷基片（混合）封装
- 7 小型陶瓷 DIP
- 9 扁平封装

④ 器件标号。

⑤ 使用温度范围：

- 1 0~+200℃
- 2 -55~+125℃
- 4 -25~+85℃
- 5 0~75℃
- 6 100% 25℃探测（仅适用小方块）
- 7 高可靠产品（0~+75℃）
- 8 按 MIL-STD-883B 标准
- 9 -40~+85℃

- 5 陶瓷基片（混合）封装
- 7 小型陶瓷 DIP
- 9 扁平封装

④ 器件标号。

⑤ 使用温度范围：

- 1 0~+200℃
- 2 -55~+125℃
- 4 -25~+85℃
- 5 0~75℃
- 6 100% 25℃探测（仅适用小方块）
- 7 高可靠产品（0~+75℃）
- 8 按 MIL-STD-883B 标准
- 9 -40~+85℃
- 9+ -40~+85℃加老化

RH 辐射加固

⑥ 附加说明。

Hitachi Ltd. (Hitachi)
日立公司半导体事业部（日）
<http://www.hitachi.com>

The logo consists of the word "HITACHI" in a bold, sans-serif font above the word "RENESAS" in a larger, bold, sans-serif font. A stylized square symbol is positioned to the left of the "R" in "RENESAS".

2003 年日立半导体事业部与日本三菱半导体事业部联合成立了瑞萨（Renesas）科技公司。原日立和三菱公司产品继续由瑞萨公司生产，命名方法不变。

日立公司半导体事业部的产品型号由 4 部分组成，例如：

HN **27128A** **P** **20**

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商和产品系列：

HA 模拟电路

HD 数字电路（包括 RAM）

HM RAM

HV ROM

② 器件标号, 字母 A 表示改进型。

③ 封装方式:

空 陶瓷 DIP

G 玻璃 DIP

P 塑料 DIP

F 扁平封装

Y 外引脚栅格状排列封装 (对于 16 位微机)

Z 无引脚芯片载体封装 (对于 16 位微机)

S 塑料 DIP (热装型)

MP 无引脚芯片载体封装

FP 扁平封装

CG 无引脚芯片载体封装 (对于 8 位微机)

④ 最大存取时间:

10 100ns

15 150ns

17 170ns

20 200ns

30 300ns

Honeywell, Inc. (Honeywell)

霍尼韦尔公司 (美)

<http://www.ssec.honeywell.com/>

Honeywell

该公司的产品型号由 7 部分组成, 例如:

H **CMP** **96850** **S** **I** **D** **/±**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商。

② 产品类型或类别:

ADC	模数转换器
DAC	数模转换器
DAM	用于存储器的数/模转换器
GMP	比较器
INA	仪器用放大器
SCF	开关电容滤波器
THA	磁道和保持放大器

③ 器件标号。

④ 筛选等级：

A	1 级（最佳）
B	2 级
C	3 级
S	单级

⑤ 使用温度范围：

M	军品级（ $-55\sim+125^{\circ}\text{C}$ ）
I	工业级（ $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$ ）
C	商业级（ $0\sim+70^{\circ}\text{C}$ ）

⑥ 封装形式：

J	陶瓷边铜焊封装
D	DIP
C	无引脚芯片载体封装
G	引脚阵列排列封装
N	塑料 DIP
T	四边引脚塑封
M	金属混合封装
H	陶瓷混合封装
U	芯片包封
S	小间距外引脚封装
X	特殊封装

⑦ 筛选方法：

- /+ 标准老化法
- /H 标准高可靠筛选
- G 特殊电性能

Hughes Aircraft Company (Hughes)

休斯飞机公司 (美)

<http://www.hughes.com>



该公司产品型号共有 2 种命名规则，现分别举例叙述如下：

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

H **C** **3108** - **C** **D**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 筛选/温度范围：
 - B 按 MIL-STD-883B 标准筛选
 - M 军品级 (-55~+125℃)
 - I 工业级 (-40~+85℃)
 - C 商业级 (0~+70℃)
- ③ 器件标号。
- ④ 性能表征，字母 C 或数字表明速度、电压或其他参数
- ⑤ 封装形式：
 - D 陶瓷 DIP
 - L 无引脚芯片载体封装
 - H 芯片
 - P 塑料 DIP
 - Y 玻璃 DIP
 - Q 四边形封装

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成，例如：

HCMP 1824 C P

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商和产品类别：

HCMP 微处理器

HNVM 存储器

② 器件标号。

③ 性能表征。

④ 封装：

P 塑料 DIP，商业级（0~+70℃）

D 陶瓷 DIP，军品级（-55~+125℃）

Hybrid System Corp.

混合系统公司（美）

Hybrid Systems

该公司的产品型号由 4 部分组成，例如：

HSOP 37 G J

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商，可为 HS、DAC、SP、DA、HSOP（运算放大器）。

② 器件标号。

③ 使用温度范围：

C 商业级（0~+70℃）

M 军品级（-55~+125℃）

KN 商业级（0~+70℃）

KD 工业级（-25~+85℃）

SD 军品级（-55~+125℃）

J 商业级（0~+70℃）

K 工业级（-25~+85℃）

S 军品级（-55~+125℃）

对于 HSOP 器件，有：

A、B、C 军品级 (-55~+125℃)

E、F、G 工业级 (-25~+85℃)

④ 封装形式:

D 陶瓷 DIP

N 塑料 DIP

T TO-52 金属壳封装

J TO-99 金属壳封装

Z 玻璃 DIP

P 小型 DIP

Hybrid Memory Products Limited

混合存储器有限公司 (英)

该公司的产品型号由 3 部分组成, 例如:

HMV 44256 - 120

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商可为 HMV、HMS。

② 器件标号, 后面可加 1~2 个字母表示使用温度范围:

I 工业级 (-40~+85℃)

M 军品级 (-55~+125℃)

BS 军品级 (-55~+125℃)

HR 军品级 (-55~+125℃)

③ 最大存取时间, 单位 ns。

Hynix Semiconductor Inc. (Hynix)

海力士半导体公司 (韩)

<http://www.hynix.com>

该公司原名现代电子 (Hyundai Electronics), 其产品型号由 5 部分组成, 例如:

HY 51C256A L S 10



- ① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号，其中可以包含一个字母，以表明性能变化：
 - A 第 1 次改型
 - B 第 2 次改型
 - C 第 3 次改型
- ③ 使用温度范围：
 - 空 商业级，标准功耗
 - L 商业级（0~+70℃），低功耗
 - E 工业级（-40~+85℃），标准功耗
- ④ 封装形式：
 - S 300 密耳塑料 DIP
 - P 600 密耳塑料 DIP
 - F 无引脚芯片载体（J 型）封装
 - D 600 密耳陶瓷 DIP
- ⑤ 最大存取时间：
 - 10 100ns
 - 12 120ns
 - 15 150ns
 - 20 200ns

Data Device Corp. (DDC)

数据器件公司（美）

<http://www.ddc-web.com/>

该公司原名 ILC 数据器件公司（ILC Data Device Corp.），后改为现名，并使用新标志。其产品型号共有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成，例如：



BUS 66105 R

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示产品功能系列：

ADC	模数转换器
ADH	模数转（混合式）
API	模拟位置指示器
BUS	接口
DAC	数模转换器
DGL	可抗假信号的数模转换器
DRC	数字解算器
DSC	同步器
HFB	放大器 HSR
OSC	振荡器
PWR	电源器件
SDC	数字同步器
SH	取样-保持电路
TH	跟踪-保持电路

② 器件标号。

③ 可靠性：

R 高可靠性

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

DSC 544 H 1 R

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 功能类别，同第 1 类产品。

② 器件标号。

③ 输出电压和频率：

H 90V，360~440Hz（同步器）

- I 90V, 57~63Hz
 - 6 90V, 57~440Hz (同步器)
 - L 11.8V, 360~440Hz (同步器或分解器)
- ④ 使用温度范围:
- 1 -55~+85°C
 - 2 0~+70°C
- ⑤ 可靠性:
- R 高可靠性

Industria Mexicana Toshiba S.A. (Toshiba)

东芝墨西哥工业公司 (墨西哥)

<http://www.toshibalatino.com/mexico/>

TOSHIBA

该公司的产品型号由 4 部分组成, 例如:

TA **78005A** **C** **I**
 ① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 产品功能系列:

- TMM NMOS 存储器
- TC CMOS 存储器
- TCP CMOS 微处理器/控制器
- TMP CMOS 微处理器/控制器
- TA 线性电路

② 器件标号。

③ 封装形式:

- C 陶瓷封装
- D 玻璃 DIP
- F 扁平封装
- P 塑料 DIP
- J 塑封 (内引脚弯曲呈 J 型)

- T 有引脚端芯片载体塑料封装
- Z 分支交叉直插封装

④ 特性:

- I 工业级 (-40~+85℃)
- L 低功耗

Inmos Corp. (Inmos)

英莫斯公司 (英)

<http://www.inmos.com>

该公司现已于 1989 年并入意法半导体公司 (ST Microelectronics), 其产品型号由 5 部分组成, 例如:

IMS 1403 W 55 M

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 类别

- IMSG 颜色检查表
- IMST Transputor
- IMSC 转接器
- IMSB 计算板
- IMSD 开拓系统
- IMSP 开拓系统
- IMSA 数字信号处理系统
- IMSB 数字信号处理系统
- IMSD 数字信号处理系统

② 器件标号。

③ 封装形式:

- P 塑料 DIP
- S 陶瓷 DIP
- W 无引脚芯片载体陶瓷封装



- G 陶瓷栅格状排列封装
- J 有引脚芯片载体塑料封装

④ 最大存取时间:

- 10 100ns
- 25 25ns
- 35 35ns
- 55 55ns
- 70 70ns

⑤ 使用温度范围:

- M 军品级 (-55~+125°C)
- L 商业级 (0~+70°C)
- 空 商业级 (0~+70°C)

Inova Microelectronics Corp. (Inova)

奥沃微电子公司 (美)

该公司的产品型号由 7 部分组成, 例如:

S **128K** **8** **L** - **85** **M** **C**
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

① 产品系列:

- S 静态 RAM
- F 高速存储器

② 字数。

③ 每字比特数。

④ 芯片功耗:

- L 低功耗
- 空 标准功耗

⑤ 存取时间:

- 70 70ns
- 85 85ns

100 100ns

120 120ns

⑥ 使用温度范围:

C 商业级 (0~+70℃)

I 工业级 (-40~+85℃)

M 军品级 (-55~+125℃)

⑦ 封装形式:

C 陶瓷边铜焊 DIP

Integrated Device Technology (IDT)

IDT 公司 (美)

<http://www.idt.com>

该公司的产品型号由 6 部分组成, 例如:

IDT **7M856** **S** **55** **C** **B**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商和产品系列, 可为 IDT、ICS、MK、M、RC 和 SF。

② 器件标号。

③ 表示芯片功耗:

S 标准

L 低功耗

④ 芯片速度。

⑤ 封装形式:

P 塑料 DIP

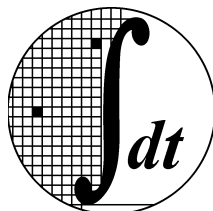
C 边铜焊 DIP

D 玻璃 DIP

L 无引脚芯片载体陶瓷封装

X 特殊封装

F 扁平封装



SO 小间距外引脚封装

⑥ 使用温度范围:

空 商业级 (0~+70℃)

B 军品级 (-55~+125℃)

按 MIL-STD-883B 标准筛选

Intel Corp. (Intel)

英特尔公司 (美)

<http://www.intel.com>

The Intel logo, consisting of the word "intel" in a lowercase, sans-serif font, followed by a large, bold, lowercase letter "i".

该公司的产品型号共有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成, 例如:

M **D** **2114** **L-4**

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示芯片等级:

M 军品级 (0~+70℃)

I 工业级 (0~+70℃)

J JAN 器件 (内部识别用), 按 M38510 编号 (0~+70℃)

L 工业级, 扩展到-40~+85℃

Q 商业级 (0~+70℃)

T 扩展到-40~+85℃

② 封装形式:

A 引脚阵列排列陶瓷封装

B 气密封装, B 型

C 气密封装, C 型

D 气密封装, D 型

N 有引脚芯片载体塑封

X 无包封

R 气密封装 (无引脚芯片载体封装)

G 气密封装（引脚阵列排列封装）

L 叠成薄片塑封

P 塑封

③ 器件标号，其中如有字母，则表明改型。

④ 功耗、速度、工艺说明。

注：对于军温器件，B 后缀是按 MIL-STD-883B 级标准筛选；C 后缀是按 MIL-STD-883C 级筛选；S 后缀是特殊规定；H 后缀为高可靠，所有器件都要经过辐射检查，以剔除不合格品。

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品由 5 部分组成，例如：

L D 27C128 - 200 V05
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，与第 1 类产品相同。

② 封装，与第 1 类产品相同。

③ 器件标号。

④ 最大存取时间：

150 150ns

170 170ns

200 200ns

250 250ns

⑤ 电源容差：

V05 ±5%

V10 ±10%

International CMOS Technology, Inc. (ICT)

国际 CMOS 技术公司（美）

该公司的产品型号由 5 部分组成，例如：

PEEL 18CV8 P C 25
① ② ③ ④ ⑤



各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商，可为 PEEL、ICT。
- ② 器件标号。
- ③ 封装形式：
 - P 塑封
 - C 陶瓷封装（3层）
 - T TO型外壳封装
 - L 无引脚芯片载体陶瓷封装
 - E、D 陶瓷封装
- ④ 使用温度范围：
 - 空 商业级（0~+70℃）
 - I 工业级（-20~+85℃）
- ⑤ 传输延迟，单位 ns。

International Microcircuits, Inc.
(IMI)

国际微电路公司（美）

<http://www.imicorp.com>

该公司已被赛普拉斯半导体公司（Cypress Semiconductors）收购，其产品型号由 8 部分组成，例如：

G **7** **1440** **B** **26** **Q** **Y** **L**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 电路工艺：
 - 4 金属栅 CMOS，单金属
 - 7 硅栅 CMOS，单金属
 - 9 硅栅 CMOS，双金属
- ③ 逻辑单元。



- ④ 改型标志：
 - A 首次设计
- ⑤ 专用与工作代号，其中 00 表示未指定。
- ⑥ 封装形式：
 - P 塑料封装
 - Q 陶瓷 DIP
 - R 芯片载体封装
 - S 特殊封装
 - T 无封装（管芯）
 - U 边焊封装
 - X 原型元件
- ⑦ 使用温度范围：
 - V 特殊
 - W 0~70℃
 - X 原型元件
 - Y -25~+85℃
 - Z -55~+125℃
- (8) 合格测试：
 - K 25℃时的全功能测试
 - L 专门测试/筛选
 - M 按 MIL-STD-883B, 5004 标准测试
 - X 原型

International Rectifier (IR)

IR 公司（美）

<http://www.irf.com>



该公司的产品型号由 2 部分组成，例如：

CPY 30AF

① ②

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示产品系列：

CPY 晶体管阵列
2N、IRFD MOS 管

② 器件标号，封装形式

HFAB HEXDIP (4 侧引脚)
AF TO-39 金属壳封装
AC TO-61 金属壳封装
AA TO-66 金属壳封装
空 TO-3 金属壳封装

Intersil Corporation(Intersil)

英特矽尔公司(美)

<http://www.intersil.com>



该公司前身为哈里斯(Harris)半导体公司，于1999年改为现名，为哈里斯公司的子公司。该公司的产品型号共有2种命名规则。

1. 第1类产品型号命名规则

该类产品型号由7部分组成，例如：

IM **6** **508** **A-1** **M** **D** **E**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商和产品系列：

D 驱动器
DG 驱动器(模拟开关)
G 多沟道场效应管
ICL 线性电路
ICM 手表和时钟电路
IH 混合/模拟门电路
IM 数字或存储器电路

② 工艺代号。

③ 器件标号。

④ 表示速度选择 (Z)、工作电压 (A) 或改进标志 (-1)。

⑤ 使用温度范围:

- A 55~+125°C
- B -20~+85°C
- C 商业级 (0~+70°C)
- I 工业级 (-40~+85°C)
- M 军品级 (-55~+125°C)

⑥ 封装形式:

- B 塑料扁平封装 (小型封装)
- D 陶瓷 DIP
- E 小型 TO-8 型外壳封装
- F 陶瓷扁平封装
- I 16 条外引脚 DIP, (0.6×0.7) 引脚间距
- J 陶瓷 DIP
- K 8 条外引脚 TO-3 金属管壳封装
- L 无引脚陶瓷封装
- P 环氧树脂 DIP
- Q 2 条外引脚金属管壳封装
- T TO-5 型外壳封装

⑦ 外引脚数:

- A 8
- B 10
- C 12
- D 14
- E 16
- N 18
- P 20
- F 22
- G 24
- I 28

J	32
K	36
L	40
M	48
V	8, 引脚间距 0.23 英寸
W	10, 引脚间距 0.23 英寸
Y	8, 引脚 4 接管壳
Z	10, 引脚 5 接管壳

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 6 部分组成, 例如:

IH **5043** **B** **M** **E** **D**
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 电性能。
- ④ 使用温度范围。
- ⑤ 封装形式, 同第 1 类产品。
- ⑥ 外引脚数, 同第 1 类产品。

IXYS Corp. (IXYS)

IXYS 公司 (美)

<http://www.ixys.com>



该公司的产品型号共由 5 部分组成, 例如:

IXDP **610** **D** **M** **B**
 ① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商和产品系列:

IXYS 数字 PWM 控制器

IXDP 开关电源

IXMS 双 PWM 控制器

IXTE 晶体管阵列

IXSE 外围接口

② 器件标号。

③ 封装形式：

D 瓷陶 DIP

P 塑料 DIP

L 无引脚芯片载体陶瓷封装

PS 陶瓷 DIP (宽 0.300 英寸)

DS 玻璃 DIP (宽 0.300 英寸)

④ 使用温度范围：

C 商业级 (0~+70℃)

L 工业级 (-40~+85℃)

M 军品级 (-55~+125℃)

⑤ 筛选方法：

空 标准

B 老化

JAN Nomenclature (JNC)

JAN 术语公司 (美)

该公司的产品型号由 6 部分组成，例如：

J **M38510** / **XXXX** **B** **C** **B**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，字母 J 或 JAN 表示 JAN 认可的器件。此前缀很重要的，如果无该标记则不是 JAN 器件。

② M38510 为军品级标记。

③ 器件标号。

④ 器件等级：

A 导弹和载人宇宙飞船用

- B 一般军品级
 - C 次要军事应用
- ⑤ 封装形式:
- A 1/4 英寸×1/4 英寸扁平封装, 14 条外引脚
 - B 1/8 英寸×1/4 英寸扁平封装, 14 条外引脚
 - C 1/4 英寸×3/4 英寸 DIP 式, 14 条外引脚
 - D 1/4 英寸×3/8 英寸扁平封装, 14 条外引脚
 - E 1/4 英寸×3/4 英寸 DIP 式, 16 条外引脚
 - F 1/4 英寸×3/8 英寸扁平封装, 16 条外引脚
 - G 10 引脚管壳
 - H 1/4 英寸×1/4 英寸扁平封装, 10 条外引脚
 - I 10 引脚管壳
 - J 1/2 英寸×5/4 英寸 DIP 式, 24 条外引脚
 - K 3/8 英寸×1/2 英寸扁平封装, 24 条外引脚
 - L 3/8 英寸×1/2 英寸扁平封装, 24 条外引脚
 - Z 1/4 英寸×3/8 英寸扁平封装, 24 条外引脚
- ⑥ 引脚光洁度:
- A 铁镍钴合金或 42 号合金, 热浸焊
 - B 铁镍钴合金或 42 号合金, 纯酸处理镀锡铂
 - C 铁镍钴合金或 42 号合金, 镀金铂
 - X 光洁度不限

Lansdale Semiconductor, Inc.
 (Lansdale)
 兰斯达勒公司 (美)

LANSDALE
Semiconductor, Inc.

<http://www.lansdale.com>

该公司的产品型号由 3 部分组成, 例如:

ML 7491A C
 ① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示制造厂商：

MC 摩托罗拉公司
HP 哈里斯公司
RM 雷锡昂半导体公司
SE 西格尼蒂克公司
S 西格尼蒂克公司

ML/HL/RL/SL 本公司

② 器件标号，其中字母表明改型。

③ 封装形式：

A 14 条外引脚扁平封装
B 14 条外引脚扁平封装
C 14 条外引脚 DIP
D 14 条外引脚 DIP
E 16 条外引脚 DIP
F 16 条外引脚 DIP
G 8 条外引脚壳形封装
H 10 条外引脚扁平封装
I 10 条外引脚壳形封装
J 24 条外引脚 DIP
K 24 条外引脚扁平封装
L 24 条外引脚 DIP
M 12 条外引脚壳形封装
P 8 条外引脚 DIP
Q 40 条外引脚 DIP
R 20 条外引脚 DIP
S 20 条外引脚 DIP
V 18 条外引脚 DIP
W 22 条外引脚 DIP

Lambda Americas, Inc. (Lambda)

兰姆达美国 (美)

<http://www.lambdapower.com>



该公司的产品型号由 3 部分组成, 例如:

LAS **6321** **P**
① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示芯片类别:

L 超压调节器

LAS 调节器

LPD 功率驱动器

PMD 分立器件

PMR 双整流器

② 器件标号。

③ 封装形式:

P 塑料 DIP

Lattice Semiconductor

Corp. (Lattice)

莱迪思半导体公司 (美)

<http://www.latticesemi.com>



该公司的产品型号由 9 部分组成, 例如:

GAL **16** **V** **8** - **25** **L** **D** **I** /**883**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示产品类别:

GAL 普通阵列逻辑

② 阵列输入端数。

③ 结构:

V 可变的

- ④ 器件输出端数。
- ⑤ 速度：
25 25ns
35 35ns
45 45ns
- ⑥ 芯片功耗：
L 半功耗
Q 1/4 功耗
空 标准
- ⑦ 封装形式：
P 塑料 DIP
D 陶瓷气密 DIP
C 陶瓷边铜焊封装
S 小型封装
V 芯片包封
J 有引脚芯片载体塑料封装
R 无引脚芯片载体陶瓷封装
L 无引脚芯片载体封装
- ⑧ 使用温度范围：
空 0~+70℃
I 40~+85℃
M -55~+125℃
- ⑨ 筛选方法：
空 标准
/883 按 MIL-STD-883 标准筛选

LG Electronics (LG)

LG 电子公司 (韩)

<http://www.lge.com>

该公司原名金星半导体公司, 1995 年



改为现名。其产品命名方法请参见金星半导体公司产品命名方法。

Linear
Corporation(Linear)
凌力尔特公司(美)

Technology



<http://www.linear.com>

该公司的产品型号由 4 部分组成，例如：

LT **1001A** **C** **H**
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 工艺：

LT	线性
LF/LH/LM	交流源到 NSC
OP	交流源到 PMI
SG	交流源到硅
UC	交流源到 Unitrode

② 器件标号。

③ 使用温度范围：

C	商业级 (0~+70℃)
M	军品级 (-55~+125℃)

④ 封装形式：

D	边铜焊 DIP
H	TO-5 或 TO-46 外壳封装
J	陶瓷 DIP
K	TO-3 外壳封装
N	DIP
S	小型封装
P	3 条外引脚 TO-247 外壳封装
T	3 或 5 条外引脚 TO-220 外壳封装
Z	2 或 3 条外引脚 TO-92 外壳封装

Logic Devices Inc.

逻辑器件公司(美)

<http://www.logicdevices.com>



该公司的产品型号由 6 部分组成, 例如:

L RF08 J C B - 1
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 封装形式:
 - D 气密 DIP
 - P DIP
 - X 无引脚芯片载体陶瓷封装
 - G 引脚阵列排列封装
 - L 有引脚芯片载体封装
 - J 芯片载体塑料封装
 - C 陶瓷 DIP
 - F 扁平封装
- ④ 使用温度范围:
 - C 商业级 (0~+70°C)
 - M 军品级 (-55~+125°C)
- ⑤ 筛选等级:
 - 空 商业级
 - B 高可靠
 - R 在 125°C 下老化 48 小时
 - T 定制
 - E 筛选扩展
- ⑥ 特性/速度等级标志

LSI Logic Corporation (LSI)

LSI 公司(美)

<http://www.lsi.com>



该公司的产品型号共由 5 部分组成, 例如:

L 64210A G M B

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂家。
- ② 器件标号，其中字母 A 表明改型。
- ③ 封装形式：
 - G 引脚阵列排列封装
 - D 陶瓷 DIP
 - L 无引脚芯片载体陶瓷封装
 - J 有引脚芯片载体塑料封装
- ④ 使用温度范围：
 - M 军品级（-55~+125℃）
 - C 商业级（0~+70℃）
- ⑤ 筛选等级
 - 空 标准筛选
 - B 按 MIL-STD-883C 标准筛选

Marconi Electronic
Devices, Inc. (Marconi)
马可尼电子器件公司 (美)
<http://www.mitel.com>

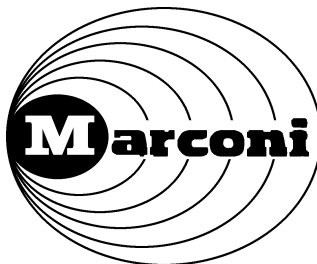
该公司已并入米特尔 (Mitel) 公司，
原标志停用。该公司的产品型号由 4 部分
组成，例如：

MA S 6167F GC

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 抗辐射容限
 - 空 无容限



- S 辐射加固
- R 抗 100 千拉德辐射
- Q 抗 300 千拉德辐射
- H 抗 1000 千拉德辐射

③ 器件标号、封装形式，其中：

- C 陶瓷 DIP
- F 扁平封装
- L 无引脚芯片载体封装
- N 芯片包封
- A 引脚栅格状排列封装

④ 使用温度范围、筛选方法或工艺处理：

使用温度范围：

- GB 商业级 (0~+70℃)
- GC 军品级 (-55~+125℃)
- GF 工业级 (-40~+85℃)
- GE -20~+85℃

筛选方法：

- B1 B 级
- B9 B 级+SEM 检查和 PND 筛选
- S0 S 级
- 82 S 级

工艺处理 (ESA/SCC9000)：

- T1 B 级, Lat1
- T2 B 级, Lat2
- T3 B 级, Lat3
- T4 C 级, Lat1
- T5 C 级, Lat2
- T6 C 级, Lat3

Matra-Harris Semiconductor SA (MHS)

麦特莱-哈里斯半导体公司（法）



该公司现名为 MHS 公司。原产品型号共有 4 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

H **M** **1** **65231** - **2**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 产品系列：

- A 模拟电路
- C 通信电路
- D 数字电路
- I 接口电路
- M 存储器
- S CICD
- V 模拟（高压）电路
- Y 模拟混合电路
- PL 可编程逻辑

注：HPROM X-0512-X 除外。

③ 封装形式：

- 0 芯片
- 1 陶瓷 DIP
- 2 TO-5 金属壳封装
- 3 塑料 DIP
- 4 无引脚芯片载体陶瓷封装
- 5 陶瓷基片混合封装
- 7 小型陶瓷 DIP
- 9 扁平封装
- 1B 边铜焊封装

④ 器件标号，其中可以包含一个字母，为改型标志。

⑤ 使用温度范围：

- 1 0~+200℃
- 2 -55~+125℃
- 4 -25~+85℃
- 5 0~+75℃
- 6 100%25℃探针（仅适用芯片封装）
- 7 高可靠民品（0~+75℃）
- 8 MIL-STD-883B 标准
- 9 -40~+85℃
- 9+ -40~+85℃带老化

KH 抗辐射加固

2. 第2类产品（存储器和通信电路）型号命名规则

该类产品型号由6部分组成，例如：

H **M** **1** **65261** **B** - **2**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 产品系列：

C 通信

M 存储器

③ 封装形式：

0 芯片

1 陶瓷封装

3 环氧树脂封装

4 无引脚芯片载体陶瓷封装

5 基片和无引脚组装

④ 器件标号。

⑤ 改型标志：

B 高速（低功耗）

- C 扩展改型
- 空 标准产品
- S 高速（高功耗）
- H 25ns
- K 35ns
- M 45ns
- N 55ns

⑥ 使用温度范围：

- 2 -55~+125℃
- 5 0~+70℃
- 6 100%25℃探针（仅适合芯片包封）
- 9 -40~+85℃

3. 第3类产品（微处理器、微控制器、外设电路）型号命名规则

该类产品型号由5部分组成，例如：

M **D** **8086** - **B**
 ① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 使用温度范围：

- 空 民品
- I 工业级（-40~+85℃）
- M 军品级品（-55~+125℃）
- X 在25℃下，芯片包封探针

② 封装形式：

- C 边铜焊封装
- D DIP
- G 引脚阵列（栅格）排列封装
- P 塑封
- R 无引脚芯片载体陶瓷封装
- X 芯片包封

③ 器件标号。

- ④ 频率范围。
- ⑤ 多种性能标志。

4. 第 4 类产品（门阵列）型号命名规则

该类产品型号由 7 部分组成，例如：

M A 1 C - 1200 A05 - 2
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 表示产品系列。
- ③ 封装形式：
 - 0 芯片
 - 1 陶瓷封装
 - 3 环氧树脂封装
 - 4 无引脚芯片载体陶瓷封装
 - C 边铜焊自插式 DIP 封装
 - 8 引脚阵列-栅格状排列封装

④ 引出端数：

A	8
B	14
C	40
D	64
E	16
F	18
G	20
H	22
I	28
J	32
K	48
L	44

M	68
R	84
T	100
U	120
V	144

⑤ 门数。

⑥ 定制规范。

⑦ 使用温度范围：

2	-55~+125℃
5	0~+70℃
6	25℃探针
9	-40~+85℃

Master Logic

马斯特逻辑公司（美）

该公司的产品型号由 4 部分组成，例如：

ML **150** **P** - **24**
 ① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 产品系列：

MT	CMOS 门阵
MLA	CMOS 定制
F	其他

② 门数：

50	50 门
75	75 门
100	100 门
150	150 门
200	200 门
350	350 门

③ 封装形式:

P 陶瓷封装
CD DIP
SB 边铜焊封装

④ 外引脚数。

Matsushita Electronic Industrial Co.Ltd.

(Panasonic)

松下电器产业株式会社(日)

<http://panasonic.co.jp>

该公司的产品型号由 4 部分组成, 例如:

MN 41256A J 08
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 可为 DN、AN、MN、AMS
- ② 器件标号, 其中字母 A 为改型标志。
- ③ 封装形式:

N DIP
R SIP
J 芯片载体封装
H、M 组件
SM、S 小型封装
空 塑料 DIP

④ 最大存取时间:

08 80ns
10 100ns
12 120ns
15 150ns



Panasonic

Maxim Integrated Products ,Inc. (Maxim)

美信集成产品公司 (美)

<http://www.maxim-ic.com>



该公司的产品型号共有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

AD **7574K** **C** **/W** **N**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 产品系列：

AD	转换器，电压参考源，模拟开关
ICL	线性电路和模数转换器
REF	电压参考源
MP	乘法数模转换器
OP	运算放大器
DG	模拟多路转换器
HI	模拟多路转换器
MM	模拟开关和显示驱动器
MG	开关电容器滤波器
BB	缓冲放大器（电压跟随器）
LH	放大器
MAX	一般分类

② 器件标号，其中字母表明改型。

③ 使用温度范围：

C	商业级（0~+70℃）
I	-20~+85℃
E	工业级（-40~+85℃）
M	军品级（-55~+125℃）

④ 封装形式：

- A SSOP (缩小外形封装) 209 密耳 (14, 16, 20, 24, 28 引脚);
300 密耳 (36 引脚) TO-237 外壳封装
- B UCSP (超小型晶片级封装)
- C 塑料 TO-92; TO-220
- C LQFP 1.4mm (7mm × 7mm 过孔 20mm × 20mm)
- C TQFP 1.0mm (7mm × 7mm 过孔 20mm × 20mm)
- D 陶瓷边铜焊 300 密耳 (8, 14, 16, 18, 20 引脚); 600 密耳
(24, 28, 40, 48 引脚)
- E QSOP (1/4 小外形封装)
- F 陶瓷扁平封装
- G 金属外壳 (金)
- G QFN (塑料、薄型、四边扁平封装, 无引脚冲压) 0.9mm
- H SBGA (超级球栅阵列 θ)
- H TQFP 1.0mm 5mm × 5mm (32 引脚)
- H TSSOP (薄型缩小外形封装) 4.4mm (8 引脚)
- J CERDIP (陶瓷 DIP) (N) 300 密耳 (8, 14, 16, 18, 20 引
脚); (W) 600 密耳 (24, 28, 40 引脚)
- K SOT 1.23mm (8 引脚) TO-3 外壳封装
- L LCC (陶瓷无引线芯片载体) (18, 20, 28 引脚)
- L FCLGA (倒装芯片、基板球栅阵列); 薄型 LGA (薄型基板
球栅阵列) 0.8mm
- L μ DFN (微型双列扁平封装, 无引线) (6, 8, 10 引脚)
- M MQFP (公制四边扁平封装) 高于 1.4mm; ED-QUAD (28mm ×
28mm 160 引脚) 塑料 DIP (小尺寸封装)
- N PDIP (窄型塑料 DIP 封装) 300 密耳 (24, 28 引脚)
- P PDIP (塑料 DIP 封装) 300 密耳 (8, 14, 16, 18, 20 引脚);
600 密耳 (24, 28, 40 引脚)
- Q PLCC (塑料陶瓷无引线芯片载体)
- R CERDIP (窄型陶瓷 DIP 封装) 300 密耳 (24, 28 引脚)
- S SOIC (窄型塑料小外形封装) 150 密耳

T	金属外壳 (镍), TO-5 (或 TO-78, TO-99, TO-100) 外壳封装
T	TDFN (塑料、超薄、双列扁平封装, 无引线冲压) 0.9mm (6, 8, 10 & 14 引脚)
T	薄型 QFN (塑料、超薄、四列扁平封装, 无引线冲压) 0.8mm
TQ	薄型 QFN (塑料、超薄、四列扁平封装, 无引线冲压) 0.8mm (8 引脚)
U	SOT 1.23mm (3, 4, 5, 6 引脚)
U	TSSOP (薄型缩小外形封装) 4.4mm (14, 16, 20, 24, 28, 38, 56 引脚); 6.1mm (48 引脚)
U	μ MAX (薄型缩小外形封装) 3mm \times 3mm (8, 10 引脚)
V	U.TQFN (超薄 QFN-塑装、超薄四边扁平, 无引线冲压) 0.55mm
W	SOIC (宽型、塑料小外形封装) 300 密耳
W	WLP (晶片级封装)
X	CSBGA 1.4mm
X	CVBGA 1.0mm
X	SC70
Y	SIDEBRAZE (窄型) 300 密耳 (24, 28 引脚), 超薄 LGA 0.5mm
Z	薄型 SOT 1mm (5, 6, 8 引脚)

⑤ 外引脚数:

A	8
B	10
C	12
D	14
E	16
F	22
G	24
H	44
I	28
J	32
K	35

L	40
M	48
N	18
P	20
Q	2
R	3
S	4
T	6
U	60
V	8 (引脚壳周长 0.2 英寸, 隔离外壳), 30, 169
W	10 (引脚壳周长 0.22 英寸, 隔离外壳), 169
X	36, 45
Y	8 (引脚壳周长 0.2 英寸, 外壳接引脚 4), 52
Z	10 (引脚壳周长 0.23 英寸, 外壳接引脚 5), 26, 72

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成, 例如:

MAX 400 C P A
 ① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商。

② 器件标号:

100~199	模数转换器
200~299	接口
300~399	模拟开关和多路转换器
400~499	运算放大器, 缓冲器和视频放大器
500~599	数模转换器
600~699	电源和电压调节器
700~799	外设电路和显示驱动器
800~899	不限定
900~999	不限定

- ③ 使用温度范围：
 - C 商业级 (0~+70℃)
 - I -20~+85℃
 - E 工业级 (-40~+85℃)
 - M 军品级 (-55~+125℃)
- ④ 封装形式 (同第 1 类产品)。
- ⑤ 外引脚数 (同第 1 类产品)。

MCE Semiconductor, Inc. (MCE)

MCE 半导体公司 (美)

该公司的产品型号由 5 部分组成, 例如:

MCE LM567 D 08 C

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 封装形式:
 - D 陶瓷 DIP
 - M TO-99 金属壳封装
 - P 塑料 DIP
 - H 8 条外引脚 TO-99 金属壳封装
 - A 芯片包封
 - SP 小型封装
 - VT 16 端无引脚芯片载体封装
- ④ 外引脚数。
- ⑤ 使用温度范围:
 - C 商业级 (0~+70℃)
 - M 军品级 (-55~+125℃)

Micrel Semiconductor,

Inc. (Micrel)

麦瑞半导体公司 (美)

<http://www.micrel.com>



该公司的产品型号由 3 部分组成, 例如:

MIC **2833A** **N**

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 器件标号, 其中字母 A 为改型标志。
- ③ 封装形式:

N 或 P DIP 封装

Micra Corp.

密克莱公司 (美)

<http://www.craneco.com>



该公司先并入 Interpoint 公司, 后来再次并入克瑞 (Crane) 集团公司。

其产品型号由 4 部分组成, 例如:

MC **0021** **C** **H**

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 使用温度范围:
 - 空 军品级 (0~+125°C)
 - C 工业级 (-25~+85°C)

④ 封装形式:

D 边铜焊 DIP
G TO-8 金属壳封装
H TO-5 金属壳封装

- K TO-3 金属壳封装
- X 专用

Micro Linear Corp. (Micro-Linear)
微线性器件公司 (美)
<http://www.microlinear.com>



该公司的产品型号由 5 部分组成, 例如:

ML 2110 B C P
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 性能等级。
- ④ 使用温度范围:
 - C 商业级 (0~+70℃)
 - I 工业级 (-40~+85℃)
 - M 军品级 (-55~+125℃)
- ⑤ 封装形式:
 - D 边铜焊 DIP
 - F 扁平封装
 - J 陶瓷气密 DIP
 - L 无引脚芯片载体陶瓷封装
 - P 塑料 DIP
 - Q 有引脚芯片载体塑料封装
 - S 小型封装

Micro Networks Corp. (MNC)
微网络公司 (美)
<http://www.mnc.com>



该公司现属 IDT 公司 (Integrated



Device Technology), 其产品型号由 6 部分组成, 例如:

MN **5250** **A** **CL** **H** **B**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商。

② 器件标号。

③ 改型标志。

④ 封装形式:

FP 扁平封装

CD 陶瓷 DIP

PD 塑料 DIP

TC TO 型金属壳封装

CL 陶瓷无引脚封装

LC 无引脚芯片载体陶瓷封装

LP 有引脚芯片载体塑料封装

⑤ 使用温度范围:

空 0~+70°C

B -25~+85°C

F -55~+85°C

G -55~+100°C

H -55~+125°C

⑥ 筛选方法:

空 按本公司工艺并老化

B 100%筛选, 按 MIL-STD-883, 5008 标准筛选

Micropac Industries, Inc. (MICROPAC)

微派斯工业公司 (美)

<http://www.micropac.com>

该公司的产品型号共由 2 部分组成, 例如:



MIOV 52142 15

- ① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，常见前缀的有：MIOV，MLN，M，MLM，MLA，MIVIR。
- ② 器件标号。
- ③ 输出电压。对于电压调节器而言，它表明输出电压值。

Micro Power Systems, Inc.

微型电源系统公司（美）

<http://www.exar.com>



该公司属于埃克萨集成系统公司（Exar Integrated Systems, Inc.），其产品型号共由 4 部分组成，例如：

MP 5537 C J

- ① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商，MP，OP，MPREF，MPINA，MPVFC。
- ② 器件标号。
- ③ 使用温度范围：

C/E/H/D 商业级（0~+70℃）

F 工业级（-25~+85℃）

J/B/A/G/S/M 军品级（-55~+125℃）

- ④ 封装形式：

D 陶瓷 DIP

Z/Y/Q DIP

L 无引脚芯片载体陶瓷封装

J TO-99 外壳封装

T TO-52 外壳封装

K TO-100 外壳封装

Micron Technology, Inc. (Micron)

美光科技公司 (美)

<http://www.micron.com>



该公司的产品型号由 5 部分组成, 例如:

MT **5C2564** **DJ** **25** **L**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商。

② 器件标号。

③ 封装形式:

W 陶瓷 HP (600 密耳)

C 陶瓷 DIP (300 密耳)

CW 陶瓷 DIP (600 密耳)

DJ 小型塑料 (300 密耳)

EC 无引脚芯片载体陶瓷封装

空 塑料 DIP (300 密耳)

④ 最大存取时间:

25 25ns

30 30ns

35 35ns

45 45ns

55 55ns

⑤ 保持能力:

L 2V 保持能力

Mikro Elektronik

米克罗电子公司 (德)

该公司的产品型号共有 2 种命名规则, 现分别举例说明如下:

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成, 例如:

D 195 D

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示产品类别：

A、B、C 模拟电路

D、DL、DS、E、P 双极型数字电路

U、UA、UB、VB、V 非双极数字电路

② 器件标号。

③ 封装形式：

D DIP

G 组件

2. 第2类产品型号命名规则

该产品型号由2部分组成，例如：

TDA 2030H

① ②

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，有TDA、TBA、TAA。

② 器件标号。

Mitel Semiconductor (Mitel)

敏迪半导体公司（加）

<http://www.mitel.com>



该公司的产品型号由4部分组成，例如：

MD 4330 B E

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 产品类别：

MA 阵列

MD 数字电路

MH 混合电路

- ML 线性电路
- MT 通信电路
- CM 组件
- ② 器件标号。
- ③ 改型标志：
 - A 改进型
 - B 标准型
- ④ 封装形式：
 - C 陶瓷 DIP
 - D 陶瓷 DIP 边铜焊
 - E 塑料 DIP
 - H 芯片包封
 - Y 无引脚芯片载体陶瓷封装

Mitsubishi Electric Corp. (Mitsubishi)
三菱公司 (日)

<http://www.mitsubishi.com>

1. 自行研制的产品型号命名规则

该产品型号由 6 部分组成，例如：

M **5** **1** **99** **A** **P**
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 使用温度范围：
 - 5 工业级/商业级 (-20~+75℃)
 - 9 高可靠
- ③ 工艺或电路类别：
 - 0 CMOS 电路
 - 1 线性电路
 - 3 TTL 电路



10~19	线性电路
32~33	TTL (相当于德州仪器公司的 T1SN74 系列)
41~47	TTL, 其他电路
48~49	I ² L 电路
84	CMOS 电路
85	P 沟硅栅 MOS 电路
86	P 沟铝栅 MOS 电路
87	N 沟硅栅 MOS 电路
88	P 沟铝栅 EDMOS 电路
89	CMOS 电路
S0~S2	肖特基 TTL 电路 (相当于 T1SN74S 系列)

④ 序号, 由 2 位数字构成, 表明电路系列类型。

⑤ 改进型标志, 用单个字母表明外形的不同, 或者对一些产品进行说明: 对于线性电路, 选定一个字母 (不包括 I 和 O 在内, 因这 2 个字母被用来标志特性不同的一些产品);

对于特性相同, 仅仅外引脚功能端排列顺序有差别的, 则用 R 来表示; 如果不需要改进型标志, 那么就不加该部分相应字母, 后边的项前移。

⑥ 封装形式:

B	树脂密封陶瓷封装
K	低温玻璃密封陶瓷封装
L	塑料 SIP
S	陶瓷封装
T	圆壳玻璃金属密封封装 (类似于 TO-3 封装)

2. 仿制产品型号命名规则

该类产品型号由 6 部分组成, 例如:

M **5** **K** **4116** **S** - **2**
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 使用温度范围:

- 5 工业或商业级 (0~+70°C/75°C或-20~+85°C)
- 9 高可靠产品
- ③ 仿制公司产品标志:
- C 摩托罗拉公司 MC 系列
- G 通用仪器公司系列
- K 莫斯特卡公司 MK 系列
- L 英特尔公司系列
- T 得州仪器公司 TMS 系列
- W 西部数据公司系列
- ④ 器件标号, 表示芯片电路功能, 采用被仿制公司的标号。
- ⑤ 封装形式:
- K 玻璃陶瓷密封
- P 塑料封装
- S 金属陶瓷密封
- ⑥ 电特性, 由 1~2 位数组成。

Mitsubishi Mitsubishi Electric America, Inc. (Mitsubishi)

美国三菱电子公司 (美)

<http://www.mitsubishichips.com>

该公司的产品型号由 7 部分组成, 例如:

M 5 M 5255 FP 70 LL

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 使用温度范围:
- 5 工业/商业级 (0~70/75°C, -20~+85°C)
- 9 高可靠
- ③ 该类产品原生产厂家
- A 先进微器件公司
- C 摩托罗拉 MC 系列



- E 西格尼蒂克公司（英）
- F 飞兆公司
- G 通用仪器公司
- K 莫斯泰克公司 MK 系列
- L 英特尔公司
- M 三菱公司（日）Mitsubishi
- N 国家半导体公司
- R 雷声公司
- T 得州仪器公司，TMS 系列
- W 西部数据公司系列

④ 器件标号，其中的字母表示改进型。

⑤ 封装形式：

- P 塑料 DIP
- KP 塑料 DIP
- RV 小型封装
- VP 小型封装
- FP 扁平封装

⑥ 最大存取时间。

⑦ 维持电流

- L 50 μ A（最大）
- LL 20 μ A（最大）

Monolithic Memories Inc. (MMI)

单片存储器公司（美）

<http://www.amd.com>



该公司现已并入先进微器件公司（Advanced Micro Devices, Inc.），其产品型号共有 4 种命名规则，现分别举例说明如下：

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 7 部分组成，例如：

PAL 14 L 4 M J 883B

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

- ① 表示芯片系列：

PAL 可编程序阵列逻辑

HAL 硬阵列逻辑

- ② 阵列输入数。

- ③ 输出类型：

H 高电平

L 低电平

C 互补

R 寄存

X 专有或寄存

- ④ 输出数。

- ⑤ 使用温度范围：

C 商业级

M 军品级

- ⑥ 封装形式：

J 陶瓷 DIP

N 塑料 DIP

D 边焊陶瓷 DIP 式封装

F 扁平封装

W 陶瓷封装

L 无引脚封装

- ⑦ 筛选等级：

883B 按 MIL-STD-883B, 5004 和 5005B 级筛选

883C 按 MIL-STD-883, 5004 和 5005C 级筛选

B 按 MIL-STD-883, 5004 和 5005 筛选

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 6 部分组成，例如：

SN 54 LS 373 J 883B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 使用温度范围：

74 商业级

54 军品级

③ 表示芯片系列：

S 肖特基

LS 低功耗肖特基

NICR PROMS、ROMS 字符发生器逻辑

④ 器件标号。

⑤ 封装形式，同第 1 类产品。

⑥ 筛选等级，同第 1 类产品。

3. 第 3 类产品型号命名规则

该类产品型号由 6 部分组成，例如：

5 3 41 - 1 J **883B**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 使用温度范围：

6 商业级

5 军品级

② 产品类别：

0 字符发生器 O.C

1 字符发生器 T.S

2 ROM

③ 器件标号。

④ 表示芯片系列。

⑤ 封装形式，同第 1 类产品。

⑥ 筛选方法，同第 1 类产品。

4. 第 4 类产品型号命名规则

该类产品型号由 9 部分组成，例如：

5 3 S 2 4 0 A J 883B
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

各部分字母和数字含义如下。

① 使用温度范围：

6 商业级

5 军品级

② 产品类别：

3 PROM

③ 芯片系列：

S 肖特基

LS 低功耗肖特基

RX 寄存

④ 存储容量：

1 1 024bit

2 2 048bit

4 4 096bit

8 8 192bit

16 16 384bit

⑤ 输出数：

4 4bit

8 8bit

⑥ 输出类型：

0 集电极开路

1 三态

⑦ 性能：

空 标准型

A 增强型

⑧ 封装形式，同第 1 类产品。

⑨ 筛选等级，同第 1 类产品。

Mosel Vitelic Corp. (MVC)

茂矽电子公司(美)

<http://www.mvc.com>



该公司的产品型号由 8 部分组成，例如：

Y 51 C 256 C 12 L I
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。第 1 部分 数字含义
 - 51 动态 RAM
 - 53 动态 RAM
 - 61 静态 RAM (快速)
 - 62 静态 RAM (慢速)
- ③ 器件标号第 2 部分 字母 C 表示 CMOS 工艺
- ④ 器件标号第 3 部分 数字表明编号
- ⑤ 封装形式：
 - C 陶瓷 DIP
 - T 膜状 DIP
 - D 陶瓷 DIP
 - P 塑料 DIP
 - S 膜状塑料 DIP
 - G 无引脚芯片载体陶瓷封装
 - J J 引脚芯片载体封装
 - L 带鸥翼的引脚芯片载体封装
 - K 窄间距 (内引脚弯曲成丁状) 封装
 - F 小型扁平封装
 - Z 分支交叉直插封装
 - Y 分支交叉直插陶瓷封装

- P SIP
- U 引脚阵列排列封装（槽向上）
- V 引脚阵列排列封装（槽向上）
- X 芯片包封

⑥ 最大存取时间:

⑦ 表示芯片功耗:

空 标准

L 低功耗

⑧ 使用温度范围:

空 商业级 (0~+70℃)

I 工业级 (-40~+85℃)

M 军品级 (-55~+125℃)

Motorola Semiconductor Products, Inc. (Motorola)

摩托罗拉公司半导体部 (美)

该公司于 2004 年分拆, 成立了飞思卡尔半导体公司 (Freescale Semiconductor, Inc), 并使用新商标, 产品名方法不变。该公司的产品型号共有 4 种命名规则。



1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成, 例如:

MLM 3415 F M

① ② ③ ④



各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商和芯片功能:

- MC 封装电路
- MCC 没封装的电路芯片
- MFC 专用功能电路, 采用低成本塑料封装 (末位无封装标志)
- MCBC 梁式引脚电路芯片
- MOB 包封后的梁式引脚电路(当扁平封装时型号末位用 F 表示)

MCCF	倒片式线性集成电路
MLM	等效于国家半导体公司生产的集成电路（外引脚功能端排列顺序相同）
MCH	密封式混合集成电路
MHP	塑封混合集成电路

② 器件标号:

1500~1599	线性集成电路, 军品级 (-55~+125°C)
1400~1499 和 3400~3499	线性集成电路, 工业级 (0~+70°C)
1300~1399 和 3300~3399	消费类线性集成电路

③ 封装形式:

L	陶瓷 DIP (14 或 16 条引脚)
G	金属圆壳封装 (TO-5)
R	金属功率封装 (TO-66)
K	金属功率封装 (TO-3)
F	扁平封装
P	塑料封装
C	DIP
J	窄间距塑封
Z	“之”字形串联 (交叉) 塑封
R	金属功率封装 (TO-66)
T	塑封 (TO-220)
U	陶瓷封装

PQ 交错引脚排列塑封 DIP (仅适用消费类产品)

P₁、P₂ 适用于各种封装, 如: P₁=8 条引脚塑料 DIP, P₂=14 条引脚塑料 DIP。

④ 使用温度范围:

C	工业级 (-40~+85°C)
A、M	军品级 (-55~+125°C)

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成, 例如:

MLM **100422** **L** **10**

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，同第 1 类产品。
- ② 器件标号，同第 1 类产品。
- ③ 封装形式，同第 1 类产品。
- ④ 最大存取时间：

10 10ns

30 300ns

35 350ns

3. 第 3 类产品（微处理机 MC6800 系列）型号命名规则

该类产品型号由 6 部分组成，例如：

MC **68** **A** **59** **C** **L**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② MC6800 系列。
- ③ 芯片速度：

空 1.0MHz

A 1.5MHz

B 2.0MHz

- ④ 器件标号。
- ⑤ 使用温度范围：

空 0~+70℃

C -40~+85℃

- ⑥ 封装形式：

L 陶瓷封装

4. 第 4 类产品型号命名规则

该类产品型号由 2 部分组成，例如：

2N **5146**

① ②

组成该类产品型号的字母和数字含义如下。

- ① 前缀，有 2C、2N、TL、MF、MC、MW、LM、MM、MP、TD、LF、MH、IK。
- ② 器件标号。

Mostek

莫斯泰克公司（美）

<http://www.st.com>

MOSTEK

该公司在 20 世纪 80 年代中期被 SGS 汤姆逊公司（SGS Thomson），即现在的意法半导体公司（STMicroelectronics）收购。其产品型号由 3 部分组成，例如：

MK **4116** **P**

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 封装形式：
 - E 无引脚芯片载体陶瓷封装
 - J 陶瓷 DIP
 - K 锡边焊陶瓷 DIP 式封装
 - N 环氧树脂 DIP 式封装
 - P 金边焊陶瓷 DIP 式封装
 - T 具有透明盖板的陶瓷 DIP 式封装

Mullard Ltd. (Mullard)

大盾公司（英）

<http://www.rell.com>

该公司现属理察森电子公司（Richardson Electronics, Ltd.）。其产品型号共由 6 部分组成，例如：



S 54 LS 174 P B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片系列：

PC 高速 CMOS

N 标准 TTL

S 标准 TTL

② 使用温度范围：

54 -55~+125℃ (仅对陶瓷 DIP)

74 标准温度范围, -40~+85℃或-40~+125℃

③ 工艺类别：

HC CMOS 输入开关电平, 电源电压 2~6V, 缓冲

HCT TTL 输入开关电平, 电源电压 4.5~5.5V, 缓冲

HCV CMOS 输入开关电平, 电源电压 2~6V, 非缓冲

LS 低功耗肖特基 TTL

S 肖特基 TTL

H 高速 TTL

④ 器件标号。

⑤ 封装形式：

D 陶瓷 DIP

P 塑料 DIP

T 小型塑封

⑥ 筛选方法：

B 工业级, 老化

MX-COM, Inc. (MX-COM)

MX-COM 公司 (美)

<http://www.cmlmicro.com>

该公司现名为 CML 微电路公司
(CML Microcircuits), 是英国 CML 微



系统控股公司（CML Microsystems Plc.）的子公司。该公司的产品型号共由 3 部分组成，例如：

MX **204** **LH**
① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 封装形式：

LH 芯片塑封
P 塑料 DIP
J 陶瓷 DIP
L 扁平 4 引脚封装
Q DIP
LV1 小型 4 引脚封装

National Semiconductor (NS)
国家半导体公司（美）
<http://www.national.com>



该公司产品型号共有 3 种命名规则，现分别举例叙述如下：

1. 老产品型号命名规则（1989 年前产品）

该类产品型号由 4 部分组成，例如：

LF **356** **N** / **A+**
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 表示芯片系列：
 - ADC 模数转换器
 - AEE 微型计算机产品
 - AF 有源滤波器
 - AH 模拟开关（混合）
 - ALS 先进低功耗肖特基电路

AM	模拟开关（单片）
BLC	插件板级计算机
BLX	插件板级扩展
CD	CMOS（仅 4000 系列）
COP	微型控制器系列
DAC	数模转换器
DH	数字器件（混合）电路
DM	数字（多片）电路
DP	接口（微处理器）
DS	接口
FOR	光纤接收机
FOT	光纤发射机
HC	高速 CMOS
IDM	微处理器（2901）
IMP	微处理器（IMP）
INC	微处理器（4004/8080A）
IPC	微处理器（PACE）
ISP	微处理器（SC/MP）
JM	MIL-M38510
LF	线性（BI-FET）电路
LH	线性（混合）电路
LM	线性（单片）电路
LP	线性低功耗电路
LX	传感器（压力和温度）
MA	时钟组件
MH	MOS（混合）
MM	CMOS（单片）
NH	混合
NSA	LED 数字阵列
NSB	LED 数字（4bit/5bit）电路

NSC	LED 管芯（或芯片）
NSC	微处理器 1600, 800
NSL	LED 灯
NSL	光学器件
NSM	LED-集成显示组件
NSN	LED 数字（2bit）
NSW	LED 手表电路管芯, PNP, NPN, ZN
RA	电阻器阵列
RMC	装架计算机
SD	专用数字器件
SF	专用场效应管
SFW	软件
SH	专用混合电路
SK	专用组件
SL	专用线性电路
SM	专用 MOS 电路
SN	数字（附属厂产品）电路
SPM	开发系统
SPX	开发系统
SZ	专用传感器
TBA	线性（第 2 源）电路
TDA	线性电路
TP	电信产品
TRC	音频接收机插件板

② 器件标号, 如该部分包含 A 或 C 字母, 其含义为:

- A 改进型
- C 商业级

③ 封装形式:

- D 玻璃/金属 DIP 式封装
- F 玻璃/金属扁平封装（1/4 英寸×1/4 英寸）

F	00 标准引脚形式的玻璃/金属扁平式封装
F	01 标准引脚形式的玻璃/金属扁平式封装
F	06 标准引脚形式的玻璃/金属扁平式封装
F	07 标准引脚形式的玻璃/金属扁平式封装
G	12 引脚 TO-8 圆壳封装
H	多头引脚圆壳封装
H-05	4 引脚圆壳 (TO-5) 封装
H-46	4 引脚圆壳 (TO-46) 封装
J	低温度 DIP 式陶瓷封装 (也称玻璃密封封装)
J-8	8 引脚 DIP 式陶瓷封装 (小型 DIP 式封装)
J-14	14 引脚陶瓷 DIP 式封装
K	TO-3 圆壳 (钢) 封装
KC	TO-3 圆壳 (铝) 封装
K-steel	TO-3 圆壳 (钢) 封装
N	灌封 DIP 式 (环氧树脂 B) 封装
N-01	交替引脚的灌封 DIP 式封装 (环氧树脂 B)
N-8	8 引脚灌封小型 DIP 式封装 (环氧树脂 B)
N-14	14 引脚灌封 DIP 式封装 (环氧树脂 B)
P	3 引脚 TO-202 功率封装
S	14 引脚 SGS 型功率 DIP 式封装 (环氧树脂 B)
T	3 引脚 TO-220 功率封装 (环氧树脂 B)
W	低温度陶瓷扁平封装
W	00 标准引脚形式陶瓷扁平封装
W	01 标准引脚形式陶瓷扁平封装
W	06 标准引脚形式陶瓷扁平封装
W	07 标准引脚形式陶瓷扁平封装
Z	3 引脚 TO-92 灌封封装 (环氧树脂 B)

④ 使用温度范围。

注 1: 该公司对于有专利权的线性电路, 其型号的第 1 部分 (字母), 如上所述, 仍表示电路的系列, 紧接其后的多位数字则表示电路的品种类别,

而其中第 1 位数字“1”、“2”或“3”则分别用来表征该种电路的不同使用温度范围，并有：

- 1 军品级（-55~125℃）
- 2 工业级（-25~85℃）
- 3 商业级（0~70℃）

例如：该公司的通用运算放大器 LM101/LM201/LM301，LM 表示单片线性电路系列，后 3 位数字 101、201 和 301 皆表示同一类产品通用运算放大器，但 LM101 为军品级（-55~125℃），LM201 和 LM301 分别为工业级（-25~85℃）和民用级（0~70℃）。

注 2：对于该公司的 CD×××系列 CMOS 数字电路，其附加词尾 C 和 M 表示：

- C -40~85℃
- M -55~125℃

该公司的 DM54××系列数字电路，其使用温度范围皆为 -55~125℃；DM8×××系列数字电路使用温度范围皆为 0~70℃。

2. 新产品型号命名规则（1989 年以后产品）

该类产品型号有 2 种命名方法：

（1）第 1 种产品型号由 5 部分组成，例如：

CD 77S184 A C J
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片系列：

- AD 模数电路
- AH 模拟混合电路
- CD CMOS 数字电路
- DA 数模电路
- DM 数字单片电路
- LF 线性 FET 电路
- LH 线性混合电路
- LM 线性单片电路

LX	变换器
MM	MOS 单片电路
AF	有源滤波器
DH	数字混合电路
DP	接口（微机）
DS	接口
HS	混合电路
JM	MIL- M38510
LP	线性低功耗电路
MA	计算机组件
MF	线性（单片滤波器）
MH	MOS 混合电路
NS	微处理器组件（存储器系统）
PL	可编程阵列逻辑
ADC	模数转换器
TBA	线性单片电路
COP	微处理机系列
DAC	数模转换器
HPC	高性能微处理器
ICM	集成计算机组件
IDM	微处理器（2901）
INS	微处理器（4004/8080A）
ISE	仿真器
LMC	线性 CMOS 电路
MCA	门阵列
NMC	MOS 存储器
NSC	微处理器（800）
PAL	可编程阵列逻辑
NS32	微处理器（3200）
AM	晶体管（FET）

BC	晶体管（小信号）
BD	晶体管（功率器件）
BF	晶体管（小信号和 FET）
PN	双极型塑封晶体管
MPS	晶体管（小信号）
NSD	晶体管（功率）
NSE	晶体管（功率）
PNP	分立晶体管
MJE	功率晶体管
MMBF	FET SOT-23
MMBT	双极晶体管 SOT-23
MMBTA	双极晶体管 SOT-23
MMBTH	双极晶体管 SOT-23

② 器件标号。

③ 改型标志。

④ 使用温度范围：

C 商业级（-40~+85℃）

M 军品级（-55~+125℃）

⑤ 封装形式：

D 玻璃/金属 DIP

F 玻璃/金属扁平封装

H TO-5（TO-99、TO-100、TO-46）外壳封装

J 低温玻璃 DIP

K TO-3（金属）封装

N 塑料 DIP

P TO-202（D-40，硬膜）封装

S SGS 型功率 DIP

T TO-220（金属）封装

W 低温玻璃扁平封装

Z TO-92 封装

(2) 第 2 种产品型号由 8 部分组成, 例如:

DM PAL 10 H 8 A J M

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示数字存储器。

② 可编程逻辑阵列。

③ 阵列输入端数。

④ 输出类型:

H 高电平有效

L 低电平有效

C 互补

R 调节器

A 带调节器的算术逻辑

⑤ 输出端数。

⑥ 速度:

空 标准速度 (40ns)

A 低功耗 (35ns, 150mA)

A-1 高速, 低功耗

⑦ 封装形式:

N 塑料 DIP

J 陶瓷 DIP

⑧ 使用温度范围:

C 商业级 (0~+70°C)

M 军品级 (-55~+125°C)

NCM Corporation (NCM)

NCM 公司 (日)

<http://www.netcybermedia.com>

NCM
communications

该公司的产品型号共由 3 部分组成, 例如:

NCM 40 02 Z N

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 芯片类别：

20 金属门阵，全定制

30 金属门阵，半定制

40 硅门阵，全定制

50 双极门阵

60 模拟，定制

70 硅门阵，半定制

③ 器件标号。

④ 改型标志。

⑤ 封装形式：

D 陶瓷 DIP

F 陶瓷扁平封装

L 无引脚芯片载体封装

N 塑料 DIP

NCR Corporation(NCR)

NCR 公司（美）

<http://www.ncr.com>

该公司的产品型号由 5 部分组成，例如：

NCR **23128** **I** **25** **PLCC**

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 器件标号。

③ 使用温度范围：

I 工业级（-40~+85℃）

HR 军品级（-55~+125℃）



SHR 军品级 (-55~+125°C)

④ 最大存取时间:

15 150ns

20 200ns

25 250ns

30 300ns

⑤ 封装形式:

PLCC 有引脚芯片载体塑料封装

空 DIP

NEC Corporation (NEC)

NEC 公司 (日)

<http://www.nec.com>

NEC

该公司的产品型号由 6 部分组成, 例如:

UP **D** **4364** **G** **10** **L**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商。

② 表示芯片系列:

A 组合元件

B 双极型数字电路

C 双极型模拟电路

D 非双极型数字电路 (MOS)

③ 器件标号。

④ 封装形式:

A 金属壳 (类似 TO-外壳) 封装

B 陶瓷扁平封装

C 塑料 DIP

D 陶瓷 DIP

G 塑料扁平封装

H 塑料 SIP

- J 塑料（类似 TO-92 外壳）封装
- M 小型 MOD 封装，薄片载体封装
- V “之”字形分支交叉 DIP 式封装

⑤ 最大读取时间（对特殊系列）：

- 10 100ns
- 12 120ns
- 15 150ns
- 20 200ns

注：其他系列含义：

- 10 10ns
- 12 12ns
- 15 15ns
- 20 20ns

⑥ 维持功耗：

- L 低功耗

NEC Electronics, Inc. (NEC)

NEC 电子公司（美）

<http://www.nec.com>

NEC

该公司产品型号共有 2 种命名规则，现分别举例叙述如下：

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成，例如：

μPD 7810H D

- ① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片系列：

μPC 线性电路

μPD MOS 电路

② 器件标号。

③ 封装形式：

B	陶瓷扁平封装
C	塑料 DIP
CT	28 引脚塑料 DIP (400 密耳)
CX	24 引脚塑料 DIP (600 密耳)
C1~C8	40 引脚塑料 DIP (600 密耳)
D	陶瓷 DIP
DW	64 引脚窗式 DIP
G	24 引脚小型塑封
G2	小型扁平塑封
GR	54 引脚小型扁平塑封 (反向引脚)
GF	54 引脚小型扁平塑封
G-00	52 引脚小型扁平塑封
G-1B	64 引脚小型扁平塑封
G-4	44 引脚小型扁平塑封
G-5	44 引脚芯片载体塑料封装
G-6	44 引脚小型扁平塑封
G-08	40 引脚陶瓷 (Piggyback) DIP (600 密耳)
G-12	64 引脚小型扁平塑封
G-22	44 引脚小型扁平塑封
G-36	64 引脚 QUIP 塑封
H	TO-220 外壳封装
HA	塑料 SIP
J	TO-92 外壳封装
L	18 引脚芯片载体塑料封装
LA	20/26 引脚窄间距引脚封装
L-5	无引脚芯片载体塑料封装
L-8	无引脚芯片载体塑料封装
R	132 引脚 (栅格) 阵列排列陶瓷封装
V	16 引脚 “之” 字形塑封

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

μPD 43 256 V - 12
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片系列，同第 1 类产品。

② 存储器等级：

10 10KB ECL RAM

100 100KB ECL RAM

28C CMOS EEPROM

43 MIX MOS 静态 RAM

③ 器件标号。

④ 表示封装形式，同第 1 类产品。

⑤ 速度 (ns)。

NMB Technologies corporation(NMB)

NMB 技术公司 (日)

<http://www.nmbtc.com>



该公司的产品型号由 4 部分组成，例如：

AAA1M10X 0 P - 10
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片系列：

AAA1M10X 高速 1MB DRAM

AAA1M20X 甚高速 DRAM

② 存取方式：

0 快速页式 (1MB×1)

1 半字节

2 静态 (1MB×1)

4 快速页式 (256KB×4)

③ 封装形式:

- P 塑料 DIP
- C 陶瓷 DIP
- Z “之”字形串连（交叉）直插封装
- J 窄间距（内引脚弯曲成 J 状）封装

④ 速度:

- 12 120ns
- 10 100ns
- 08 80ns
- 07 70ns
- 06 60ns

New Japan Radio Co., Ltd. (JRC)

新日本无线株式会社（日）

<http://www.njr.co.jp>

JRC

该公司的产品型号共由 3 部分组成，例如：

NJU 3403A M

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号，其中字母 A 表示改型产品。
- ③ 封装形式：

- M 小型封装
- N DIP
- A TO-92 外壳封装
- P 陶瓷 DIP
- T TO-5 金属壳封装
- S SIP

Oki Electric Industry Co., Ltd.

日本冲电气电子株式会社（日）

<http://www.oki.com>

OKI

该公司产品型号共有 2 种命名规则，现分别举例叙述如下：

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成，例如：

MSM **2816A** **25**

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号，其中字母 A 表示改型产品。
- ③ 最大存取时间：

10 100ns

12 120ns

15 150ns

25 250ns

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成，例如：

MSM **3750** - **6** **A**

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀。
- ② 器件标号。
- ③ 最大存取时间：（特殊组件）

1 330ns

2 380ns

6 650ns

8 850ns

12 120ns

- ④ 改型标志。

Nortec Communications, Inc. (Nortec)

诺泰克公司 (美)

<http://www.nortec.com>



NORTEC

该公司的产品型号共由 4 部分组成，例如：

NE 6003 11 D

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 电选择。
- ④ 封装形式：

D 陶瓷 DIP
F 扁平封装
H 金属壳封装
J 陶瓷 DIP
N 灌封 DIP
P 8 引脚 DIP
Y 管芯

Omnirel Corp. (Omnirel)

欧涅莱公司 (美)

<http://www.irf.com>

该公司已和 IR 公司 (International Rectifier) 合并，其产品型号由 3 部分组成，例如：



OM 7501 SC

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。

② 器件标号，其中的字母为改型标志。

③ 封装形式：

- C 8 引脚 DIP
- B 8 引脚扁平封装
- H 3 引脚 TO-220 外壳封装
- ST 3 引脚 TO-220 外壳封装
- SC 3 引脚 TO-247 外壳封装
- SA 3 引脚 TO-254 型或 TO-254AA 型外壳封装
- SC 5 引脚 TO-247 外壳封装
- SS 6 引脚 SIP
- DP 16 引脚扁平封装

Optical Electronics, Inc. (OEI)

光电公司 (美)

<http://www.oei-az.com>



该公司产品型号共有 2 种命名规则，现分别举例叙述如下：

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号仅由 4 位数字组成，例如：

2930

①

为器件标号，表示芯片类别：

- 25×× 对数放大器
- 29×× 对数放大器
- 502× 取样和保持放大器
- 503×/9×× 峰值读出和保持放大器
- 58×× 乘法器
- 99×× 宽带运算放大器
- AH×××× FET 或运算放大器

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成，例如：

AH 0013 CA

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀。

② 器件标号。

③ 温度/封装：

CJ/CK/CL	商业级 (TO 外壳封装)
CA/CB	商业级 (DIP)
DK/DS	商业级 (DIP)
GH/GJ/GK	扩展 (-25~+100℃) DIP
空	特殊器件 (DIP 或 TO-8 外壳封装)
LT	无引脚芯片载体陶瓷封装
C	8 引脚陶瓷 DIP
F	24 端无引脚陶瓷芯片载体封装
D	陶瓷 DIP

Panasonic Industrial Company(Panasonic)

松下工业公司(美)

<http://www.panasonic.com>

Panasonic

该公司产品型号共有 2 种命名规则，现分别举例叙述如下：

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成，例如：

DN 74LS195A 8

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀。

② 器件标号，其中字母 A 为改型标志。

③ 封装形式：

空	塑料 DIP
S	标准小型封装

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成，例如：

MN 41000 - 10
① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀。
- ② 器件标号。
- ③ 最大存取时间：
10 100ns
12 120ns

Performance Semiconductor Corporation (Performance)

弗尔曼斯半导体公司（美）

<http://www.performance-semi.com>

m



该公司的产品型号由 4 部分组成，例如：

P 4C116-20 L M
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号，其中短划后数字表明存储器的最大读取时间。

15 15ns
20 20ns
25 25ns
30 30ns
35 35ns
40 40ns

- ③ 封装形式：

D 陶瓷 DIP

- L 无引脚芯片载体陶瓷封装
 - P 塑料 DIP
 - F 有引脚芯片载体塑料封装
 - C 陶瓷 DIP
 - G DIP (鸥翼式)
 - PG 引脚阵列 (栅格) 排列封装
 - QG 有引脚芯片载体 (鸥翼式) 封装
 - QL 有引脚芯片载体 (直引脚) 封装
- ④ 使用温度范围:
- M 军品 (-55~+125℃)
 - C 民品 (0~+70℃)

Philips Components(Philips)

飞利浦公司 (荷)

<http://www.philips.com>

该公司产品型号共有3种命名规则,现分别举例叙述如下:

1. 第1类产品型号命名规则

该类产品型号由2部分组成,例如:

BCV 61

① ②

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀,表示芯片功能:

BCV 晶体管阵列

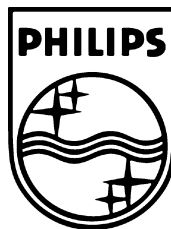
BGY RF/IF 放大器

其他前缀有: PCD、TDA、SAA、SE、NE、SU、MM、UA、HEF、TAA、TBA、TCA、SAB、NE、PC、TEA、MH、TU、BGX、OM、UAA、PCF、BLV、HXA。

② 器件标号。

2. 第2类产品型号命名规则

该类产品型号由6部分组成,例如:



PC 74 HC 7046 A P

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商和芯片功能：

PC 高速 CMOS

② 使用温度范围：

54 扩展（-55~+125℃），仅限于 DIP 封装

74 标准（0~+85℃或-40~+125℃）

78 （0~+80℃）

③ 表示工艺类别：

HC CMOS 输入开关电平，电源电压 2~6V 缓冲

HCT TTL 输入开关电平，电源电压 4.5V~5.5V，缓冲

HCV CMOS 输入开关电平，电源电压 2~6V，非缓冲（单级）

④ 器件标号。

⑤ 改型标志。

⑥ 封装形式：

D 陶瓷 DIP

P 塑料 DIP

T 塑封（小型）

3. 第 3 类产品型号命名规则

该类产品型号由 6 部分组成，例如：

S 54 LS 174 P B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片系列：

PC 高速 CMOS

N 标准 TTL

S 标准 TTL

② 使用温度范围：（同第 2 类产品）

③ 表示工艺类别，同第 1 类产品，且有：

LS 低功耗肖特基 TTL

S 肖特基 TTL

H 高速 TTL

④ 器件标号。

⑤ 封装形式：（同第 1 类产品）

⑥ 筛选方法：

B 老化

Plessy Semiconductors Ltd.

(Plessy)

普莱赛半导体公司（英）

<http://www.mitel.com>



该公司现属敏迪半导体公司（Mitel Semiconductor），其产品型号共有 3 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该产品型号由 3 部分组成，例如：

SL 360 DP

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示电路工艺类别

MV	CMOS
SP	双极数字
NH	N 沟道 MOS
MJ	N 沟道 MOS
SL	双级线性
ML	MOS 线性
MN	N MOS 数字
MP	MOS 数字
MT	MOS 线性
D	通信

NOM NMOS 存储单元和阵列
TCA/TBA/TDA/TAA 消费类电路产品

② 器件标号。

③ 封装形式：

DG 陶瓷 DIP
CM 多引脚 TO-5 外壳封装
DC DHmon
DP 塑料 DIP
EP 螺栓型功率封装
FM 10 引脚扁平封装
GC 无引脚芯片载体封装
SP 塑料 SIP
RP 功率 DIP
QP 塑封（四边引脚）
QG 陶瓷（四边引脚）封装
KM TO-3 外壳封装
GM 40 引脚扁平封装
LC 无引脚芯片载体封装

2. 第 2 类产品（指数据转换器）型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成，例如：

ZN **432** **CJ** - **10**
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀。

② 器件标号。

③ 使用温度范围/封装形式：

E 自插式 DIP 封装（0~+70℃）

DE DIP（-40~+85℃）

D 小型封装（0~+70℃）

J 陶瓷自插式 DIP 封装（-55~+125℃）

- BJ 陶瓷自插式 DIP 封装 (-40~+85°C)
- CJ 陶瓷自插式 DIP 封装 (0~+70°C)
- AM 芯片载体陶瓷封装 (-55~+125°C)

④ 线性偏差:

- 7 ±0.39%
- 8 ±0.19%
- 9 ±0.097%
- 10 ±0.049%

3. 第 3 类产品 (指低功耗基准源) 型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成, 例如:

ZNREF 025 C 1
 ① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀。
- ② 器件标号。
- ③ 使用温度范围:

A -55~+125°C

AB -55~+110°C

C 0~+70°C

④ 容差:

- 1 1%
- 2 2%

Precision Monolithics, Inc.

(PMI)

精密单片公司 (美)

<http://www.analog.com>



该公司已并入模拟器件公司 (Analog Device, Inc.), 其产品型号由 4 部分组成, 例如:

DAC 01 C Y

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片系列：

BUF	电压跟随器（缓冲器）
CMP	电压比较器
DAC	数模转换器
MAT	匹配晶体管
MUX	模拟多路转换器
OP	运算放大器
PM	第 2 源器件
REF	参考电压源
RPT	PCM 线转换器
SMP	采样和保持电路
SW	模拟开关
SSS	高级的第 2 源产品，改善特性
ADC	模数转换器
AMP	仪用放大器
DMX	DE-乘法器
GAP	通用模拟处理器
JAN	MIL-M-38510
PKD	峰值检波器
LDJ	总线驱动器

② 器件标号。

③ 芯片等级。

④ 封装形式：

H	6 引脚 TO-78 外壳封装
J	8 引脚 TO-99 外壳封装
K	10 引脚 TO-100 外壳封装
L	10 引脚扁平封装
M	14 引脚扁平封装

N	24 引脚扁平封装
P	环氧树脂 BDIP 式封装
Q	16 引脚密封 DIP 式封装
T	28 引脚密封 DIP 式封装
V	24 引脚陶瓷双列直插式封装
X	18 引脚密封 DIP 式封装
Y	14 引脚密封 DIP 式封装
R	20 引脚陶瓷 DIP 式封装
Z	小尺寸引脚陶瓷 DIP 式封装

Pro Electron

欧洲电子联盟

<http://www.eeca.org>



该联盟已并入欧洲电子元件制造商协会 (European Electronic Component Manufacturers Association)。其产品型号由 3 部分组成, 例如:

TEC **1033** **GC**

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀:

第 1 个字母: T	模拟电路
U	模拟/数字混合电路

第 2 个字母: 无特殊含义

第 3 个字母: 使用温度范围:

A	无规定
B	0~+70°C
C	-55~+125°C
D	-25~+70°C
E	-25~+85°C
F	-40~+85°C
G	-55~+85°C

② 器件标号。

③ 封装：

第 1 个字母，表示封装形式：

- C 圆柱形封装
- D DIP 式引脚封装
- E 功率 DIP（外带散热片）
- F 扁平（引脚在两边）封装
- G 扁平（引脚在四边）封装
- K 菱形（TO-3 系列外壳）封装
- M 多列引脚（2、3、4 列引脚除外）封装
- Q 4 列引脚直插式封装
- R 功率型 4 列引脚直插式封装（外带散热片）
- S SIL（TO-127、TO-220 外壳）
- T 3 列引脚封装

第 2 个字母，表示封装材料：

- C 金属-陶瓷
- G 玻璃-陶瓷
- M 金属
- P 塑料

Raytheon Company (Raytheon)

雷神公司（美）

Raytheon

该公司已被飞兆半导体公司收购。其产品型号由 3 部分组成，例如：

RC 4200A DE

① ② ③

部分字母和数字含义如下。

① 使用温度范围：

- RC 商业级（0~+70℃）
- RG 军品级（-55~+125℃）
- BL B 级

RM	军品级 (-55~+125℃)
RV	工业级 (-40~+85℃)
25	商业级 (0~+70℃)
74	商业级 (0~+70℃)
54	军品级 (-55~+125℃)
XR	全温度范围
RF	RAY I, II, III TTL
LM2	工业级 (-40~+85℃)
LM3	商业级 (0~+70℃)
NRF	RAY I, II, III TTL
LH1, LM2	军品级 (-55~+125℃)
54LS	低功耗肖特基 TTL, 军品级

② 器件标号, 其中字母 A 表明改型。

③ 封装形式:

CJ	14 引脚陶瓷扁平封装
BM	16 引脚环氧树脂 B 扁平封装
CL	16 引脚陶瓷扁平封装
CK	14 引脚陶瓷扁平封装
DB	14 引脚环氧树脂 B DIP
DC	14 引脚陶瓷 DIP
DD	16 引脚陶瓷 DIP
DE	8 引脚陶瓷 DIP
DM	16 引脚陶瓷 DIP
DZ	40 引脚陶瓷 DIP
FV	28 引脚陶瓷扁平封装
FZ	42 引脚陶瓷扁平封装
MB	16 引脚环氧树脂 B DIP
ML	16 引脚陶瓷 DIP, 边铜焊
MS	20 引脚陶瓷 DIP, 边铜焊
MZ	40 引脚陶瓷 DIP, 边铜焊

NB	8 引脚环氧树脂 B DIP
PS	20 引脚环氧树脂 B DIP
PU	24 引脚环氧树脂 B DIP
PV	28 引脚环氧树脂 B DIP
PZ	40 引脚环氧树脂 B DIP
TK	9 引脚 TO-66 外壳功率型封装
D	14 引脚金属 DIP
F	扁平封装
H	3、8 或 10 引脚金属壳封装
J	14 或 16 引脚陶瓷 DIP
K	TO-3 外壳功率型封装
N	24 引脚玻璃/金属扁平封装
N	环氧树脂 B DIP (仅 LM 系列)
Q	10 引脚扁平 (1/4 英寸×1/4 英寸) 封装
R	24 引脚陶瓷 DIP
T	3、8、10 或 12 引脚金属壳封装
W	14 引脚陶瓷扁平封装
M	8 或 14 引脚塑料微封装
S	陶瓷引脚 DIP
P	塑料 DIP
X	芯片
CH	芯片 (MIL-STD-883B、2010 法) 和薄片封装
CQ	10 引脚陶瓷扁平封装
FD	64 引脚陶瓷扁平封装, 边铜焊
LS	20 引脚芯片载体 (正方形) 封装
LV	28 引脚芯片载体 (长方形) 封装
LW	28 引脚芯片载体 (正方形) 封装

Renesas

Technology

Corp. (Renesas)

瑞萨科技公司 (日)

<http://www.renesas.com>



该公司于 2003 年由日本三菱半导体事业部与日立半导体事业部联合成立。该公司产品型号请参考三菱和日立公司的产品命名法。

RS Components Ltd. (RS)

RS 器件公司 (英)

<http://www.rs-components.com/index.html>



该公司现属电子英国电子器件集团公司 (Electrocomponents plc)，其产品型号由 2 部分组成：

RS 74C922

① ②

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号，其中字母：

C CMOS

HC 高速 CMOS

RCA Corp. Solid State Div. (RCA)

RCA 公司固态电路分部 (美)

<http://home.rca.com/EN-US/Rcahome.htm>



1

该公司的产品型号由 5 部分组成，例如：

CA 3120 B E A

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 电路种类 (2~3 个字母)：

CA 线性电路

CD 数字电路
CDP 微处理器
MWS MOS 电路

② 器件标号。

③ 改型标志。

④ 封装形式：

D 陶瓷 DIP
E 塑料 DIP
F 陶瓷 DIP（玻璃封装）
H 芯片
K 陶瓷扁平封装
Q 四列引脚塑封
T TO-5 外壳封装

⑤ 改型标志：

A 改进型，可与原型互换
B 改进型，可与原型及 A 改进型互换使用
C 改进型

Ricoh Co., Ltd. (Ricoh)

理光公司（日）

<http://www.ricoh.com>

RICOH

该公司的产品型号由 3 部分组成：

RD 27C256 - 25
① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，可为 RF、EPL、RD、RP。

② 器件标号，其中字母意义为：

C CMOS
HC 高速 CMOS

③ 最大存取时间：

10	100ns
15	150ns
25	250ns
30	300ns
35	350ns

Ricoh Corporation

理光公司电子器件分部（美）

<http://www.ricoh.com>

RICOH

该公司产品型号有 2 种命名规则，现分别举例叙述如下：

1. 第 1 类产品型号由 7 部分组成，例如：

EPL **16** **P** **2** **A** **D** **35**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，有 EPL、RF、RD、RP。

② 输入端数。

③ 输出类型：

P 可编程极性

RP 寄存器

④ 输出端数。

⑤ 程序检验电压：

A 21V (55ns)

B 13.5V (35ns)

⑥ 封装形式：

D 陶瓷 DIP (第 1 个方窗口)

P 塑料 DIP (无窗口)

⑦ 延迟时间：

55 55ns

35 35ns

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成，例如：

RD **27C64** **25**
① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，同第 1 类产品。
- ② 器件标号。
- ③ 最大存取时间：
25 250ns
30 300ns

Rockwell

International



Corp. (Rockwell)

洛克威尔公司半导体部（美）

<http://www.conexant.com>



C O N E X A N T

洛克威尔公司半导体部现已独立为
科胜讯系统公司 (Conexant Systems, Inc.)。该公司的产品型号由 5 部分组成：

R **2364** **B** **P** **E**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 频率：
空 最高 1MHz
A 最高 2MHz
B 最高 3MHz
- ④ 封装形式：
C 陶瓷 DIP
P 塑料 DIP
Q 四列引脚直插式封装 (QUIP)

J 芯片载体，带 J 引脚

⑤ 使用温度范围：

空 商业级 (0~+70℃)

E 工业级 (-40~+85℃)

M 军品级 (-55~+125D) B 级

MT 军品级 (-55~+125℃)

Rohm Co. Ltd. (Rohm)

罗姆公司 (日)

<http://www.rohm.com>



该公司的产品型号由 4 部分组成，例如：

BA **2804A** **F** **300**

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商，可为 BU、BA。

② 器件标号，其中字母 A 表示改型产品。

③ 封装形式：

F 小型封装

K 四边引脚扁平封装

空 DIP

④ 最大存取时间：

300 300ns

350 350ns

400 400ns

55 55ns

70 70ns

85 85ns

Samsung Semiconductor, Inc. (Samsung)

三星半导体公司 (韩)

<http://www.samsungsemi.com>

该公司产品型号共有 3 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成, 例如:

KSV 3100A C N

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 器件表示芯片系列:

KA	线性电路
KS	ROS 电路
KT	通信电路
LM	仿国家半导体公司产品
MC	仿摩托罗拉公司产品
NE	仿西格尼蒂克公司产品
KSV	模数、数模变换器
KAD	模数变换器
KDA	数模变换器

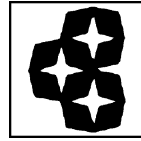
② 器件标号, 其中字母 A 表示改进型。

③ 使用温度范围:

C	通用 (0~+70°C)
I	工业级 (-55~+125°C)

④ 封装形式:

D	小型封装
J	陶瓷 DIP
N	塑料 DIP (300/600 密耳)
S	SIP
E	小间距 (400 密耳) 封装
B	小间距 DIP (400 密耳)



P	小间距 DIP (300 密耳)
W	引脚“之”字形串连(交叉)直插封装
U	引脚阵列(栅格式)排列封装
L	无引脚芯片载体陶瓷封装
PL	有引脚芯片载体塑料封装
M	TO-3 外壳封装
H	TO-3P 外壳封装
Z	TO-92 外壳封装
V	TO-92L 外壳封装
T	TO-220 外壳封装
X	TO-247 外壳封装
G	芯片

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 2 部分组成, 例如:

KS 54AHCT164

① ②

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 常见的是 KS、KM。

② 器件标号, 其中字母表明工艺类别:

C CMOS 兼容输入/输出电路

HC 高速 CMOS 电路

HCT 高速 TTL (和 CMOS 兼容) 电路

AHCT 先进的高速 TTL (和 MOS 相容) 电路

注: 若只有单个字母 A 表示改型产品。

3. 第 3 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成, 例如:

KM 4128 - 12

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀。

② 器件标号。

③ 最大存取时间：

10 100ns

12 120ns

15 150ns

20 200ns

SANYO Electric Co., Ltd(Sanyo Electric Co., Ltd)

三洋电机公司（日）

<http://www.sanyo.com>



该公司产品型号由 2 部分组成，例如：

LC 3517

① ②

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示芯片系列：

LA 单片双极型线性电路

LB 单片双极型线性电路

LC 单片 CMOS 电路

LM 单片 NMOS 电路

② 器件标号，后可跟字母，表明电路类别：

A 通用电路

L 低功耗电路

H 高速电路

E 小规模电路

STK 厚膜电路

Saratoga Semiconductor(Saratoga)

赛伦半导体公司（美）

该公司的产品型号由 6 部分组成，例如：

SS M 6116 - 25 P C

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

组成产品型号的各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 表示芯片系列：

L 逻辑电路

M 存储器

③ 器件标号。

④ 速度，单位 ns。

⑤ 封装形式：

C 陶瓷 DIP

D 塑料封装

E 塑封（窄间距）

F 扁平封装

J 有引脚芯片载体塑料封装

L 无引脚芯片载体陶瓷封装

P 塑料 DIP

S 边铜焊 DIP

X 芯片包封

⑥ 使用温度范围：

C 商业级（0~+70℃）

B 军品级（-55~+125℃），按 MIL-STD-8830C，B 级标准

M 军品级（-55~+125℃）

S 25℃

SEEQ Technology (SEEQ)

SEEQ 技术公司（美）

<http://www.lsilogic.com>

该公司已并入 LSI 公司（LSI Logic Corporation），其产品型号由 5 部分组成，例如：



D Q 2864 H 250

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 封装形式：

D 陶瓷
L 无引脚芯片托架体
P 塑料 DIP
N 塑料引脚芯片托架体
F 密封扁平封装

② 温度范围：

Q 商业级 (0~+70℃)
E 工业级 (-40~+85℃)
M 军品级 (-55~+125℃)

③ 器件标号。

④ 附加说明：

写入时间：

空 标准型
H 快速型 (适合存储器)

寿命 (对于 EEPROM)：

K 1000 次循环
N 10000 次循环

⑤ 最大存取时间：

2 200ns
20 200ns
200 200ns
25 250ns
250 250ns

Sensym ICT(Sensym)

赛西姆公司(美)

<http://www.sensym.com>

SenSym

该公司现属霍尼韦尔公司(Honeywell,Inc.)。该公司的产品型号由3部分组成,例如:

SCX **100** **DNC**

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀,表示芯片系列,有 SCX、SPX、SX、SSX、LX、ST。
- ② 器件标号。
- ③ 附加说明:

A/AN/ANC 绝对标准

D/DN/DNC 不同标准

G1 标准压力器件,输出电压为1~6V

G2 标准压力器件,输出电压为2.5~12.5V

G 标准压力器件

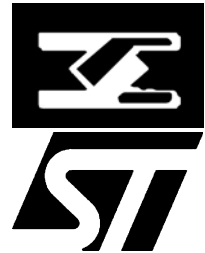
SGS-ATES Component Electronic SpA

(SGS-ATES)

SGS-亚特斯电子元件公司(意大利)

<http://www.st.com>

该公司已合并为意法半导体公司(STMicroelectronics N.V.)。其产品型号共有2种命名规则。



1. 第1类产品型号命名规则

该类产品型号由3部分组成,例如:

TDA **1220** **A**

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀。该公司产品型号的前缀字母与1欧洲电子联盟的前缀相同,并有:

H 正逻辑

HB, HC	CMOS 电路
L, LS	通用线性电路
M	MOS 电路
TAA	电视机和收录机电路 (消费类)
TBA	电视机和收录机电路 (消费类)
TCA	电视机和收录机电路 (消费类)
TDA	电视机和收录机电路 (消费类)

- ② 器件标号。
- ③ 改型标志, 表明电路性能变化。

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成, 例如:

M 74HC597 C1

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 有 M、T、Z。
- ② 器件标号, 其中字母表明工艺:

C CMOS

HC 高速 CMOS

- ③ 封装形式:

F1 塑料 DIP

B1 塑料 DIP

C1 芯片载体封装

D1 DIP

D2 DIP

SGS-Thomson Microelectronics (SGS-Thomson)

SGS-汤姆逊公司 (意、法)

<http://www.st.com>

该公司已改名为意法半导体公司 (STMicroelectronics N.V.)。其产品型号共有 5 种命名规则。



1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

MK **41L67** **N** **L** - **25**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀：

MK 标准型
MKB 军品级，高可靠，筛选按 MIL-STD-883B 级标准
MKI 工业，高可靠（-40~+85℃）

② 器件标号：

1×××/1×××× 移位寄存器，ROM
2×××/2×××× ROM，EPROM
3×××/3×××× ROM，EPROM
 38×× 微处理器和支持件
4×××/4×××× RAM
5×××/5×××× 计数器，通信和工业品
7×××/7×××× 微处理器系统

③ 封装形式：

N 环氧树脂 DIP
P 金边焊陶瓷 DIP
J 陶瓷 DIP
K 锡边焊陶瓷 DIP
T 陶瓷 DIP
E 无引脚芯片载体陶瓷封装
D 双密度（RAM）封装
F 扁平封装

④ 使用温度范围：

A 工业级（-40~+85℃）
C -25~+85℃
H 0~+55℃

- L 商业级 (0~+70℃)
- M 军品级 (-55~+125℃)
- R -55~+85℃
- S 特殊工作范围

⑤ 最大存取时间:

- 15 150ns
- 20 200ns
- 25 250ns
- 82 150ns
- 83 200ns
- 84 250ns

2. 第2类产品型号命名规则

该类产品存储器类型号由4部分组成, 例如:

Mxx xxxxxx xx xx
 ① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片系列:

- M27 EPROM
- M93 EEPROM

② 器件标号。

③ 速度。

④ 封装形式:

- B 塑封
- D 多层陶瓷封装
- F 陶瓷玻璃密封
- M 塑封 (SO-8)

3. 第3类产品型号命名规则

该类产品型号由7部分组成, 例如:

xx x xxxxxx x xx x xx
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片类别：

ET21	静态 RAM
ETL21	静态 RAM
ETC27	EPROM
MK41	快速静态 RAM
MK45	双口先进先出
MK48	静态 RAM
TS27	EPROM
TS28	EEPROM
TS59	EEPROM

② 表示工艺类别：

空	NMOS
C	CMOS
L	低功耗

③ 器件标号。

④ 封装形式：

C	陶瓷封装
J	陶瓷封装
N	塑封
Q	窗式陶瓷-玻璃 DIP

⑤ 速度。

⑥ 使用温度范围：

空	0~+70℃
E	-25~+70℃
V	-40~+85℃
M	-55~+125℃

⑦ 筛选方法：

空	标准型
B/B	按 MIL-STD-883B 标准筛选

4. 第 4 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成，例如：

<u>Z80</u> ××	<u>×</u>	<u>×</u>	<u>×</u>
①	②	③	④

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片：

Z8000	CPU
Z8500	外设电路

② 速度:

空 4MHz

A 6MHz

③ 封装形式:

B 塑封

D 陶瓷封装

F 玻璃密封

C 有引脚芯片载体塑料封装

K 无引脚芯片载体封装

④ 使用温度范围:

1 0~+70℃

6 -40~+85℃

2 -55~+125℃

5. 第 5 类产品（微机电路）型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成，例如：

Z86××× × × ×
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片系列:

Z86××× 微机

Z84××× 微机

② 速度，对 Z86×××:

空 8MHz

A 12MHz

对 Z84×××:

空 2.5MHz

A 4MHz

B 6MHz

H 8MHz

③ 封装形式，同第 4 类产品。

④ 使用温度范围，同第 4 类产品。

Sharp Electronics Corporation of American (SHARP)

美国夏普电子公司 (美)

<http://www.sharpsma.com>

SHARP

该公司的产品型号由 4 部分组成，例如：

LH **57128** **J** **20**
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，有 LZ, LR, SM, LH。
- ② 器件标号，其中可包含一个字母，表明改型。
- ③ 封装形式：

D DIP
M 小型封装
J DIP

- ④ 最大存取时间：

10 100ns
12 120ns
15 150ns
20 200ns
30 300ns

Siemens Aktiengesellschaft (Siemens)

西门子公司 (德)

<http://www.siemens.com>

SIEMENS

该公司的产品型号共有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

TA **A** **2762** **A** - **DC**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 表示芯片系列，其中第 1 个字母：

- S 个别数字电路
- T 模拟电路
- U 模拟/数字混合电路

第 2 个字母没有特殊含义，除 H 表明标准混合电路外，其他指不同系列电路。

② 使用温度范围：

- A 无规定范围
- B $0\sim+70^{\circ}\text{C}$
- C $-55\sim+125^{\circ}\text{C}$
- D $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$
- E $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$
- F $-40\sim+85^{\circ}\text{C}$

③ 器件标号。

④ 改型标志。

⑤ 封装形式，其中第 1 个字母表示形状：

- C 圆柱形
- D DIP
- E 功率 DIP（外加散热片）
- F 扁平封装（引脚在两边）
- G 扁平封装（引脚在四边）
- K TO-3 型封装
- M 多层引脚封装（除 2、3、4 引脚外）
- N 引脚芯片载体封装
- Q 四列直插式封装
- P 功率型四列直插式封装（外加散热片）
- S SIP
- T 三列引脚封装

第 2 个字母表示封装材料：

- C 金属陶瓷
- G 玻璃陶瓷

M 金属

P 塑料

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成，例如：

LM **193** **A** **FE**

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，有 CGY、FA、FC、FZY、TCA、TDB、SM、PEB、TAA、TAE、TAF、TBB、TBC、LM、PSB、SDA、SA、KPY、KTY、KSY、HKZ、TLB、TDA。

② 器件标号。

③ 改型标志。

④ 封装形式：

G/D 小型 (SO) 封装

T TO 型外壳封装

FE/N/P DIP

Siemens Corp. (Siemens)

美国西门子公司 (美)

<http://www.siemens.com>

SIEMENS

该公司的产品型号共有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

SA **B** **81C52** **A** - **DP**

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 芯片系列，与德国西门子公司第 1 类产品相同。

② 使用温度范围，与德国西门子公司第 1 类产品相同。

③ 器件标号。

④ 改型标志。

⑤ 封装形式，与德国西门子公司第 1 类产品相同。

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

HY **B** **41257** **P** **12**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀。
- ② 温度，与第 1 类产品相同。
- ③ 器件标号。
- ④ 封装形式：
 - C 金属-陶瓷封装
 - P 塑料
 - G 玻璃陶瓷 DIP
- ⑤ 最大存取时间：
 - 12 120ns
 - 15 150ns
 - 20 200ns

Sierra Semiconductor Corp. (Sierra)

西雷半导体公司（美）

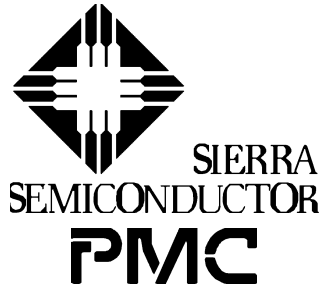
<http://www.pmc-sierra.com>

该公司的产品型号由 4 部分组成，例如：

SC **11001** **C** **N**
① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 使用温度范围：
 - C 商业级（0~+70℃）
- ④ 封装形式：
 - N 塑料 DIP
 - V 无引脚芯片载体封装



Signetics Corp.

西格尼蒂克公司 (美)

<http://www.usa.philips.com/index.page>

The logo for Signetics, featuring the word "Signetics" in a bold, stylized, black font. The letters are thick and blocky, with a slight shadow effect. The "S" is particularly large and prominent.

该公司现属飞利浦半导体公司，其产品型号由 3 部分组成，例如：

NE 527 D

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 使用温度范围

X	商业级 (0~+70°C)
75	商业级 (0~+70°C)
NE	商业级 (0~+70°C)
55	军品级 (-55~+125°C)
SE	军品级 (-55~+125°C)
S	军品级 (-55~+125°C)
SA	工业级 (-40~+85°C)
SU	扩展 (-25~+85°C)

② 器件标号。

③ 封装形式：

D	塑封表面贴装器件
N	塑料 DIP
A	有引脚芯片载体塑料封装
F	14、16、18、20、22、24、28 引脚陶瓷 DIP
G	无引脚芯片载体陶瓷封装
H	TO-5 外壳封装
I	8~50 引脚陶瓷 DIP
K	2 引脚 TO-3 外壳封装
Q	扁平陶瓷封装
R	氧化铍扁平陶瓷封装
U	9、13 引脚 SIP
Y	24 引脚陶瓷正方形扁平封装 (辐射引脚)
W	10、14、15、24 引脚扁平封装
CK	十字形芯片封装
EC	4 引脚 TO-46 外壳封装
EE	4 引脚 TO-72 外壳封装
FE	8 引脚 DIP

SK	微处理机组件
TA	8 引脚 TO-5 外壳封装
N14	14 引脚塑料 DIP

Silicon Systems, Inc.

硅系统公司（美）

<http://www.ti.com>

该公司现属于得州仪器公司。其产品型号共有 2 种命名规则。



1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成，例如：

SSI **1204** **C** **P**
 ① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 器件标号。

可以包含 1 个字母表明改型。

③ 使用温度范围

C 商业级（0~+70℃）

I 工业级（-40~+85℃）

M 军品级（-55~+125℃）

④ 封装形式：

C 陶瓷边铜焊封装

D 陶瓷 DIP

F 扁平封装

H 有引脚芯片载体塑料封装

P 塑料 DIP

T 金属外壳封装

S 膜式塑料 DIP

N 小型（窄 150 密耳）封装

L 小型（大 300 密耳）封装

W 小型（宽 400 密耳）封装

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 8 部分组成，例如：

SSI **32M** **590** **A** **J** **-2** **C** **P**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 芯片类别：

32B HDD 接口
32C HDD 控制器
32D 数据接收
32H HDD 磁头定位
32M HMM 电动机速度控制器
32P HDD 脉冲选择器
32R HDD 读/写放大器
34B FDD 接口
34D FDD 数据接收
34P 脉冲选择
34R 读写放大器
35P 磁带驱动脉冲选择器
73D 调制/解调器器件
73K K 系列调制/解调器
73M 调制/解调器支持件
75T 音调信号设备
78P 数字通信电路
78A 模拟通信电路

③ 器件标号。

④ 改型标志，用 A、E 表示。

⑤ 修正类型：

- J 老化（168 小时）
- K 老化（48 小时）
- L 低功耗
- M 镜像
- S 串行
- R 阻尼电阻
- U 芯片 UART
- LJ 低噪声老化（168 小时）
- LN 低噪声
- LQ 低噪声，电阻，镜像
- SL 低功耗系列
- RM 电阻，镜像

⑥ 通道数。

⑦ 使用温度范围：

- C 商业级（0~+70℃）
- I 工业级（-40~+85℃）
- M 军品级（-55~+125℃）

⑧ 封装形式，与第 1 类产品相同。

Silicon MicroSystems Inc.

硅微系统公司（美）

<http://www.exar.com>



该公司为埃克萨（EXAR）公司的子公司。其产品型号由 2 部分组成，例如：

SM 27HC64

① ②

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号，其中字母表明工艺：

C CMOS

HC 高速 CMOS

Siliconix, Inc. (Siliconix)

硅尼克斯公司 (美)

<http://www.vishay.com/company/brands/siliconix>

该公司已并入威世 (Vishay) 公司, 其产品型号共有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成, 例如

L **161A** **A** **L** / **883**

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片类别:

D	FET 开关驱动器
G	FET
L	线性电路
LD	线性数字混合电路
DF	数字电路
DG	模拟开关和模拟多路调制器
LD	线性/数字混合电路
SD	DMOS 电路
SI	本公司产品或仿制品
STM	QPL 部分
PWM	脉冲宽度调节器

② 器件标号, 其中字母为改型标志。

③ 使用温度范围:

A	-55~+125°C
B	工业级 (-25~+85°C)
C	商业级 (0~+70°C)
D	工业级 (-40~+85°C)

④ 封装形式:



- A 金属壳密封
- J 塑料 DIP
- L 扁平密封
- P 边铜焊 DIP
- R 边铜焊 DIP
- K 陶瓷 DIP
- Y 小型封装

⑤ 筛选方法:

- /883 按 MIL-STD-883B 级 (不包括 JAN) 标准筛选
- 2 非 MIL, 非 JAN
- 4 160 小时老化, 按 BS9000 筛选

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 2 部分组成, 例如:

2N 7211

- ①
- ②

各部分字母和数字含义如下。

- ① 晶体管阵列前缀, 有 2N、2C。
- ② 器件标号。

Solid State Devices, Inc (SSDI)

固态器件公司 (美)

<http://www.ssd-power.com>



该公司产品型号由 4 部分组成, 例如:

SSI 757201 C D

- ①
- ②
- ③
- ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 使用温度范围:
 - C 商业级 (0~+70°C)

I 工业级 (-40~+85℃)

④ 封装形式:

D 陶瓷 DIP

P 塑封 DIP

Solitron Devices, Inc.

(Solitron)

索列特朗公司(美)



<http://www.solitrondevices.com>

该公司的产品型号由 5 部分组成, 例如:

CM 4035 A E X

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示产品系列:

CM CMOS

UC (4×××) 线性电路

UC (6×××) PMOS 存储器

UC (7×××) PMOS 存储器

② 器件标号。

③ 电源电压极限值:

A 15V

B 20V (缓冲)

BU 20V (非缓冲)

④ 封装形式:

E 塑料 DIP

EN 窄体 24 引脚塑料 DIP

F 玻璃密封陶瓷 DIP

M 小型封装

K 扁平封装

D 陶瓷 DIP

Q 有引脚芯片载体塑料封装

⑤ 筛选方法:

X 老化

空 标准工艺

S-MOS Systems Inc. (S-MOS)

S-MOS 系统公司 (美)

S-MOS

该公司的产品型号由 4 部分组成, 例如:

SRM **2016** **C** **15**

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 第 1 个字母 S 为前缀, 表示生产厂商, 后 2 个字母表示电路类别:

CL 转换器

EA 传感器阵列

ED 延迟线驱动器

LA 逻辑阵列

MC 微处理器和外设

MM 掩模 ROM

PM 可编程存储器

RM 静态 RAM

SC 标准单元

TC 通信电路

VM 乐曲 IC

② 器件标号。

③ 封装形式:

C 塑料 DIP

D 芯片包封

F 四边引脚扁平封装

H 陶瓷 DIP

J 引脚芯片载体塑料封装

M 小型封装

N 膜状 DIP

S 热封 DIP

④ 速度:

15 150ns

Sony Corp. (Sony)

索尼公司 (日)

<http://www.sony.com>

SONY

该公司产品型号有新、旧 2 种命名规则。

1. 原命名法

产品型号由 4 部分组成, 例如:

CX 20 014 A

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商。

② 类别:

0/1/8/10/20/22 双极型

5/7/19/25 MOS 型

③ 器件标号。

④ 改型标志。

2. 新命名法

产品型号由 5 部分组成, 例如:

CX A 1001 A P

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商。

② 芯片类别:

A 双极, 线性电路

B 双极, 数字电路

- D MOS 数字电路
- K 存储器
- P/Q 微机电路
- L CCD 信号处理电路

③ 器件标号。

④ 改型标志。

⑤ 封装形式：

- P 塑料 DIP
- D 陶瓷 DIP
- M 小型扁平封装
- L SIP
- Q 四列直插封装
- S 小型 DIP
- K 无引脚芯片载体陶瓷封装

Sorep SA(Sorep)

索莱弗-赛公司(法)

该公司的产品型号由 3 部分组成，例如：

SO 4735A CC

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 器件标号，其中字母 A 表示改型。

③ 使用温度范围，筛选方法：

CC 商业级 (0~+70℃)

CZ 军品级 (-55~+125℃)，按 MIL-STD-883C，B 级筛选

Space Reaearch Technology

空间研究技术公司(美)

该公司的产品型号由 5 部分组成，例如：

SRT 4501 C PD 80

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 器件标号。

③ 使用温度范围，筛选方法：

C 商业级（0~+70℃）

L 工业级（-40~+85℃）

M 军品级（-55~+125℃）

883C 按 MIL-STD-883C、B 级筛选

④ 封装形式：

PD 塑料 DIP

CD 陶瓷 DIP

PC 有引脚芯片载体塑料封装

CC 无引脚芯片载体陶瓷封装

F 扁平封装

注：除 PD 外，所有封装均为气密性封装。

⑤ 最大存取时间（单位 ns）。

Sprague Electric Co. (Spragu)

美国史普拉格电子公司

该公司的产品型号由 5 部分组成，



例如：

UD N - 2933 L - BU

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片类别：

UC CMOS, BIMOS, I²L 或合成阵列

UD 数字驱动器

UG 霍耳效应器件

- UL 线性驱动器
 - UT 晶闸管阵列
 - TP 晶体管阵列
- ② 使用温度范围：
- N 商业级或工业级（0~+70℃）
 - Q 扩展（-40~+85℃）
 - S 军品级（-55~+125℃）
 - X 试制品
- ③ 器件标号。
- ④ 封装形式：
- A 塑料 DIP
 - B 塑料 DIP（带散热片）
 - C 无包封芯片
 - D 金属壳封装
 - H 陶瓷/金属密封 DIP
 - L 小型封装
 - M 8 引脚 DIP（塑封）
 - R 陶瓷/玻璃密封 DIP
 - S 4 引脚 SIP（塑封）
 - T 3 引脚 SIP（塑封）
 - U 3 引脚 SIP（塑封，锡焊）
 - V 金属扁平（TO-3）封装
 - W 12 引脚 SIP（功率翼塑封）
 - Y 3 引脚塑封（TO-92 型外壳）
 - Z 5 引脚 SIP（功率翼塑封，TO-220 外壳）
 - ZH 水平安装的 Z 封装
 - ZV 垂直安装的 Z 封装
 - CW 方块型
 - EK 无引脚芯片载体陶瓷封装
 - EP 有引脚芯片载体塑料封装

- LB 小型封装 (散热片)
 - LW 宽体小型封装
 - EP 有引脚芯片载体塑料封装
- ⑤ 附加说明:
- I 变型
 - BU 老化产品
 - MIL 军品级, 不按 883 标准筛选
 - 883 军品级, 按 MIL-STD-883B 级筛选, 适合于密封产品

Sprague Semiconductor Group (Sprague)

史普拉格半导体集团 (美)



该公司的产品型号共有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成, 例如:

UD N - 2933 L - BU

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片系列:

- UC CMOS, BIMOS 或 I²L 阵列
- UD 数字驱动器
- UG 霍耳器件
- UL 线性器件
- UT 开关阵列 (晶闸管)
- TP 晶体管阵列

② 使用温度范围:

- N 商业级或工业级 (0~+70℃)
- Q 扩展 (-40~+85℃)
- S 军品级 (-55~+125℃)
- X 试制品

③ 器件标号。

④ 封装形式:

- A 塑料 DIP
- B 塑料丝网状 DIP
- C 芯片
- D 金属壳封装
- H 陶瓷/金属密封 DIP
- L 小型封装
- M 8 引脚塑料 DIP
- R 陶瓷/玻璃密封 DIP
- S 4 引脚塑料 SIP
- T 3 引脚塑料 SIP
- U 3 引脚塑料 SIP (薄型)
- V 金属凸缘 TO-3 型外壳封装
- W 12 引脚塑料 SIP (带功率翼)
- Y 3 引脚 TO-92 外壳塑料
- Z 5 引脚塑料 SIP (带功率翼 TO-220 外壳)
- ZH 水平安装的 Z 封装
- ZV 垂直安装 Z 封装
- CW 探针方块
- EK 无引脚芯片载体封装
- EP 有引脚芯片载体塑料封装
- LB 网状小型封装
- LW 宽体小型封装
- EB 有引脚芯片载体塑料封装

⑤ 附加说明:

- I 变型选择
- BU 老化
- MIL 军品级
- 883 军品级, 按 MIL-STD-883B 级筛选 (仅适用于密封器件)

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成，例如：

883 / **4006B** **C**
① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 老化及筛选等级：

SCL 标准工艺
883 MIL-STD-883B 级
CCL MIL-STD-883C 级
JCL 38550
883C MIL-STD-883B 级和 CMOS 工艺
BCL 标准 CMOS，军品级（-55~+125℃）

② 器件标号。

③ 封装形式：

C 陶瓷/玻璃 DIP
D 空封焊或边铜焊陶瓷封装
E 环氧树脂（塑料）封装
F 金属扁平封装
H 芯片
K 扁平陶瓷封装
L 无引脚芯片载体封装
Q 四边型窗式陶瓷-玻璃 DIP 式封装
T 小型环氧封装
HW 薄方片

STMicroelectronics N.V. (ST)

意法半导体（意、法）

<http://www.stmicroelectronics.com>

意法半导体成立于 1987 年，是由意大利
SGS 半导体公司和法国汤姆逊半导体合并而成



的，原名 SGS 汤姆逊半导体公司。其产品命名方法 SGS 汤姆逊公司。

Standard Microsystems Corporation (SMSC)

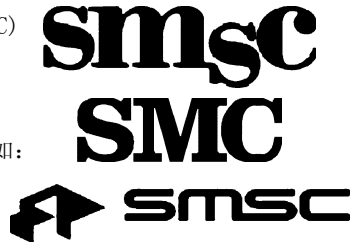
标准微系统公司（美）

<http://www.smssc.com>

该公司的产品型号由 3 部分组成，例如：

SR 5015 80

① ② ③



各部分字母和数字含义如下。

① 芯片类别：

FDC 软磁盘控制器

COM 通信接口

HDC 硬盘控制器

CRT 视频延迟

MPU 微机接口

KR 键盘编码器

SR 移位寄存器

② 器件标号。

③ 移位寄存器数。

Stantel Components, Inc.

斯坦泰尔器件公司（美）

该公司的产品型号由 5 部分组成，例如：

STC 6116 M 70 J

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 芯片系列：

CRT 视频显示电路

DSP 混合数字信号处理电路

SCA 模数转换器

SCC	比较器
SCD	数模转换器
SCG	取样, 保持电路
SFA	光纤放大器
SFD	光纤驱动器
SLM	多路调制器
SLS	移位寄存器
SMF	先进先出
STC	存储器和混合电路
TEC	电信电路
VAX	阵列

② 器件标号。

③ 筛选等级：

B	BS9000
I	工业级
M	MIL-STD-883C 级
空	商业级

④ 芯片速度。

⑤ 封装形式：

C	芯片载体封装
D	陶瓷（玻璃烧结）封装
J	边铜焊陶瓷 DIP
N	塑料 DIP
SX	薄膜（宽 0.3 英寸）封装

Synertek System Corp. (Synertek)

辛纳泰克系统公司（美）

该公司已并入霍尼韦尔公司（Honeywell, Inc.）。其产品型号由 5 部分组成，例如：

SY M C 2114 L3



- ① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 使用温度范围：
 - 空 0~+70℃
 - M 军品级 (-55~+125℃)
 - X 专用
- ③ 封装形式：
 - C 陶瓷封装
 - P 塑封
 - D 陶瓷 DIP
 - X 芯片
 - F 扁平封装
 - T TO 壳封装
- ④ 器件标号。
- ⑤ 性能或工艺标志。

Supertex, Inc. (Supertex)

超科公司 (美)

<http://www.supertex.com/>

该公司的产品型号由 3 部分组成，例如：

CM 6400 P

- ① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 表示芯片系列：
 - HV 高压 IC
 - SD 烟雾探测器
 - HT 晶体管阵列
 - MP 电源支撑件
 - ED 可编程编码器/解码器



Supertex inc.

DC	数据编码器
ET	编码器/发送器
CM	CMOS 存储器
RCMP	电源支撑件

② 器件标号。

③ 封装形式：

C	陶瓷边铜焊 DIP
D	陶瓷 DIP
X	芯片包封
L	无引脚芯片载体封装
T	自动焊带封装
PC	塑料 DIP
PC	有引脚芯片载体塑料封装
PJ	有引脚芯片载体塑料封装
DJ	无引脚芯片载体陶瓷封装
LC	无引脚芯片载体陶瓷封装
PG	四边引脚小型塑封（带鸥翼式引脚）
DC	四边引脚小型塑封（带鸥翼式引脚）
CF	扁平引脚芯片载体陶瓷封装
CS	标准弯头引脚芯片载体陶瓷封装
CR	引脚反弯芯片载体陶瓷封装
WG	小型封装

Teledyne Semiconductor Corp. (Teledyne)

德律戴恩半导体公司（美）

<http://www.microchip.com>

该公司现已并入微芯片科技公司（Microchip Technology Inc.）。其产品型号由 8 部分组成，例如：

TSC 7660 A X M J A / 883



- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 器件标号。

③ 改型标志。

④ 引脚选择。

⑤ 使用温度范围：

C 商业级 ($0\sim+70^{\circ}\text{C}$)

I 工业级 ($-25\sim+85^{\circ}\text{C}$)，($-40\sim+85^{\circ}\text{C}$)

M 军品级 ($-55\sim+125^{\circ}\text{C}$)

⑥ 封装形式：

J 塑料 DIP

N 陶瓷 DIP

L 陶瓷-玻璃 DIP

E 金属壳 (TO-99) 封装

M 金属壳 (TO-18) 封装

P 塑料 DIP

T 金属壳 (TO-99) 封装

B 扁平塑封

S 扁平塑封 (非成型的直列引脚)

O 塑封 (小型表面贴装器件)

⑦ 引出端口数：

A 8

D 14

E 16

F 22

N 18

G 24

I 28

L 40

Y 8 (引出端 4 连接到外壳)
Q 60
S 68
W 40

⑧ 筛选方法:

空 标准工艺
/883 按 MIL-STD-883B 级标准筛选
/BI 在 125°C 下, 100%老化 (160 小时)

Telefunken Electronic GmbH (Telefunken)

特洛芬肯电子公司 (德)

<http://www.telefunken.de>

该公司的产品型号由 5 部分组成, 例如:

U 2029 M V A
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 封装形式:

U 单片集成电路
T 芯片 (无包封)
M 多芯片封装

② 器件标号。

③ 工艺:

B 双极型 IC
M MOS 或混合组件
U 集成元件

④ 芯片分类:

C 在载体上分开和测量芯片
F 在延长的薄片上分开和测量芯片
M 在非延长的薄片上分开和测量芯片
V 在真空封装内分开和测量芯片



W 在塑料盒内封装测量芯片（薄片不分开）

⑤ 背面材料：

空 没有金属化

A 铝

G 金属

S 银

Teledyne Philbrick(Teledyne)

德律戴恩菲尔布里克公司（美）

该公司的产品型号主要分为下列几个系列：

- | | |
|---------|----------------|
| 1000 系列 | 运算放大器，组件 |
| 1300 系列 | 运算放大器，集成电路 |
| 1400 系列 | 运算放大器，场效应集成电路 |
| 1700 系列 | 运算放大器，稳定斩波器 |
| 2200 系列 | 电源，交流输入，印刷电路装配 |
| 2300 系列 | 电源，直流输入，印刷电路装配 |
| 2400 系列 | 电源，交流输入，机壳安装 |
| 4000 系列 | 模数转换器 |
| 4100 系列 | 数模转换器 |
| 4200 系列 | 模数测量放大器 |
| 4300 系列 | 非线性功能组件 |
| 4700 系列 | 电压-频率与频率-电压转换器 |
| 4800 系列 | 采样/保持放大器 |
| 4900 系列 | Degtitlbers |



Teltone Corporation(Teltone)

泰尔通公司（美）

<http://www.teltone.com>



该公司的产品型号由 3 部分组成，例如：

M 980 P

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 器件标号。

③ 封装形式：

P 塑料 DIP

C 陶瓷 DIP

Texas Instruments, nc. (TI)

得州仪器公司(美)

<http://www.ti.com>



该公司的产品型号共有 5 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成，例如：

SN 74 S188 J

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片类别：

AC 先进双极型电路

SBP 双极微处理器

SMJ MOS 存储器和微处理器 883B

SN 标准电路

SNJ 标准电路：883B, JEDEC, STD101

TAC CMOS 逻辑阵列

TAL 低功耗肖特基 TTL 逻辑阵列

TAL STL 逻辑阵列

TL 线性电路

TLC 线性 CMOS 电路

TIEF 红外源

TIEPLA 双极场效应可编程逻辑阵列

TIBPAL	双极, 可编程逻辑阵列
FP	矩形芯片载体 (适合 DRAM)
TMS	MOS 存储器/微处理器
TM	微处理器, SIP 封装存储器
TBP	双极存储器
TC	CCD 器件
TCM	通信电路
TIED	红外检波器
TIL	光电电路
VM	音频存储器
JANP	JM38510, B 级
JBP	双极 PROM, 883C, JEDEC, STD101

② 使用温度范围: 74、74H、74LS、74S、75、74AS、74HC/74HCT*、74ALS、74F、74BCT 为 0~+70℃, 带“*”者-40~+80℃; 54、54H、54L、54LS、54S、55、54AS、54HG/54HCT、54ALS、54F、54BCT 为-55~+125℃。

③ 器件标号。

④ 封装形式:

JT	陶瓷 DIP (24 引脚, 300 密耳)
J、JG	陶瓷 DIP
JD	边铜焊陶瓷 DIP
KA、KC、KD、KF	塑封 (功率翼)
LP	3 引脚塑封
N、NE	塑封 DIP
T	金属扁平封装
WA、W	陶瓷扁平封装
NT	塑料 DIP (24 引脚, 300 密耳)
U	陶瓷扁平封装
NF	塑封 DIP (28 引脚 400 密耳)
FH	陶瓷单层方形芯片载体封装 (JEDEC 标准)
FN	单层方形芯片载体塑料封装

FK	多层方形芯片载体封装 (JEDEC 标准)
FE	多层矩形芯片载体封装
WC	陶瓷扁平封装
FG	多层矩形芯片载体封装 (JEDEC 标准)
D	小型封装 (150 密耳)
DW	小型封装 (300 密耳)
FM	矩形芯片载体封装 (DRAM)
DJ	小型封装, 适用于 J 引脚存储器、低功耗 TTL、低功耗肖特基 TTL、肖特基 TTL、标准接口、先进肖特基 TTL、高速 CMOS、先进低功耗肖特基 TTL、先进器件

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 3 部分组成, 例如:

N 82LS10 F

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 使用温度范围:

N	商业级 (0~+70℃)
75	商业级 (0~+70℃)
NE	商业级 (0~+70℃)
55	军品级 (-55~+125℃)
SE	军品级 (-55~+125℃)
S	军品级 (-55~+125℃)
SA	工业级 (-40~+85℃)
SU	扩展 (-25~+85℃)

② 器件标号。

③ 封装形式:

D	塑封 (表面贴装器件)
N	塑料 DIP
A	有引脚芯片载体塑料封装

F	14、16、18、20、22、24 引脚陶瓷 DIP
G	无引脚芯片载体陶瓷封装
H	TO-5 壳封装
I	8~50 引脚陶瓷 DIP
K	2 引脚 TO-3 壳封装
Q	陶瓷扁平封装
R	陶瓷扁平封装（带翼）
U	9、13 引脚 SIP
Y	24 引脚陶瓷扁平方形封装（辐射引脚）
W	10、14、15、24 引脚扁平封装
CK	十字形芯片
EC	4 引脚 TO-46 壳封装
EE	4 引脚 TO-72 壳封装
FE	8 引脚 DIP
SK	微处理器组件
TA	8 引脚 TO-5 壳封装
N14	14 引脚 DIP 塑封

3. 第 3 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

TMS **44C257** - **12** **DJ** **L**
 ① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 表示芯片系列，同第 1 类产品。
- ② 器件标号。
- ③ 为最大值存取时间：

3	35ns
4	45ns
5	55ns
7	70ns
10	100ns

12	120ns
15	150ns
20	200ns
25	250ns
30	300ns
35	350ns
40	400ns
50	500ns

④ 封装形式，同第 1 类产品。

⑤ 使用温度范围：

空、C、L	商业级 (0~+70℃)
I、E	工业级 (-40~+85℃)
S	扩展 (-55~+100℃)
M	军品级 (-55~+125℃)

4. 第 4 类产品型号命名规则

该类产品型号由 8 部分组成，例如：

TIB **PAL** **16** **R** **4** **-15** **M** **J**
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 表示芯片系列：

TIB	双极 PAL
TIC	CMOS PAL
TIE	ECC PAL

③ 输入端数。

④ 输出配置：

R	寄存器
L	低电平有效
X	异或

⑤ 输出端数。

⑥ 最大存取时间:

-10 100ns

-12 120ns

-15 150ns

A 高速

A-2 高速低功耗

⑦ 使用温度范围, 同第 3 类产品。

⑧ 封装形式, 同第 1 类产品。

5. 第 5 类产品型号命名规则

该类产品型号由 8 部分组成, 例如:

SMJ **6** **8** **CE** **64** - **25** **JD** **M**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示产品系列:

TMS 商业级 MOS 电路

SMJ 军品级 MOS 电路

TMX 预研产品, 商业级 MOS 电路

② 芯片类别:

4 DRAM/FRAM

6 SRAM (军品级)

③ 字宽:

1 1bit

4 4 bit

8 8 bit (SRAM)

9 9 bit (SRAM)

④ 工艺类别:

C CMOS

CE CMOS, 输出使能控制 (对于 SRAM)

CD CMOS, I/O 端分开 (对于 SRAM)

空 NMOS

⑤ 密度:

16	16K SRAM
16	16K DRAM
64	64K DRAM
64	64K SRAM
61	64K VRAM
72	72K SRAM
64	256K DRAM
61	256K VRAM
256	256K DRAM
257	256K DRAM
256	256K 8RAM
288	288K SRAM
256	1M DRAM
257	1M DRAM
251	1M VRAM
1024	1M DRAM
1025	1M DRAM
1027	1M DRAM
1050	1M FRAM

⑥ 表示芯片速度。

对 SRAM:

25	25ns
35	35ns
45	45ns
55	55ns

对 DRAM:

8	80ns
10	100ns
12	120ns

15 150ns

20 100ns

对 FRAM:

3 25ns

4 30ns

6 50ns

⑦ 封装形式。

对商业级塑封:

DJ 小型, J 引脚

FM 有引脚芯片载体塑料封装

SD 分支交叉直插封装

N DIP

对军品级陶瓷封装:

JD DIP

HJ 小型封装 (J 引脚)

FG 或 FV 无引脚芯片载体陶瓷封装

⑧ 使用温度范围:

空 商业级 (0~+70°C)

L 商业级 (0~+70°C)

S 扩展 (-55~+100°C)

M 军品级 (-55~+125°C)

Texas Instruments Ltd. (TI)

德州仪器有限责任公司 (英)

<http://www.ti.com>

该公司的产品型号由 5 部分组成, 例如:

TLC **27M2** **B** **I** **JG**

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。



① 表示芯片类别:

SN	标准产品
AC	先进双极型电路
TL	线性电路
SBP	双极型微处理器
SMJ	MOS 存储器和微处理器 (883B)
SNJ	标准电路: 883, JEDEC, STD101
TAC	CMOS 逻辑阵列
TAL	低功耗肖特基 TTL 逻辑阵列
TAT	STL 逻辑阵列
TLC	线性 CMOS 电路
TMS	MOS 存储器/微处理器
TBP	双极标准电路
TIES	红外源
TIEF	互阻抗放大器
TTFLPA	双极场效应可编程逻辑阵列
TIBPAL	双极可编程阵列逻辑
JANB	JM38510

② 器件标号。

③ 改型标志。

④ 使用温度范围:

空	商业级 (0~+70℃)
C、L	商业级 (0~+70℃)
I、E	工业级 (-40~+85℃)
S	扩展 (-55~+100℃)
M	军品级 (-55~+125℃)

⑤ 封装形式:

FM, FN	有引脚芯片载体塑料封装
W, Y	DIP
GB	引脚栅格状排列封装

JD	边铜焊陶瓷 DIP
T	金属扁平封装
JD, JG, JT, J	陶瓷 DIP
NE, NW, NT, N, P	塑料 DIP
U, S, W	陶瓷扁平封装
AD, D, DW, DY	小型封装
FG, FH, JK, FK, JW	无引脚芯片载体封装
U, AD, P, L, C	SIP (存储器类)
KC	TO-220 外壳封装 (带散热片)
LP	TO-92 外壳封装
PQ	四边引脚扁平塑封
KP	SIP (带散热片)

Thaler Corporation(Thaler)

萨勒公司(美)

<http://www.thaler.com>



该公司的产品型号由 6 部分组成, 例如:

VRE **102** **M** **A** **F** **-3**
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片类别:

VRE 电压基准源
 ADC 模数转换器
 DAC 数模转换器
 IRE 电流基准源
 SWR Wine 波参考源

② 器件标号。

③ 产品等级:

C 工业级 (-25~+85℃)
 M 军品级 (-55~+125℃)

- ④ 电气等级。
- ⑤ 封装形式：
 - 空 陶瓷 DIP
 - F 金属扁平
- ⑥ 惯例标志。

Third Domain, Inc.
 第三产业公司（美）



该公司的产品型号由 4 部分组成，例如：

RSS **100** **C** **D**
 ① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，有 RSS, VC, VSC, VLD, RCS, VSM, VLC。
- ② 器件标号。
- ③ 使用温度范围：
 - C 商业级（0~+70℃）
 - M 军品级（-55~+125℃）
- ④ 封装形式：
 - D 陶瓷 DIP
 - N 塑料 DIP

Thomson CSF
 汤姆逊半导体公司（法）
<http://www.thomson-csf.com>



该公司现属法国泰雷兹（Thales）集团，其产品型号共有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

TLC **25L2** **A** **C** **D**
 ① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片系列:

SN	标准电路
AC	先进双极型电路
TL	线性电路
LT	运算放大器
MC	放大器
LM	运算放大器
UA	电压调节器
NE	定时器
OP	运算放大器
TGA	放大器
SBP	双极型微处理器
SMT	MOS 存储器和微处理器
883B、SNJ	标准电路 (883, JEDEC, STD101)
TAC	CMOS 逻辑阵列
TAL	低功耗肖特基 TTL 逻辑阵列
TAT	STL 逻辑阵列
TLC	线性 CMOS 电路
TMS	MOS 存储器/微处理器
TBP	双极标准电路
TLES	红外源
TIEF	互阻抗放大器
JANB	JM38510
TIFLPA	双极场效应可编程逻辑阵列
TIBPAL	双极可编程逻辑阵列

② 器件标号。

③ 改型标志。

④ 使用温度范围:

空 商业级 (0~+70℃)

C、L 商业级 (0~+80℃)

- I、E 工业级 (-40~+85℃)
- S 扩展 (-55~+100℃)
- M 军品级 (-55~+125℃)

⑤ 封装形式:

- D 塑封 (表面贴装器件)
- N 塑料 DIP
- A 有引脚芯片载体塑料封装
- F 14、16、18、20、22、24 引脚陶瓷 DIP
- G 无引脚芯片载体陶瓷封装
- H TO-5 壳封装
- I 8~50 引脚陶瓷 DIP
- K 2 引脚 TO-3 壳封装
- Q 陶瓷扁平封装
- R 陶瓷扁平封装 (带翼)
- U 9、13 引脚 SIP
- Y 24 引脚陶瓷扁平方形封装 (辐射引脚)
- W 10、14、15、24 引脚扁平封装
- CK 十字形芯片
- EC 4 引脚 TO-46 壳封装
- EE 4 引脚 TO-72 壳封装
- FE 8 引脚 DIP
- SK 微处理器组件
- TA 8 引脚 TO-5 壳封装
- N14 14 引脚 DIP 塑封

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成, 例如:

SF C 2318 A DC

- ① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片系列, 其中

第 1 个字母表示电路类别:

- S 数字集成电路
- T 模拟集成电路
- U 混合电路

第 2 个字母可为除 A、B、C 或 H 之外任一字母。

② 使用温度范围:

- A 非标准
- B $0\sim+70^{\circ}\text{C}$
- C $-55\sim+125^{\circ}\text{C}$
- D $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$
- E $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$
- F $-40\sim+85^{\circ}\text{C}$

③ 器件标号。

④ 改型标志。

⑤ 表示封装形式, 其中

第 1 个字母表示形状:

- C 圆柱形封装
- D DIP
- E 功率 DIP (带散热片)
- F 扁平封装 (2 引脚)
- G 扁平封装 (4 引脚)
- K TO-3 外壳封装
- M 多层引脚封装 (多于 4 行)
- Q 四边引脚封装
- R 四边引脚功率器件 (带散热片)
- S SIP
- T 三列直插式封装
- L 四列直插封装
- N 四列直插封装
- P 扁平封装

U 小型封装

第 2 个字母表明所用材料:

B 陶瓷 (翼式)

C 陶瓷

G 玻璃/陶瓷

M 金属

P 塑料

X 其他

T 陶瓷

Toko America, Inc. (Toko)

Toko 美国有限公司 (美)

<http://www.tokoam.com>



该公司的产品型号由 3 部分组成, 例如:

TK 1042 D

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商。

② 器件标号。

③ 封装形式:

D 小型封装 (鸥翼式)

M 小型封装

D DIP

Z TO-92 晶体管型封装或分支交叉直插封装

AD DIP

空 TO-92 型外壳封装或 DIP

Topaz Semiconductor Inc. (Topaz)

黄晶半导体公司 (美)

该公司的产品型号由 3 部分组成, 例如:



CDG 2214 BJ

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示产品类别：

CDG	模拟开关
VQ	晶体管阵列
SD	功率场效应管 (P 沟道)
VP	功率场效应管 (P 沟道)
AN	功率场效应管 (N 沟道)
TN	功率场效应管 (N 沟道)
TZ	功率场效应管 (N 沟道)
VN	功率场效应管 (N 沟道)

② 器件标号。

③ 表示封装形式。

对集成电路：

BJ	塑料 8 引脚 DIP，工业级 (-40~+85℃)
AK	8 引脚陶瓷 DIP，军品级 (-55~+125℃)
J	16 引脚陶瓷 DIP
N	16 引脚塑料 DIP

对分立元件：

DD	TO-18 外壳气密性封装
HD	TO-39 或 TO-99 外壳密封
BD	TO-92 或外壳塑封
AD	TO-237 (92+) 外壳塑封
DB	TO-72 外壳金属封装

Toshiba America, Inc. (Toshiba)

东芝美国有限公司 (美)

<http://www.toshiba.com/tai/>

TOSHIBA

该公司的产品型号共有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 6 部分组成，例如：

TMM 2068 A D I 45

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示芯片系列：

TD	双极型数字电路
TC	CMOS 存储器
TA	双极线性电路
TMM	NMOS 存储器
TCP	微处理器，控制器
TMP	微处理器/微机

② 器件标号。

③ 改型标志。

④ 封装形式：

C	陶瓷封装
D	陶瓷-玻璃 DIP
P	塑料 DIP
F	扁平封装
J	塑封（内引脚弯成 J 形）
T	有引脚芯片载体塑料封装
Z	分支交叉直插封装

⑤ 芯片等级：

I	工业级（-40~+85℃）
L	低功耗

⑥ 最大存取时间或传输延迟时间。

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

TC **74** **HC** **323** **P**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，同第 1 类产品。

② 芯片系列：

40H×××	和 54/74TTL 电路外引脚功能端排列顺序相同
50×××	东芝公司老产品
4×××	同 RCA 的 CD4×××系列兼容

45××× 东芝公司老产品
74 同 TTL74 系列兼容
54 同 TTL54 系列兼容

③ 类型:

HC、HCV、HCT、AC ACT JEDEC 标准

④ 器件标号。

⑤ 封装形式:

P 塑封
F 扁平或窄间距 (200 密耳) 封装
M 金属封装
C 陶瓷封装
J 内引脚弯成 J 形封装
D 陶瓷 DIP
Z 分支交叉直插封装
U 微型扁平封装
FU 小型封装 (150 密耳)
FW 小型封装 (300 密耳)

Toshiba Corp. (Toshiba)

东芝公司 (日)

<http://www.toshiba.com>

TOSHIBA

该公司的产品型号共有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成, 例如:

TC **40** **H** **164** **F**
① ② ③ ④ ⑤

① 工艺:

TA 双极线性
TC CMOS
TD 双极数字
TMM NMOS 存储器

② 芯片系列:

40H××× 和 54/74TTL 电路外引脚功能端排列顺序相同
50××× 东芝公司老产品

4×××	同 RCA 的 CD4×××系列兼容
45×××	东芝公司老产品
74	同 TTL74 系列兼容
54	同 TTL54 系列兼容

③ 类型:

HC、HCV、HCT、AC ACT JEDEC 标准

④ 器件标号。

⑤ 封装形式:

P 塑封

F 扁平或窄间距 (200 密耳) 封装

M 金属封装

C 陶瓷封装

J 内引脚弯成 J 形封装

D 陶瓷 DIP

Z 分支交叉直插封装

U 微型扁平封装

FU 小型封装 (150 密耳)

FW 小型封装 (300 密耳)

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成, 例如:

TMM **2016A** **D** **I** **15**

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示芯片系列:

TD 双极型数字电路

TC CMOS 存储器

TA 双极线性电路

TMM NMOS 存储器

TCP 微处理器, 控制器

TMP 微处理器/微机

- ② 器件标号。
- ③ 封装形式（同上述第 1 类产品）。
- ④ 筛选等级：
 - I 工业级（-40~+85℃）
 - L 低功耗
- ⑤ 芯片速度：

表明最大存取时间或传输延迟时间。

Toyocom USA, Inc. (Toyocom)
 美国东洋通信机美国有限公司（美）
<http://www.toyocom.com>

该公司的产品型号由 3 部分组成，例如：

TH 2C1004 GM
 ① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 封装形式：
 - GM 分支交叉直插封装
 - M 分支交叉直插封装
 - B 无引脚单列封装

TRW LSI Products, Inc. (TRW)
 TRW 大规模集成电路产品公司（美）



该公司的产品型号共有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 5 部分组成，例如：

TDC 1016 J5 C 10
 ① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片类别:

MPY 三重扩散双极型乘法器
TDC TRW 公司三重扩散双极型编目产品
TMC TRW 公司 CMOS 编目产品
THC TRW 公司混合电路

② 器件标号。

③ 封装形式:

J0 64 引脚密封陶瓷 DIP
J1 64 引脚密封陶瓷 DIP (带扁平散热片)
J3 64 引脚密封陶瓷 DIP
J4 48 引脚密封陶瓷 DIP
J5 40 引脚密封陶瓷 DIP
J6 28 引脚密封陶瓷 mP
J7 24 引脚密封陶瓷 DIP
J8 18 引脚密封陶瓷 DIP
J9 16 引脚密封陶瓷 DIP
A1 68 接点 JEDECA 芯片载体封装
C1 68 接点密封陶瓷芯片载体封装
C2 44 接点密封陶瓷芯片载体封装
C3 28 接点密封陶瓷芯片载体封装
E1 印刷电路板 (欧式, 100mm×160mm)
P1 印刷电路板 (标准式, 4.5 英寸×5.5 英寸)
L1 68 引脚密封芯片载体陶瓷封装
B2 24 引脚 DIP (0.3 英寸宽)
B5 40 引脚 DIP
B6 28 引脚 DIP
B7 24 引脚 DIP (0.6 英寸宽)
B8 18 引脚 DIP
G5 88 引脚栅空心封装 (不带散热片)
G8 68 引脚栅空心 (不带散热片)

- N0 64 引脚塑料 DIP
 - N4 48 引脚塑料 DIP
 - N5 40 引脚塑料 DIP
 - N6 28 引脚塑料 DIP
 - N7 24 引脚塑料 DIP
 - N9 16 引脚塑料 DIP
 - S5 32 引脚金属封装 DIP
 - S7 24 引脚金属密封 DIP
 - H5 88 引脚栅格塑封
 - H8 68 引脚栅格塑封
 - R4 84 引脚芯片载体封装
 - R1 68 引脚芯片载体封装
 - R2 44 引脚芯片载体封装
 - R3 28 引脚芯片载体封装
- ④ 使用温度范围，筛选等级：
- C 商业级（0~+70℃）
 - N 商业级（0~+70℃）
 - G 商业级，带老化
 - F 军品级（-55~+125℃）
 - A 军品级，高可靠

⑤ 电特性。

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 4 部分组成，例如：

TDC 1005 J9 F

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 表示芯片系列，第 1 类产品。
- ② 器件标号。
- ③ 封装形式，同第 1 类产品。
- ④ 使用温度范围筛选

- C 商业级 (0~+70℃)
- N 商业级 (0~+70℃)
- G 商业级, 带老化
- F 军品级 (-55~+125℃)
- A 军品级, 高可靠

United Technologies Microelectronics Center (UTMC)

微电子联合中心 (美)

<http://www.utmc.com>



该公司现已并入美国艾法斯 (Aeroflex) 公司, 其产品型号由 4 部分组成, 例如:



UT 1553BRTI G A

- ① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 封装形式:
 - A 无引脚芯片载体封装
 - G 引脚阵列排列封装
 - K 引脚芯片载体封装
 - L 引脚芯片载体封装 (鸥翼式)

Unitrode Corp. (Unitrode)

尤尼罗德公司 (美)

<http://www.unitrode.com>



该公司现属德州仪器公司 (TI) 的产品型号由 5 部分组成, 例如:

UC 7812 A C K

- ① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 生产厂商和芯片类别:
 - UC 线性集成电路

UCC BICMOS

② 器件标号。

③ 改型标志。

④ 使用温度范围：

C 0~+70℃

空 军品级

⑤ 封装形式：

J 玻璃封焊陶瓷 DIP

N 塑料 DIP

D 小型表面贴装

S 边铜焊陶瓷 DIP

L 无引脚芯片载体陶瓷封装

Q 有引脚芯片载体塑料封装

E DIP

B DIP

V ZIP

H TO-5 金属壳封装

K TO-3 钢座功率器件封装

T TO-220 塑封功率器件封装

P 陶瓷封装

VH 垂直安装分支交叉直插封装

Valvo GmbH(Valvo)

沃奥格姆巴公司(德)

<http://www.valvo.com>

该公司的产品型号由 2 部分组成，例如：

87C61 - 20

①

②

各部分字母和数字含义如下。

① 器件标号，其中字母表明工艺：

C CMOS



HC 高速 CMOS

② 最大存取时间:

15 150ns

20 200ns

25 250ns

30 300ns

Vitesse Semiconductor Corporation (Vitesse)

威泰斯半导体公司 (美)

<http://www.vitesse.com>

VITESSE

该公司的产品型号由 5 部分组成, 例如:

VS **12G422T** **L** **M** **10**

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商。

② 器件标号。

③ 封装形式:

L 无引脚芯片载体封装

F 无引脚芯片载体封装

D DIP

④ 使用温度范围:

C 商业级 (0~+70°C)

I 工业级 (-40~+85°C)

M 军品级 (-55~+125°C)

⑤ 附加说明, 如存取时间等。

VLSI Technology, Inc. (VLSI)

VLSI 技术公司 (美)

该公司已并入菲利普公司, 其产品型号由 5 部分组成, 例如:



VT 20C18 - 20 P C

① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商，有 VL、VT、V 和 VM。

② 器件标号。

③ 最大存取时间 (ns)。

④ 封装形式：

L 无引脚芯片载体封装

Q 无引脚芯片载体封装

J 无引脚芯片载体封装

C 陶瓷 DIP

P 塑料 DIP

T 膜状陶瓷边铜焊 DIP

D 陶瓷-玻璃 DIP

S 膜状塑料 DIP

G 无引脚芯片载体陶瓷封装

F 小型封装

⑤ 使用温度范围：

空 商业级 (0~+70℃)

C 商业级 (0~+70℃)

I 工业级 (-40~+85℃)

X 军品级 (-55~+125℃)

VTC Incorporated(VTC)

VTC 公司(美)

该公司的产品型号由 6 部分组成，例如：

V B A 705 D K

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。



② 筛选等级:

- J 军品级
- B 老化 (在 150℃下老化 168 小时)
- 空 无筛选工艺

③ 表示芯片系列:

- A 放大器
- C 比较器和数据转换器
- M 大容量存储器 (磁盘、带驱动电路)
- S 专用接口电路

④ 器件标号。

⑤ 封装形式:

- D 陶瓷 DIP
- F 扁平封装
- P 塑料 DIP
- J 边铜焊陶瓷 DIP
- T 金属壳封装
- X 芯片包封
- DL 无引脚芯片载体陶瓷封装
- DS 陶瓷细引脚 DIP
- PO 塑封 (小型)
- PS 塑料 DIP (细引脚)
- DK 无引脚芯片载体陶瓷封装
- PL 有引脚芯片载体塑料封装
- TB TAB PAC (大容量存储器封装)

⑥ 使用温度范围:

- J~R 商业级 (0~+70℃)
- S~Z 军品级 (-55~+125℃)

Walmsley Microsystems Ltd. (WML)

沃姆斯莱微系统公司（英）

该公司的产品型号由 2 部分组成，例如：

WA 1001

① ②

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示芯片类别：

WA 模拟器件

WS 数字系统

W1 成像器件

② 器件标号。

Waferscale Integated, Inc. (WSI)

晶片集成电路公司（美）

<http://www.st.com>

该公司现属意法半导体公司（ST Microelectronics），
其产品型号由 6 部分组成，例如：

WS 27C128 - 20 B M S

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 器件标号，其中字母表明改型。

③ 芯片速度：

50 50ns

20 200ns

25 250ns

30 300ns

④ 封装形式：

B 边铜焊陶瓷 DIP（64 引脚）

J 引脚芯片载体塑料封装（68 引脚）



- C 无引脚芯片载体陶瓷封装 (68 引脚)
- P 塑料 DIP (64 引脚)
- G 引脚阵列排列陶瓷封装 (101 引脚)
- D 陶瓷-玻璃 DIP

⑤ 使用温度范围:

- 空 商业级 (0~+70℃)
- S 商业级 (0~+70℃)
- M 军品级 (-55~+125℃)

⑥ 筛选方法:

- 空 标准工艺
- S WSI 标准工艺
- H WSI 高可靠
- F 标准/高可靠 (任选)

Weitek Corp. (Weitek)

威泰克公司 (美)

<http://www.conexant.com>

该公司已并入罗克威尔公司 (Rockwell International Corp.), 后又随罗克威尔公司并入科胜讯系统公司 (Conexant Systems, Inc.)。其产品型号由 5 部分组成, 例如:

WTL **1066** **10** **G** **CD**
 ① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 高大速度值 (MHz)。
- ④ 封装形式:
 - G 引脚阵列封装
- ⑤ 使用温度范围:



C O N E X A N T

CD 商业级 (0~+70℃)

MD 军品级 (-55~+125℃)

Western Design Center(WDC)

西方设计中心(美)

<http://www.wdesignc.com>



该公司的产品型号由 5 部分组成, 例如:

W **65C816** **P** **I** **4**
① ② ③ ④ ⑤

各部分字母和数字含义如下。

① 表示芯片系列:

W 标准电路

WD 定制电路

② 器件标号。

③ 封装形式:

P 塑封

C 陶瓷封装

D 陶瓷-玻璃 DIP

X 芯片包封

④ 使用温度范围:

空 0~+70℃

I -40~+85℃

M -55~+125℃

⑤ 芯片速度:

4 4MHz

6 6MHz

8 8MHz

10 10MHz

Western Digital Corp. (WD)

西部数据公司 (美)

<http://www.wdc.com>



该公司原名通用数据公司 (General Digital), 1971 年改为现名, 其产品型号由 3 部分组成, 例如:

WD 1510 -PH01

① ② ③

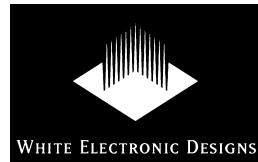
各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 有 WD、CP、BR、TR、UC、FD、DM、W、PT。
- ② 器件标号, 可以包含一个字母, 为改型标志。
- ③ 型号变化。

White Electronic Designs Corporation (WEDC)

怀特电子设计公司 (美)

<http://www.whiteedc.com>



该公司是 1998 年由 Bowmar Instrument Corporation (White Microelectronics) 和 Electronic Designs, Inc. 合并而成。

1. 1987 年之前产品

该公司 1987 年前的产品型号由 7 部分组成, 例如:

EDH 8 C 10 LP J M

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 产品功能类别:
 - 4 DRAM
 - 5 EEPROM
 - 6 μ PAK
 - 7 UVEPROM
 - 8 SRAM
- ③ 工艺类别:

- C CMOS, 4T
 - HC 高速 CMOS
 - CL CMOS, 6T
 - N 半字节 (DRAM)
- ④ 芯片存取速度:
- 70 70ns
 - 10 100ns
- ⑤ 芯片功耗: (仅 8K×8 系列)
- 空 标准功耗
 - LP 低功耗
- ⑥ 封装形式:
- J 无引脚芯片载体陶瓷封装
 - P 陶瓷封装 (在陶瓷基片上)
 - K 陶瓷边铜焊封装
- ⑦ 使用温度范围:
- C 商业级
 - I 工业级
 - M 军品级

2. 1987 年之后产品

该公司 1987 年后产品型号由 7 部分组成, 例如:

EDI 8 M C 100 C B
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀, 表示生产厂商。
- ② 表示芯片系列:
- 4 DRAM
 - 5 EEPROM
 - 6 μPAK
 - 7 UVEPROM
 - 8 SRAM

9 特殊芯片

③ 功能分类：

空 单片

M 组件（陶瓷）

F 组件（FR4）

④ 表示工艺类别：

B 双极

N NMOS

C CMOS, 4T 标准功耗

P CMOS, 4T 低功耗

H CMOS, 6T 标准功耗

L CMOS, 6T 低功耗

⑤ 表示芯片存取速度：

20 20ns

100 100ns

200 200ns

⑥ 封装形式：

P 单片塑料 DIP

C 单片陶瓷 DIP

D 陶瓷 DIP（600 密耳）

T 薄片 DIP（400 密耳）

L 无引脚芯片载体陶瓷封装

J 无引脚芯片载体陶瓷封装

Y 有引脚芯片载体塑料封装

G 外引脚阵列排列封装

F 扁平封装

U 小方块包封

S SIP 封装

Z DIP 封装

W 小间距外引脚封装

Q 陶瓷膜 DIP (300 密耳)

R 陶瓷膜 DIP (300 密耳)

⑦ 使用温度范围:

C 商业级

I 工业级

M 军品级

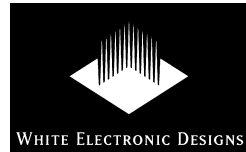
B 军品级, MIL-STD-88C, B 级

White Microelectronics

怀特微电子公司 (美)

<http://www.whiteedc.com>

1998 年该公司与 Electronic Designs, Inc. 合并, 组建为怀特电子设计公司 (White Electronic Designs Corporation)。该公司的产品型号由 3 部分组成, 例如:



DHC8 **M** **16**

① ② ③

各部分字母和数字含义如下。

① 器件标号。

② 芯片功能:

DPDS 双平行, 双串行

M 存储器

③ 附加说明。

Xicor, Inc. (Xicor)

辛卡公司 (美)

<http://www.xicor.com>



该公司已并入英特矽尔 (Intersil) 公司, 其产品型号由 6 部分组成, 例如:

X **2004** **D** **M** **25** **/5**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀，表示生产厂商。

② 器件标号。

③ 封装形式：

- P 塑料 DIP
- D 陶瓷-玻璃 DIP
- E 无引脚芯片载体陶瓷封装
- H 芯片包封
- K 引脚阵列排列封装
- J 有引脚芯片载体塑料封装
- G 玻璃烧结封装
- S 小型封装

④ 使用温度范围：

- 空 商业级 ($0\sim+70^{\circ}\text{C}$)
- I 工业级 ($-40\sim+85^{\circ}\text{C}$)
- M 军品级 ($-55\sim+125^{\circ}\text{C}$)

⑤ 最大存取时间：

- 15 150ns
- 20 200ns
- 25 250ns
- 30 300ns
- 35 350ns
- B MIL-STD-883-REVC, B 级

⑥ 寿命：

- /5 5000 数据变化/位
- /10 10000 数据变化/位
- 空 1000 数据变化/位

Zilog, Inc. (ZiLOG)

齐洛格公司(美)

<http://www.zilog.com>

Zilog

该公司的产品型号有 2 种命名规则。

1. 第 1 类产品型号命名规则

该类产品型号由 7 部分组成, 例如:

Z **80320** **08** **V** **S** **C** **Rxxx**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各部分字母和数字含义如下。

① 前缀, 表示生产厂商。

② 器件标号。

③ 芯片速度。

④ 封装形式:

D 陶瓷-玻璃 DIP

P 塑料

V 芯片载体塑料封装

⑤ 使用温度范围:

S 0~+70°C

E -40~+85°C

M -55~+125°C

⑥ 封装材料:

C 塑料标准

E 密封标准

F 原来标准

⑦ ROM 掩模数 (R 后面的 3 位数字表示掩模数)。

2. 第 2 类产品型号命名规则

该类产品型号由 6 部分组成, 例如:

Z **80** **A** **CPU** **C** **M**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 芯片速度：
 - A 4MHz
 - 空 2.5MHz
- ④ 芯片类别：
 - CPU 中央处理器单元
 - PIO 输入/输出单元
 - STC 计数定时器
 - VSIO 串行输入/输出
 - DMA 直接存取存储器
- ⑤ 封装材料：
 - C 陶瓷封装
 - P 塑料封装
- ⑥ 筛选方法：
 - S 按标准筛选方法
 - H 按军品级筛选方法

Zyrel, Inc. (Zyrel)

西奈尔公司（美）

<http://www.zyrel.com>



该公司的产品型号由 4 部分组成，例如：

Z 108 L 10

① ② ③ ④

各部分字母和数字含义如下。

- ① 前缀，表示生产厂商。
- ② 器件标号。
- ③ 芯片功耗：
 - 空 标准功耗
 - L 低功耗

④ 最大存取时间:

10 100ns

15 150ns

20 200ns

25 250ns

30 300ns

附录 集成电路引脚功能及电路 常用英文缩写词汇编

本附录收集了集成电路引脚功能及电路英文常用缩写词约 3000 条,各词条按英文字母顺序排列。对同一缩写词的近似意义均用逗号隔开,不同意义则用分号隔开。

△

A/B answer back 应答,对答,回答信号;通道 A/B 选择

A/D analog to digital 模拟-数字(转换)

A/S asynchronous/synchronous 异步/同步选择; add/subtraction 加/减(选择)

A,a address 地址; analog 模拟; anode 阳极,正极

AA Alternate address 交替地址; access address 存取地址,访问地址;
address array 地址矩阵; analog amplifier 模拟放大器; automatic answering 自动应答

AAD address adder 地址加法器

AAI accumulator adjust instruction 累加器调整指令

AAR an address register 地址寄存器

AAS 交替地址选择

AB accumulator buffer 累加缓冲器; address buffer 地址缓冲器; address bus 地址总线; address byte 地址字节

ABCONN abandon connection 拒接

ABLE address bus leading edge 地址总线前沿

ABO astable blocking oscillator 非稳态间歇振荡器

ABP active bandpass 有源带通,有效通带,有效带宽

ABRT abrupton 中断

ABS (数据) AB 选通; access-barred signal 接入阻止信号
ac account 计数, 计算; alternating current 交流
AC access control 存取控制; access cycle 存取周期; address control 地址控制; address counter 地址计数器; adjacent channel 相邻通道, 相邻信道; alternating current 交流
ACA automatic call acceptance 自动呼叫应答
ACB access barred signal 接入阻止信号
ACC accel 加速; accept 接收; access 存取; access circuit 存取电路; accumulator 蓄电池, 累加器; accumulate 累加; alternating current coupled 交流耦合; automatic chrominance control 自动色度控制
ACI 地址控制输入
ACIA asynchronous interface adapter 异步接口适配器
ACIR adder center input register 加法器中央输入寄存器
ACK(I/O) acknowledgement I/O 响应, 输入/输出
ACKN acknowledge 应答
ACL access control lock 存取控制闭锁
ACO 地址控制输入
ACQ, ACQN acquisition 捕获, 采集
ACS access 存取, 接近, 访问, 入口, 通路
ACST access time 存取时间, 访问时间
ActHo 同 AHo
ACU 模拟计算装置
AD, A/D 地址数据; address decoder 地址译码器; address driver 地址驱动器
ADA address adder 地址加法器; automatic data acquisition 自动数据采集
ADC 地址数据控制; analog-to-digital conversion 模拟-数字转换; analog-to-digital converter 模拟-数字转换器
ADCBCO 参见 ADC、BCO
ADCCK I/O 地址数据控制时钟输入/输出
ADCCP advanced data communications control protocol procedure 先进的

数据通信控制规程

ADCIN ADC 输入

ADCLRCO 参见 AD、CLR、CO

ADCO ADC 输出

ADCWDCO 参见 AD、CW、DCO

ADD add(er) 加法 (器); addition 加法, 增加; address 地址

ADDN addition 加, 加法; 补充, 增加

ADDSD addressed 已编址的

ADDSEE addressee 被寻地址

ADEL DEL, A 端

ADEN 地址数据 (选通) 允许

ADJ adjust 调整, 校准

ADL asynchronous delay line 异步延迟线

ADL-Net autonomous decentralized loop network 独立分散循环网络

ADM adaptive delta modulation 自适应增量调制

ADMUX address for multiplexer register 多路转换器寄存器地址

ADPCM adaptive differential pulsecode modulation 自适应差分脉码调制

ADPLL all-digital phase locked loop 全数字式锁相环

ADPT adapter 适配器, 转接器

ADR adder 加法器

ADR(S) address 地址

ADS 地址状态; address 地址; address data strobe 地址数据选通

ADSD addressed 已编址的

ADSTB address strobe 地址选通

ADV add a device 增添设备

AE activity end 工作端, 有效端

AE(N) address enable 地址允许

AEC automatic error correction 自动纠错

automatic excitation control 自动激励控制

AEF 近于空标志

AES auxiliary equipment and supplies 辅助设备和附件

AF address field 地址段; address format 地址格式; audio frequency 声频

AF/PC automatic frequency phase controlled loop 自动频率相控环路

AF(A) audio frequency (amplifier) 声频 (放大器)

AFC address field control 地址段控制; address fetch cycle 地址读取周期; analog-to-frequency converter 模拟-频率转换器; automatic frequency control 自动频率控制

AFE 近于满/近于空

AFEB address field extension bit 地址段扩展位

AFF 近于满标志

AFG analog function generator 模拟函数发生器

AFM audio frequency modulation 声频调制

AFP 音频功能

AFR automatic field recognition 自动字段识别; automatic format recognition 自动格式识别

AFS audio frequency shift 音频频移

AFT automatic fine turning 自动微调; automatic frequency tracking 自动频率跟踪

AG 仅为增益, 增益晶体管; available gain 可用增益

AGC automatic gain control 自动增益控制; automatic generation control 自动生成控制

AGND 模拟接地

AGS automatic gain stabilization 自动增益稳定

AHI active high input 高有效输入

AHO 高有效输出

AI activity interrupt 活动中断, 有效中断响应输入地址输入

AIDA automated inspection of data 数据自动检验

AIE 地址输入允许

AIN 模拟 (信号) 输入

AINH 模拟高电位输入

AINL 模拟低电位输入

AIOWC 先行输入输出写命令

AK data acknowledgement 数据确认

AL absolute loading 绝对地址负载, 绝对负载; **address latch** 地址锁存; **address line** 地址线; **addressable latch** 可编址锁存

ALB 地址存取总线, 模拟灯, 地址灯

AL(R)M alarm 报警 (信号)

ALC automatic level control 自动电平控制; **automatic load control** 自动负载控制

ALE 允许地址锁存

ALE address latch enable 地址锁存允许

ALLF alloc allocate 定位, 指定, 分配

ALOR adder left output register 加法器左输出寄存器

ALR alerting message 报警信息

ALS arithmetic left shift 算术左移

alt alternate 改变, 转换, 交错

ALU arithmetic and logic unit 运算逻辑部件, 运算逻辑装置

AM access mode 存取方式; **address marker** 地址标记; **addressing mode** 寻址方式; **amplifier** 放大器; **amplitude** 振幅, 幅度; **amplitude modulation** 调幅; **automatic/manual** 自动/手控 (方式); **analog monitor** 模拟监控

AM-SSB amplitude modulation, single-sideband 单边带调幅

AMC automatic modulation control 自动调制控制

AME application migration executive 申请移动执行, 移动应用执行

AMEND amendment 修正, 改正, 变更; 调正

AMF address mode field 编址方式标识段

Amp ampere 安 (培)

AMP(L) amplifier 放大器; **amplitude** 振幅, 幅度

AMPS Advanced Mobile Phone Service 先进的移动电话服务

AMS automatic message switching 自动信息交换

AMT amount 总计, 合计

AMV_{CC} 参见 AM, V_{CC}

AMWC advance memory write command 先行存储器写命令

AN access network 存取网络

AN anal analog(ous) 模拟的

ANSI American National Standards Institute 美国国家标准学会

ANYRQST any request 任意请求

AO access opening 存取通道; address overflow 地址溢出; alphanumeric output 字母数字输出; amplifier output 放大器输出

AOB adder output bus 加法器输出总线

AOC automatic output control 自动输出控制; automatic overload control 自动过载控制

AP address path 地址通路; arithmetic processor 运算处理器; audible paging 声音拨叫

APA active position address 工作位置地址, 有效位置地址

APC access path control 存取通路控制; automatic phase control 自动相位控制; automatic power control 自动功率控制

APM amplitude pulse modulation 脉冲调制

APO 模拟电源输出

APPS automatic pulse phase shifter 自动脉冲移相器

APR alternate path retry 选择通路重复发送

APSel address path select 地址通道选择

AQ any quantity 任意量

AR 读地址(输入); access request 存取请求; accumulator register 累加寄存器; address register 地址寄存器; arithmetic register 运算寄存器

ARC advanced communications system 高级通信系统; Attached Resource Computer 附属资源计算机系统; automatic range control 距离自动控制; automatic remote control 自动遥控

ARCOF Audio Ringing codec Filter 音频环编译码器, 滤波器

ARDY (寄存器) A 就绪(待命)

ARE 转换读允许

ARI airborne radio installation 机载电台

ARITH arithmetic 算术, 运算

ARQ automatic request for repetition 自动重复请求

arr arrange 布置, 配置; 置换; 安装, 装置

ARRGT arrangement 布置, 配置; 置换; 安装, 装置

AS activity start 工作启动, 活动开始; add subtract 加减; addressing signals 寻址信号; address segmentation 地址分段; address selection 地址选择; address strobe 地址选通; address substitution 地址替换

ASCII American standard code for information interchange 美国信息交换标准代码

ASE 地址转换启动

ASG assign 赋值, 指定, 赋值指令

ASGC automatic slope and gain control 自动跨导和增益控制

ASGMT assignment 赋值, 指定, 分配

ASGN assign 赋值, 指定, 赋值指令

ASI asynchronous serial interface 异步串联接口

ASIC Application Specific Integrated Circuit 特种应用集成电路, 专用集成电路

ASM assembly 装配件, 装配; 汇编

ASP analog signal processor 模拟信号处理机

ASR automated send receive 自动化发送接收

AST 非稳态控制端

ASTB address strobe A 端选通, 地址选通

Astb(l) astable 非稳态

ASU adder/subtractor unit 加/减法器; auto setup unit 自动定位装置, 自动编排装置

ASV automatic self-verification 自动检验

ASW auxiliary switch 辅助开关

ASYN(C) asynchronous 异步的

ASYNCLR asynchronous clear 异步清零

AT access time 存取时间； address transfer 地址转移； address translation 地址转换

ATA, AT(I)N(I/O) attention active 特别注意，主动保养，主动维护（输入或输出）

ATC adaptive transformation coder 自适应变换编码器； automatic tone correcting 自动音调校正； automatic temperature compensation 自动温度补偿； automatic tuning control 自动调谐控制

ATE automatic test equipment 自动测试设备； autonomous testing equipment 自主测试设备

ATF adaptive transversal filter 自适应横向滤波器

ATG automatic test generation 自动测试生成

ATIPD(ATA) 参见 AT、IP、D

ATPG automatic test pattern generator 自动测试图形生成程序

ATT （信号电平）增高； attenuator 衰减器； attack 冲击

ATU address translation unit 地址转换器

ATV automatic threshold variation 自动阈值变化

AU access unit 存取部件； arithmetic unit 运算部件，运算器

AUI 低放输入

AUO 低放输出

AUI 附加装置连接电缆，连接装置接口（电缆）

AUD audio 音频

AUG augment 添加，增大

AUT automatic 自动的

AUX auxiliary 辅助的

AUX ST auxiliary storage 辅助存储器

AV address value 地址值； audio-visual 声像的； actual value 可用值

AVAIL, AVL, AVL(BL) availability 利用率，有效性，可用性

AVD alternate(alternative)voice/data 更换声音/数据

AVDS automatic voice data switching 自动话音数据切换

AVE automatic volume expansion 自动音量扩展

AVG average 平均值, 平均的

AVNL automatic video noise leveling 自动视频噪声电平调整

AVR automatic voltage regulation 自动调压

AW address word 地址字; 写地址 (输入)

AXC address to index, complement 变址附加地址

AXFMR automatic transformer 自动变压器

AXT address to index, true 变址真地址

AZ(S) automatic zero(set) 自动调零, 自动零位调整

nA, nB 数据输入

≡

B/F buffer/formatter 缓冲器/格式器

B/W black/white(TV picture) 黑白 (电视图像)

B(c, s) 电流源基极端

B(it)/G(eg) 比特/级

B, b bandwidth 带宽, 频带宽度; baud 波特 (信号速度单位); base 基础, 底座; 基体; 基极; battery 电池组蓄电池; bias 偏压, 偏磁, 偏置; binary 二进制的; bit 位(二进制的), 比特; branch 分流, 分支, 分路, 支路; brightness 亮度

B0A, B1B 总线可用输出

B₀, B₁, B_n 第 0、1、n 位运算器等数据输入

B-D, B/D, BIN/DEC binary-to-decimal 二进制-十进制 (转换)

BA balanced amplifier 平衡放大器总线选优; binary add 二进制加法; block address 程序块地址, 数据块地址; buffer address 缓冲器地址; buffer amplifier 缓冲放大器; buffer access 缓冲存取; bus address 总线地址; byte access 字节存取; byte address 字节地址

BABT British Approvals Board for Telecommunications 英国电信管理委员会

BAC binary analog conversion 二进制模拟转换; binary asymmetric channel 二进制非对称通道; buffer address counting 缓冲器地址计数

BACK bus acknowledge 总线响应

BADS bus address 总线地址

BAGT bus address gate 总线地址选通

BAL balance 平衡, 均衡集成稳压器

BAR bank address register 数据库地址寄存器; bus address register 总线地址寄存器

BASE basic semantic element 基本语义元素

BASIC beginner's all purpose symbolic instruction code 初学者通用符号指令码, BASIC 语言

BB back bias 反向偏置, 反向偏压; bus-bar 汇流条, 母线

BB, B/B back bean 反向射束

BBC back to back cycles 序列循环

BBD bidirectional bus driver 双向总线驱动器

BBE 字节进位允许

BBM beam brightness modulation 射束亮度调制; break before make 先断后通

BBMC break-before-make contact 接通前断路触点, 先断后通触点

BC back-connected 反向连接的; bar code 条形码; barrier capacitance 势垒电容, 阻挡层电容; beginning character 起始字符; bias current 偏压电流; binary counter 二进制计数器; bistable circuit 双稳电路; brightness control 亮度控制; break contact 断开接点; buffer cell 缓冲器单元; built-in check 内部校验; buried collector 隐埋集电极; bus clock 总线时钟; bus connection 总线连接; bus controller 总线控制器; bypass circuit 旁路电路

BC(L)K 总线时钟, 字节(位)时钟

BCC bus controller chip 总线控制器芯片

BCD binary coded data 二进制编码数据; binary coded decimal(interchange code) 二进制编码的十进制交换码; bulk charge-transfer device 整体电荷传送器件

BCDD BCD 数据

BCH bids per circuit per hour 电路小时请求次数

BCI 总线控制输入

BCO binary coded octal 二进制编码的八进制（数据）；总线控制输出

BCP branch and count registers 分支计数寄存器

BCPF basic clock pulse frequency 基本时钟脉冲频率

BCR break control register 中断控制寄存器；buffer control register 缓冲器控制寄存器

BCT branch on counter 计数器转移

BCUCLSTST 二进制计数部件关闭测试

BD backward diode 反向二极管；band 频带，波段；binary decoder 二进制译码器；binary digit 二进制数字；binary divide 二进制除法；binary-to-decimal 二进制-十进制（转换）bus driver 总线驱动器；bus duct 总线管道

BDD binary digital data 二进制数字数据；binary-to-decimal decoder 二进制-十进制译码器

BDEL B 端 DEL

BDF bus differential 微分总线

BDI bearing deviation indicator 方位偏差指示器

BDJ 电压调节端

BDM binary digital multiplier 二进制数字多路转换器

BDP binary data processing 二进制数据处理

BDT bidirectional transducer 双向换能器，双向变换器，双向传感器

BE 总线允许字节允许

BED byte error detecting(code) 字节错误检测码

BEEC binary error erasure channel 二进制错误擦除通道

BEF bell character 报警字符；bus exchange line 总线交换线路；bus exchange logic 总线交换逻辑

BEMF back electromotive force 反向电动势

BER backwark error recovery 反向错误恢复

BERT bit error rate tester 误码率检测器

BES bus exchange signals 总线交换信号

BEX broadband exchange 宽带交换

BF 电池故障缓冲器; back feed 反馈, 回授; bandpass filter 带通滤波器;
bottom face 底面; branching filter 分支滤波器

BFC buffer controller 缓冲器控制器

BFP branch-free path 无分支通路

BFR buffer 缓冲器

BG bus grant 总线允许

BGACK bus grant acknowledge 总线允许确认

BHC busy hour call 忙时呼叫

BHE/S 总线高位允许/状态

BHE(N) byte high enable 高位字节允许; 总线高位允许

BHL busy hour load 忙时负载

BI balanced input 平衡输入, 差动输入

B 线(驱动)输入; 偏置; blanking input 截止输入

BI(BL) 消隐(灭灯)输入(译码器等)

BII 偏置输入

BIO 偏置输出

BIBO bounded input/bounded output 有界输入/有界输出

BIBOM binary input binary output machine 二进制输入二进制输出设备

BIC backplane interconnection 底板互连; base input current 基极输入
电流

BICAP binary capacitor 双态电容器

BIDEC binary-to-decimal converter 二进制-十进制转换器

Bidire(ctional) 双向

BIFET bipolar junction FET 双极结型场效应晶体管

BIMOS bipolar metal-oxide-semiconductor 双极型金属氧化物半导体

BIN binary 二进制总线输入

BINFMF 参见 BIN, FMF

BIO block input/output 输入/输出块, 输入/输出部件

BIOM buffer input-output memory 输入/输出缓冲存储器

BIOS basic input-output system 基本输入/输出系统

BIP Bipolar 双极型

BIPI(n) 双极输入

BIPMOS bipolar/metal-oxide-semiconductor 双极型金属氧化物半导体

BIPO(ut) 双极输出

BIR bus-in register 总线输入寄存器

BIST built-in self testing 内部自测试

BISYNC binary synchronous communication 二进制同步通信

BIT binary information transfer 二进制信息传送(字节)位(地址); built-in test 内部测试; binary digit 二进制数字, 二进制数位

BIVAR bivariant 双变的; bivariant function generator 双变函数发生器

BIX binary information exchange 二进制信息交换

BJ barrage jamming 抑制干扰; beam jitter 电子束跳动

BK back 背, 背面

BL batch loading 成批负载; bit line 位线; blanking 消隐, 熄灭; blue lamp 蓝色灯; bootstrap loader 引导负载程序

BLAST burst last 猝发末尾

BLC balance 平衡, 均衡, 对称

BLK block 字组, 程序块, 数据块; 部件; bus lock 总线闭锁

BLK, BLN(K) blank 消隐; blink 闪烁

Bl_n, BLNC(E) Balance 平衡

BLOCK bus lock 总线闭锁

BLT beam lead technique 梁式引线技术

BM 字节方式; boundary marker 边界标记; 实发(脉冲串)方式控制; buffer mark 缓冲器标记; buffer memory 缓冲存储器; bus master 总线主控器

BMC block-multiplexer channel 块多路转换通道; burst-multiplexer channel 色同步多路转换通道

BMO 字节输出方式

BN beacon 信标; binary number 二进制数

BNA 总线下一个地址

BO 借位输出; B 线驱动输出; binary operation 二进制运算

BOC branch on condition 条件转移

BOFS bipartite offset 双向失调 (调节端)

BOI branch output interrupt 分支输出中断

BOR bus-out register 总线输出寄存器

BORR(ow) borrow 借位

BOVR bus overrun 总线溢出

BP bandpass 带通, 通频带; 基板; 双极性; bit processing 位处理行反峰脉冲消隐; breakpoint 断点; bus protocol 总线协议, 总线规程; bypass 旁路, 旁通, 分支, 跨线; byte processing 字节处理

BPA break-point address 断点地址

BPF bandpass filter 带通滤波器

BPG break pulse generator 断路脉冲发生器

BPL bandpass limiter 带通限制器

BPM bi-phase modulation 双相调制

BPMF bandpass matched filter 带通匹配滤波器

BPO 双极性失调 (偏移)

BPPA balanced push pull amplifier 对称推挽放大器

BPR bottom priority 低优先级

BPRI(N), BPRN bus priority in 总线优先入

BPRO bus priority out 总线优先出

BPSK binary phase shift keying 二进制移相键控

BR(EQ), BRQ, BUSRQ bus request 总线请求

BR, br branch 转移, 分支, 支线; branch register 分支寄存器, 转移寄存器; break request 中断请求; buffer register 缓冲寄存器; bus receiver 总线接收器

BRDY 参见 ARDY

BRF band rejection filter 带阻滤波器

BRK break 断路, 中断, 停止

BRK DET breakpoint delect 断点检测

BRS break request signal 中断请求信号

BRSTB 端复位，总线复位；burst 爆（破裂发），脉冲串，闪光，猝发

BRT bright 光亮的，亮度

BRW 借位

BS 自举总线选通；字节选择；band setting 波段选择；barrel shifter 任意位数位移；桶形移位器；base shield 管座屏蔽；buffer stage 缓冲极；byte size 字节长度；byte swapping 字节换位

BSA blocking signal acknowledgement 锁定信号确认

BSC binary symmetric channel 二进制对称通道；bit scan command 位扫描命令

BSCK, BSCLK byte substitution clock 字节换位时钟

BSCN bit scan 位扫描

BSD 参见 BS, D 和 BSV

BSD bit storage density 比特存储密度

BSELCH buffered selector channel 缓冲选择通道

BSEN busy enable 占线允许

BSO byte string operation 字节串运算，字节操作

BSP bit-serial processing 位串行处理

BSR bidirectional shift register 双向移位寄存器

BST 色同步信号

BSTB B 端选通，总线选通；bistable 双稳态

BSV 总线给定值；位给定值；自举 V/总线传送（选通）V

BSW bus switch 总线开关

BSY busy 忙，占线

BT 振铃，接头；bus transceiver 总线收发器

BTC bit time counter 位时计数器

BTD binary-to-decimal 二进制-十进制（转换）

BTERM burst terminal 猝发终端

BTF binary transversal filter 二进制横向滤波器

BTI block transfer instruction 字组传送指令

BTL beginning tape lable 磁带始端标号

BTSP bootstrap 引导指令, 引导程序

BTT block transfer time 字组传送时间

BU, B/U back-up 后备设备, 辅助, 支援

BUB 总线 B 端

BUC back-up control 后备设备控制

BUF buffer 缓冲器

BUL below upper limit 低于上限

BUSACK bus acknowledge 总线响应

BUSREQ bus request 总线请求

BV bias voltage 偏压, 偏置电压; **balanced voltage** 平衡电压

BV(ID)O blue video out 蓝视频输出

BVD beacon video digitizer 信标视频数字转换器

BVI bus-vectored interrupt 总线向量中断

BVIL bus vectored interrupt logic 总线向量中断逻辑

BW 缓冲(寄存器)写; **bandwidth** 带宽; 总线宽度

BWA backward wave amplifier 反向波放大器

BWC backward wave convert(er) 反向波变频(器)

BWI byte-wide interface 字节交换接口

BWPA backward power amplifier 反向功率放大器; **backward wave power amplifier** 反向波功率放大器

BWR bandwidth ratio 带宽比

BXLE branch on index low or equal “小于”或“等于”指数转移

BXN branch on index high “大于”指数转移

BYCLK byte clock 字节(工作)时钟

BYMPX byte multiplexer channel 字节多路转接通道, 字节多路通道

BYMUX byte multiplexer channel 字节多路转换通道

BYP bypass 旁路, 分支, 跨线; **bypcap bypass capacitor** 旁路电容器

BYPASS 字节传递

Byte CLK 字节时钟

Byte EN 字节允许

BYW 借位

BZ branch on zero 零转移; bus zero 总线零; buzzer 蜂鸣器

II

CA, CB, ... C0, C1... 进位输入输出信号

CA, CB 控制数据 A 端 B 端

C, c 计数, 进位, 色度信号; capacitance 电容; apacitor 电容器;
chrominance 色度; clear 清零, 消零; collector 集电极, 收集极; control 控制

CI control IN 控制输入

CA call accepted 呼叫应答; call allotter 呼叫分配器; chained addressing
链式寻址; channel adapter 通道转接器, 通道适配器; 级联输入; 通道注意
信号; channel address 通道地址; chopper amplifier 斩波放大器, 断续放大器;
code acquisition 代码采集; 列地址

CAB column address bits 列地址位

CAC clear all channels 清零所有信道; chroma amplitude corrector 色度幅
度校正器

CACK CA 时钟

CAD computer aided design 计算机辅助设计

CAE computer-aided editing 计算机辅助编辑

CAG(C) cyclic address generator 循环地址发生器 (控制)

CAFIR cascadable Adaptive Finite impulse Response 可分级自适应限定
脉冲应答

CAK 扁芯

CAL calibrate 校正, 校准

CALC calculate 计算

CALCN calculation 计算

CAM central address memory 中央地址存储器

can cancellation 废除, 删去, 取消, 擦去; 相约, 相消

CAP capacitor 电容器, 容量

CAR carrier 载波, 载体; channel address register 通道地址寄存器

CARC channel address regist control 通道地址寄存控制

CARD channel allocation and routing data 通道分配和数据路径选择链式寻址

CARR carrier 载波, 载体; carry 进位, 安装, 传送

CARRY/BYW 进位/借位

CARS 参见 CAR, S

CARSEN 参见 CAR, SEN 和 CAR, S, EN

CAS channel associated signalling 相联通道信号传输; column address strobe 列地址选通; compare accumulator with storage 累加器与存储器比较

CASEN 相联通道信号允许; 列存取选择

CASP column address strobe parity 列地址选通奇偶

CATH cathode 阴极

CATHFOL cathode follower 阴极输出器, 阴极跟随器

CATV community antenna television 公用天线电视

CAW channel address word 通道地址字

CB call back 重复呼叫, 回叫

CB C-bias 栅(极)偏压检验位; citizen band 民用频段, 民用波段; common base 共基极; control buffer 控制缓冲器

CBA capability based addressing 权能编址; changeback acknowledgement 返回正常信道应答; changeback acknowledgement signal 返回确认信号

CBC collector-base current 集电极-基极电流; common base circuit 共基极电路

CBFLAG CB 标志

CB P 穿路电容

CBRQ common bus request 公共总线请求

CBS channel buffer storage 通道缓冲存储器

CBV call by value 赋值, 代入值

CC 全转换; call connected 呼叫接通; call on carry 进位调用; chain command 链接命令; channel command 通道控制命令; channel controller 通道控制器; chip carrier 芯片载体; clock-in-chip 时钟脉冲芯片, 芯片上时钟;

close control 闭路控制; common collector 共集电极; common control 公用控制; common carrier 公共载波; communication control 通信控制; condition code 条件码; congestion control 过载控制, 拥挤控制; connection confirm 接通确认; constant current 恒流; cross coupling 互耦, 交叉耦合; cyclic check 循环检验

CCA chip-by-chip alignment 芯片逐个对准, 芯片逐片对位; contention channel access 争用通道存取

CCB cyclic-checking byte 循环校验字节

CCCG crystal-controlled clock generator 晶体控制时钟脉冲发生器

CCD charge coupled device 电荷耦合器件; complementary coded decimal 补码编码十进制

CCEN condition code enable 条件码允许

CCI 转换时钟输入; continuity-check incoming (signal) 连续性检验输入(信号); current controlled indicator 电流控制指示器

CCITT International Telegraph and Telephone Consultative Committee 国际电报电话咨询委员会

CCNI current-controlled negative inductance 电流控制的负电感

CCNL current-controlled negative inductance 电流控制负电感

CCNR current-controlled negative resistance 电流控制负电阻

CCO 转换时钟输出; continuity-check outgoing 连续性检验发送信号; crystal-controlled oscillator 晶体控制振荡器; current-controlled oscillator 电流控制振荡器

CCP cross-connecting point 交叉连接点

CCR 超高速缓存控制寄存器; channel command register 信道命令寄存器

CCS 用户编译器选择; composite color signal 合成彩色信号

CCT channel check test 通道检测; clock cycle time 时钟周期时间

CCTV closed-circuit television 闭路电视

CCU channel control unit 通道控制器; coupling control unit 接线控制器

CCW channel command word 通道命令字; counterclockwise 逆时针的

CD 单元延迟;直通色度(信号); **capability data** 带宽容量数据; **capacitive discharge** 电容放电; **carrier detect** 载波探测; **cartridge drive** 盒式磁带驱动器; **chain data** 链式数据; **charge displacement** 电荷位移; 电禁止控制; 冲突输入端; 列驱动

C/D 控制/数据; **clock driver** 时钟脉冲驱动器; **configuration dependent** 配置相关的; **countdown** 倒着计算, 计数损失; **crystal driver** 晶体激励器; **current driver** 电流激励器

CDAB combined data and address bus 组合数据地址总线

CDB common data bus 公用数据总线; **current data bit** 现行数据位

CDD changed data dump 变更数据转储; **chart distribution data** 表分布数据; **current-driven device** 电流激励装置

CDEL DELC 端

CDIP ceramic DIP 陶瓷双列直插式封装

CDK channel data check 通道数据检验

CDIS cache disable 高速缓冲存储器禁止

CDL 延迟行色度(信号)

CDM code division multiplexing 分码多路转换; **companded delta modulation** 压缩增量调制

CDMA code division multiple access 分码多路存取

CDels(et) 片延迟置位

CDP communication data processor 通信数据处理机

CDS cacheable data space 可高速缓存数据间隔; 冲突检测传感器; 片延迟置位

CDS 相关加倍取样; **command document start** 命令状态总线

CDSF 参见 CD, SF

CDT 冲突检测端; **control data terminal** 控制数据终端; **cyclic digital transmitter** 循环数字数据发射机

CE 时钟控制(允许); **channel end** 通道结束; **chipenable** 芯片允许信号, 芯片允许(信号); **clear entry (key)** 清零输入(键); **common emitter** 并发射极; 补偿允许; 列(地址)选通

CEF carrier elimination filter 载波抑制滤波器；complementary emitter follower 互补发射极跟随器

CEM channel electron multiplier 信道电子倍增器；counter-electromotive (force)反电动势

CE(N) 修正允许时钟允许芯片使能命令允许

CEP 计数允许并行

CEMPHAS 参见 CEM, PHAS

CER R (寄存器), 时钟允许

CES S (寄存器), 时钟允许

CET 计数允许连接

CE μ 微状态寄存器允许

CEX 时钟控制传送

C_{ext} 外接电容

CF 计数器 (级联) 反馈；清零标志；carrier frequency 载波频率；conjunctive form 连接形式；controlled feedback 控制反馈；crystal filter 晶体滤波器；current feedback 电流反馈，电流回授

C_r 外接定额电容端

CFF carry flip-flop 进位触发器；control flip-flop 控制触发器；counter flip-flop 计数器触发器；critical flicker frequency 临界闪烁频率

CFO carrier frequency oscillator 载频振荡器

CFR confirmation to receive 接收确认

CFS carrier frequency shift 载波频移

CG character generator 字符发生器；common ground 公共接地；control grid 控制栅

CGA contrast gate amplifier 对比度选通放大器

CGB convert Gray to binary 将葛来码转换为二进制码

CGC circuit group congestion 链束过载，电路组过载

CH chain 链；channel 通道；character 字符；compare halfword 比较半字；hold capacity 保持 (外接) 电容

CH(N)G change 改变，变换

CHAI, CHALIN channel in 通道（调整）输入

CHAN channel 通信；信道；沟道

CHANSTOP channel stopper 信道抑制器

CHAO, CHALO channel out 通道（调整）输出

CHAR character 字符

CHARDET character detection 字符检测

CH(R)G charge 负载，装载，加载，电荷

CHARIE character interrupt enable 字符中断允许

CHEC channel evaluation and call 通道鉴定与调用

CHGSIGN change signal 改变符号

CHK check 检验

CHKPT check point 检验点

CHNL channel 通道；信道；沟道

CHOLD channel out load 通输出负载

CHPsel chip select 片选

CHR, CHROM chrominance 色度

CHnRD 通道 n 读

CHRG charge 负荷，装载

CHnRW 通道 n 读写

CHS 斩波器稳定

CHnWR 通道 n 写

CI 电流输入；输入电容；carry in 进位输入；comparison indicator 比较指示器；configuration identification 配置识别；cut in 接通，插入，开始工作

CIC 负责控制；装入控制；central instrumentation facility 中央测试设施

CIL call identification line 呼叫识别线

CI_{INT} 内接电容积分电容

CIO counter for input/output buffer 中央输入/输出缓冲计数器；counter/timer and parallel input/output chip 计数器/定时器与并行输入/输出芯片；control input/output 控制输入/输出

CIPwm 参见 CI, Pwm

CIRC circulator 循环器, 环行器
CISC complex instruction set computer 复杂指令集计算机
CIV clock input voltage 时钟输入电压
CJ cold junction (热电偶的) 冷端
CK clock 时钟同步, 时钟脉冲; check 检查, 检验
CK DIG check digit 检验数字位
CKDN 递减(计数)时钟
CKUP 递增(计数)时钟
C(K)P 时钟脉冲
CKI 时钟输入
CKO 时钟输出
CKIN(nibit) 时钟禁止
CKT circuit 电路时钟传送
CKW clockwise 顺时针的
CL cable link 电缆链路; 碰撞(参见 CLSN); 清零; central line 中心线, 中央线; 限流; 电流限幅; 时钟极限; 控制线; closed loop 闭合环路; confidence limit 置信界限, 置信限度; connecting line 连接线; clearance 清零, 清零; closed 封闭的, 闭路的
CLA 钳位输出端
CLAMPLEV 钳位电平
CLC closed loop control 闭环控制; clear confirmation 清零确认
CLCD clear confirmation delay 清零确认延迟
CLG calling line 呼叫线
CLI calling line identification 呼叫线识别; clear indication 清零显示, 清除指示
CLK clock 时钟
nCLK n 倍时钟
CLKEN clock enable 时钟(控制)允许
CLKL LSP 寄存器时钟
Clkm MSP 寄存器时钟

CLKO 时钟输出

CLKOP clock operation 操作时钟

CLKP pulse clock 时钟脉冲

CLKR 用固定数据率模式的传送时钟和数据时钟

CLKSel 时钟选择

CLP clamp 钳位, 钳位电路; clap 拍, 振动, 摆动; clip 夹紧, 消波, 限幅

CLR clear 清零; clear request 清零请求

CLRD clear request delay 清除请求延迟

CLS collocated satellites 并行卫星

CLROFR 清零 OFR, 清除输出 FR

CLTH 清零锁存

CLU central logic unit 中央逻辑部件; circuit line-up 电路调整

CMC communication channel 信道; communications mode control 通信方式控制; contact making clock 继电时钟

CMCT communicate 通信, 联系, 交往

CMND command 指令

CMOS complementary metal-oxide-semiconductor 互补金属-氧化物-半导体

CMP computational 计算的

CMP compare 比较; 补偿; 调整

CMPL complement 补充, 补码, 补数, 反码, 反数

CMPLX complex 复杂的, 复数的, 复合的

CMPST 补偿, 调整

CMR call modification request 调入修改请求, 呼叫修改请求

CMRR common mode rejection ratio 共模抑制比

CMV common mode voltage 共模电压

CMX code multiplexer 代码多路转换器

CN compensator 补偿器; connect 连接; control number 控制数

CNCT connect 连接, 接通

CNFGCLK 参见 CN, FG, CLK
CNFGSTB 参见 CN, FG, STB
CNST 恒定, 不断, 常量
CNT control 控制; counter 计数器
CNTE counter enable 计数器允许
CNTL control line 控制 (线)
CNT/LD counter/load 计数器/负载
CNTLOAD counter load 计数器负载
CNTR counter 计数器
CNTRL central 中央的, 中心的; control 控制
CN(V)T convert 转换, 变换
CO 控制输出; 进位输出; 电流输出; crystal oscillator 晶体振荡器
C_o 输出电容, (补偿电容) 端
CODEC code/decoder 编码/译码器
COL(L) 集电极; 换向器
COLN column 列
COM comm(n) 公共端; com(m)c 共阴极
COM 复合信号
COMM communications 通信; common 公共; command 命令
COMP comparator 比较器; comparison 比较; compensator 补偿器
COMPAR comparision 比较
COMPL compliment 补充, 补码, 余数
Complt 全, 完全, 完结, 完成
CON control 控制
CONN connection 连接, 结合, 接通
CONS consecutive 相连的, 连接的
CONT continuous 触点, 接触, 连续的; control 控制
CONV conversion 转换, 变换
COR correct 正确的; correctable data error 可校正数据错误
CORR correction 校正, 改正, 修正

COS colour separation 分色；余弦

COT continuity signal 连续性信号

COV changeover signal 转换信号

CP clamp pulse 钳位脉冲；clock pulse 时钟脉冲

CP_D 减时钟脉冲输入

CP_O 时钟脉冲输出

CP_U 加时钟脉冲输入

CPA carry parallel adder 进位并行加法器；CPU-port address bus 中央处理器端口地址总线

CPC clock pulsed control 时钟脉冲控制

CPE call on parity even 偶数调用；时钟脉冲允许

CPG clock pulse generator 时钟脉冲发生器

CPGA 陶瓷封装引线一栅极阵列（管脚）

CPI 程序电流输入；clock pulse interval 时钟脉冲间隔

CPL 取补；couple 成对，对；结合，耦合

CPLD coupled 耦合的

CPLG coupling 耦合，连接

CPLMT complement 相补；补码，补数

CPLR coupler 耦合器

CPO call on parity odd 奇数、调用

C_{PO} 消振电容端

CPSE counterpoise 平衡，均衡

CPSI clock pulse serial in 串行输入时钟脉冲

CPSO clock pulse serial out 串行输出时钟脉冲

CPTY capacity 容量，通信容量

CPU central processing unit 中央处理机

CR call request 调用请求；clear 清零；钳位整流器；collision reservation 碰头预定（分组通信网的）；connection request 连接请求；controller 控制器；control register 控制寄存器；count reverse 反向计数

CR+ 基准电容正端

CR- 基准电容负端
CRA 控制数据 A 端
CRB 控制数据 B 端
CR/CB 控制寄存/公共总线
CRC cyclic redundancy check 循环冗余检验; cyclic redundancy code 循环冗余码
CRES(et) 计数器复位
CRETN 电容回路端
CROP 参见 CR, OP
CRRNT current 电流
CRQ call request 呼叫请求
CRQLCK common request lock 公共请求闭锁
CRS 载波侦听信号
CRT call request time 调用请求时间, 呼叫请求时间; carrier recovery time 载波恢复时间; character 字符, 标志; cathode-ray tube 阴极射线管; characteron tube 显字管, 字码管; choice reaction time 决策时间, 选择应变时间; clock rate test 时钟频率检验
CRTS 参见 CR, TS 和 CRT 传送
CRX 参见 C, RX 和 CR, X
CRYX 进位
cry(stal) 晶体
CS 列(脉冲信号)选择; 色同步选通; 色度选择; chip select 选片, 芯片选择
CSA 电流感应 A 线
CSB 电流感应 B 线
CSB channel status byte 通道状态字节; 片选蓝
CSE 片选允许; checksum error 检验和错误
CSG 片选缘
CSH 参见 C, SH; CS, H
CSL 片选负载

CSLSB 片选最低有效位二进制

CSMSB 片选最高有效位二进制

CSN 载波检测输入, 片选计数 (数字); cyclically symmetric network 循环对称网络

CSP coder sequential pulse 编码器时序脉冲

CSR channel select register 通路选择寄存器; CPU 停; 片选红; circulating shift register 循环移位寄存器; control shift register 控制移位寄存器; control status register 控制状态寄存器

CSS circuit switching system 线路交换系统; clock subsystem 时钟子系统

CST 连打方式指定

CSU channel service unit 通道服务器; channel synchronizer unit 通道同步装置; check signal unit 控制信号部件; computer system unit 计算机系统装置

CSW channel status word 通道状态字, 通道状态写

CT 电流开关; 多路转换条件码; 外接电容端; control transformer 控制变压器; count 计数, 结算; counter 计数器

CTC contact 接点, 触点; 接触

CTCA channel-to-channel adapter 信道-信道转换器, 信道-信道适配器

CTCSS 可控连续音调控制系统端码/解码器

CTEN 时钟转换允许

CTERM control terminate 控制终止

CTFM continuous transmission frequency modulated 连续传输调频

CTR counter 计数器; control 控制

CT(R)L control 控制, 管理

CTS 清零发送; 允许发送; clear to send 发送就绪, 清零发送

CTTL TTL 时钟

CTV cable television 电缆电视; colour television 彩色电视

CU control unit 控制部件

CUC channel unit controller 通道控制器; common user circuit 公共用户线路

CUR current 电流, 现行的

CUV 控制部件电压

CV circuit virtual 虚拟电路; constant voltage 恒压; continuously variable 连续可变的; converter 转换器; counter voltage 计数器电压

CVBS composite video band signal 复合视频信号; 参见 CV, BS; 控制 VBS

CVBSIN CVBS 输入

CVCK CV 时钟

CVCO 压控振荡器外接电容端

CVR current-voltage regulator 电流-电压调整器

CVSG channel verification signal generator 通道检测信号发生器

CVSN conversion 转换

CW calls waiting 呼叫等待; 校验字; carrier wave 载波; contact window 接触窗孔; continuous wave 连续波

C&W control and warning 控制与报警

CWE 呼叫等待允许, 载波(连续波)允许

CWSEL CW 选择

CWD continuous wave detector 连续波检波器

CW/FM continuous wave/frequency modulation 连续波调频

CWG 校验字发生器

CWIF continuous wave intermediate frequency 连续波中频

CWO continuous wave oscillator 连续波振荡器

CWT carrier wave transmission 载波发送

CWV continuous wave video 连续波视频信号

CX 进位控制多路开关

Cxc X-Y 信号钳位电容

CXTD 同轴电缆发送数据

CXR carrier 载波, 载流子

CXRD 同轴电缆接收数据

CY cycle 周期, 循环

Cyc Y 信号钳位电容

CZ call on zero 调用“零”

λ

DA, DB, DC 数据（总线）

D/S dynamic/static 静态/动态

D, d data 数据；运算器运算输入；数据选择器选择输入；译码器地址输入；寄存器并行数据输入；计数器；触发器；锁存器输入；digit 数字；drain 漏极

DA data acceptance 数据接收；**data access** 数据存取；**AGC** 检波；**data acquisition** 数据采集；**data available** 可用数据，有效数据；**delay amplifier** 延迟放大器；**detector amplifier** 检波放大器；**difference amplifier** 差频信号放大器，差动放大器；**differential amplifier** 差动放大器；**digital access** 数字存取；**digital-to-analog** 数字-模拟（转换）；**direct access** 直接存取；**direct address** 直接地址；**double amplitude** 倍幅，全幅值；**dummy address** 伪地址，哑地址；**dynamic allocation** 动态分配

DAA data access arrangement 数据存取装置

DAB 数据地址总线

DAC data access control 数据存取控制；数据地址控制；**data acquisition and control** 介质吸收补偿；**digital-to-analog conversion** 数字-模拟转换；**digital-to-analog converter** 数字-模拟转换器

DACC direct access communication channel 直接存取通信信道

DACCK 参见 DAC, CK

DACCePto(ut) 数据接收输出

DACK DMA(direct memory access) 控制器应答

DACOR data correction 数据校正

DACSTRB 参见 DAC, STRB

DADC direct access data channel 直接存取数据通道

DAGC delayed automatic gain control 延迟自动增益控制；**digital automatic gain control** 数字化自动增益控制

DAGE DMA 地址选通

DAI data adjustment instruction 数据调整指令

DAL 数据地址（总）线
DALI 数据地址总线输入
DALO 数据地址总线输出
DAM data access mode 数据存取方式
DAMA data addressed memory 数据定址存储器；demand assigned multiple access 按需分配多路存取
DART dual asynchronous receiver/transmitter 双重异步收发机
DAS 数据选通
DASL data access system language 数据存取系统语言
DASPAN data spanning 数据生成
DAT dynamic address translation 动态地址转换
DATA COL data collection 数据收集
DATA COM data communication 数据通信
DATANET data network 数据网络
DATGEN data generation 数据生成
DATI data in 数据输入
DATO data out 数据输出
DAT 数字式音频磁带
DAV data valid 有效数据数据可用
DAX data acquisition and control 数据采集和控制
DB data buffer 数据缓冲器；data bus 数据总线；data byte 数据字节
DBB detector back bias 检波器反向偏置
DBC decimal-to-binary converter 十二进制转换器
DBDR 数据总线驱动
DBE(N) data bus enable 数据总线允许
DBI data base inquiry 数据库询问；differential bearing indicator 方位差指示器
DBL double 双的，倍增的，加倍的
DBLR doubler 两倍器，倍增器；倍压器；倍频器
DBM data buffer memory 数据缓冲存储器

DBR data buffer register 数据缓冲寄存器
DBUSREQ data bus request 数据总线请求
DC 原，反码控制；去耦；方向控制；**data channel** 数据通道；
data-controlled 数据控制的；**direct current** 直流
DC + 变容极管正极
DC - 变容极管负极
DCAUDIO decouple audio 音频去耦
DCC 工作循环控制
DCLK data clock 数据时钟
DCB data/control bus 数据控制总线
DCD data carrier detector 数据载体检测器
DCDR data collection and data relay 数据收集和_data中继
DCHACK 数据通道响应
DCHMO data channel mode out 数据通道方式输出
DCHPO(UT) data channel priority out 数据通道优先级输出
DCHREQ data channel request 数据通道请求
DCI data carrier input 数据载体输入
DCIB data communication input buffer 数据通信输入缓冲器
DCK data check 数据检验；数据时钟
DCKO, DCLKO 数据时钟输出
DCIF decouple intermediate frequency 中频去耦
DCO data control output 数据控制输出；**digital control oscillator** 数控振荡器；**direct current output** 直流输出
DCP 数据时钟脉冲；decouple 去耦，退耦
DCPS digitally controlled power source 数控电源
DCPV direct current peak voltage 直流峰值电压
DCRF decouple radio facilities 射频去耦
DC SHIFT OUT 直流移位输出
DC SHIFT SENSE 直流移位取样
DCV direct current voltage 直流电压

DCW data communication write 数据通信写入

DCWV direct current working voltage 直流工作电压

DD data demand 数据请求; **delay driver** 延迟驱动器; **digital data** 数字数据; **digital display** 数字显示; **direct drive** 直接驱动

DDA decentralized data acquisition 分散数据采集

DDB domestic digital bus 内部数据总线

DDC(O) digital data converter 数字数据转换器 (输出); **digital display converter** 数字显示转换器; **direct data channel** 直接数据通道; **display data controller** 显示数据控制器

DDE direct data entry 数据直接输入; **distributed data entry** 分布式数据输入

DDEL D 端 DEL 端口

DDG digital data group 数字数据组; **digital display generator** 数字显示发生器

DDIS driver disable 驱动器禁止

DDL Data Description Language Committee 数据描述语言委员会

ISDN 双数据链路控制器

DDM digital data multiplexer 数字数据多路转换器

DDS data display system 数据显示系统; **digital data system** 数字数据系统; **digital display system** 数字显示系统

DE deferred exit 延迟出口, 延迟退出

DEC decimal 十进制的; 小数; **digital evaluation computer** 数字评价计算机

DEC, DECPLE Decouple 去耦

DECD decade 十进制; **decode** 译码, 解码

DECI(T) decimal (digit) 十进制 (数字), 十分之一, 分

DEEM/DINT 向下 (倍重) 重点输出/数据插入输入

DEF 延迟; 错误标志

DEF INT deferred interrupt 延迟中断

DEF SCAN deferred scanning 延迟扫描

Deg degree 度, 角; degauss 去磁, 消磁, 退磁

DEI 显示允许输入

DEL delta 希腊字母 Δ ; delay 延迟; delete 删除

DEM 演奏测试输入

DEN 数据允许, 显示允许

DENORM 参见 DEN, ORM

DEO 显示允许输出

DES DAMA earth station 按需分配多路存取地面站

DET detector 检测器, 检波器; 鉴频

DEV deviation 偏差

DF data fetch 取数据, 数据读取; delayed feedback 延迟反馈; difference frequency 差频; directional filter 定向滤波器; double feeder 双馈线; drive forward 正向驱动

DFB distributed feedback 分布反馈

DFF D-flip-flop D 型触发器

DFG digital function generator 数字函数发生器

DFI 显示频率输入 (译码器)

DFO 显示频率输出 (译码器)

DFT diagnostic function test 诊断功能测试; discrete Fourier transform 离散傅里叶变换

DG data generator 数据发生器

DGND digit ground 数字接地

DGT digit 数字

DH display hold 显示器保持

DI data input 数据输入; digital input 数字输入; double injection 双注入

DIA digital input adapter 数字输入转接器, 数字输入适配器

DIBX data input bus 数字输入总线

DI/DO data input/data output 数据输入/数据输出; 驱动输入/驱动输出

DIF decimation-in-frequency 十进制选频

DIEN 数据启动

DI-FET dielectrically isolated field-effect transistor 介质隔离场效应晶体管

DIF(F) differential 差动, 差分

DIFFIN differential in 差动输入

DIFF/SE MC 差分/单端模式控制

DIG digital 数字的

DIGCOMM digital common 数字公共

DIL dual-in-line(leads package) 双列直插式(引线封装)(同 DIP)

DI(N) 数据输入

DINHB delay inhibit 延迟禁止

DIO direct input/output 直接输入/输出

DIOB digital input/output buffer 数字输入/输出缓冲器

DIOI digital input/output interface 数字输入/输出接口

DIOS data input/output select 数据输入/输出选择

DIP dual-in-line package 双列直插式封装

DIPAGE digital pattern generation 数字图形生成

DIR data input ready 数据输入准备; 直接(控制); 定向, 方向控制输入; 选择

DIRINT 内部方向

DIRAC direct access 直接存取

DIRBI 参见 DIR, BI

DIRCK 参见 DIR, CK

DIRLRCI 参见 DIR, LRCI

DIS Disable 禁止(信号)端; discrepancy 不符合, 差异, 矛盾; 偏差, 误差; Discrete 离散的, 分离的, 分立的, 不连续的; Discriminate 鉴别, 辨别, 区别

DISC disconnect 断开, 断线, 断路

discriminator 鉴别器, 鉴频器, 鉴相器

DISC(H) discharge 放电; discharger 放电器

DIS, DISBL, DSbl(e), Disable 禁止(信号)端

DISP disposition 配置, 安排

Dist distance 距离

DISTR distribution 分布, 分配; data in strobe 数据输入选通

DIV divide 除, 除法指令, 分配; divergence 偏差

DIVMUL 参见 DIV, MULT

DL data length 数据长度; 数据左移; delay line 延迟线

D/L data link 数据链路

DLA data link address 数据链路地址

DLC data link control 数据链路控制

DLE 驱动锁存

DLINK downward link 下行线路

DLL delay lock loop 延迟锁定回路; down line loading 下行线路负载

DLM double-level metal 双层金属

DLO delayed output 延迟输出; double local oscillator 双本机振荡器; dual loop oscillator 双回路振荡器

DLRCO 数据 LRC 输出

DLY delay 延迟

DK 磁盘 (控制)

DLYD delayed 延迟的

DM data memory 数据存储器; delay modulation 延迟调制

D/M demodulator/modulator 解调器/调制器

DMA direct memory access 直接存储器存取

DMAC direct memory access channel 直接存储器存取通道; direct memory access control 存储器存取控制; direct memory access controller 直接存储器存取控制器

DMAG(RANT) DMA 允许

DMAR(EQUEST) DMA 请求

DMASTB DMA 选通

DMC direct memory channel 存储器直接存储通道; discrete memoryless channel 无存储器离散通道

DMCL device media control language 存储媒体控制语言 (IBM 公司)

DME 解调器

DMIR 接收数据存储输入

DMOR 接收数据存储输出

D-MOS depletion mode metal-oxide-semiconductor 耗尽型金属氧化物半导体

DMSD 数字式与标准译码器

DM(U)X demultiplexer 多路分配器

DN 递减, 下调节

DNCKO down clock out 下调时钟输出

DN/UP 下调节/上调节, 递减/递增

DNA data notavailable 无效数据, 未校正数据

DNC direct numerical control 直接数字控制; 无连接

DNCD 译码器

DNIC data network identification code 数据网络识别代码

DNR digital noise reducer 数字噪声抑制器, 数字降噪

DO data output 数据输出; deviating oscillator 偏转振荡器, 偏差振荡器;
digital output 数字输出

DOD 释放; 检波, 整流

DOE 数据输出允许

DO/IT digital output/input translator 数字输入/输出转换器

DONE 传输结束

DOR 数据输出准备

DOSTR data out strobe 数据输出选通

DOT digital output timer 数字输出定时器

DOTP 参见 DO, TP

DOWN 减计数

DP 缓冲筒, 阻尼延迟器; data parity 数据奇偶性; data path 数据通路;
数字脉冲; 非帧信号端; dial pulse 号盘脉冲

DPCM delta pulse code modulation 增量脉码调制

DPDT double pole double throw 双刀双掷开关

DPG digital pulse generator 数字脉冲发生器

DPL design procedure language 设计过程语言； document processing language 文件处理语言

DPLL digital phase-locked loop 数字相位锁相环路

DPM 驱动运行监视器

DPO data processing operations 数据处理操作

DPPM differential phase pulse modulation 微分相位脉冲调制

DPR data processing request 数据处理请求

DPSK differential phase shift keying 差分相移键控

DPST double-pole single-throw(switch) 双刀单掷（开关）

DQ 数据输出

DR 比例分频；接收 PCM 输入；驱动器；数据右移；数据接收； data register 数据寄存器； direct recording 直接记录； direction of transfer bit 数据传送位方向； disconnect request 断线请求； drive 激励，驱动

D/R direct or reverse 正向或反向的，正面或反面的

DRA 直接数据（控制）A 端

DRB 直接数据（控制）B 端

DRAM dynamic random access memory 动态随机存取存储器

DRC data recording control 数据记录控制； design rule checking 设计规程检验

DRC 数字/求解转换器

DRCP drive clock pulse 驱动器时钟脉冲

DREQ D 请求

DRESP 响应

DRO double resonant oscillator 双谐振振荡器

DRQ drive request required 提出所需驱动请求； DMA 请求；数据传送请求

Drv 驱动器

DRV 负驱动自举电源

DRY drive ready 驱动就绪，驱动器就绪

DS data selection 数据选择; data series 数据串行; 禁止(=dis); data strobe 数据选通; distributed system 分配系统

DSE 发送信号高速通道启动

DSF 特殊功能允许

DSI delivered source instruction(number) 同源导出命令 (数)

D/SE MC 差分/单边沿方式控制

D_{SL} 左串行数据输入

DSLAC 双用户线路声频信号处理电路

DSN data sequence number 数据序号; 符号位

DSP digital signal processing 数字信号处理

DSR data set ready 数据集就绪, 数据置位就绪; data signaling rate 数据信号发送速率; 接收信号高速通道

D_{SR} 右串行数据输出

D/SRAM dynamic and static random access memory 动态和静态随机存取存储器

D_{SS} 直接移位取样 (集成稳压器)

DS/U 数据管理程序/用户选择

DSX 发送信号高速通道

DT data transfer 数据传送

DTA 截止时间调整 (集成稳压器)

DTACK data transfer acknowledge 数据传送响应; data tack 数据定位

D-T CNTL 空载-时空控制

DTE data terminating equipment 数据端接设备; data test equipment 数据测试设备; ata transmission equipment 数据传输设备; **DTL** digital transistor logic 数字晶体管逻辑; diode transistor logic 二极管-晶体管逻辑; discharge-time lag 放电时间延迟

DTMF dual-tone multifrequency(dialing) 双音多频拨号

DTMP digital test monitor processor 数字测试监视处理器

DTR data terminal ready 数据终端就绪

DT/R, DTR data transmission/receiving 数据发送/接收

DUART 双通用异步接收器和发送器

DU 数字显示控制

DV 视频检波; **direct voltage** 直流电压, 恒定电压; **differential voltage** 差动电压

DVA drive available 驱动有效

DVFO digital variable-frequency oscillator 数字式变频振荡器

DVG digital video generator 数字式视频信号发生器

DVM digital voltmeter 数字电压表

DVS data valid signal 数据有效信号

DWG drawing 描绘

DX 发送 PCM 高速通道

DXC data exchange control 数据交换控制

DXE 发送信号高速通道启动

DXI data exchange INpaut 数据交换输入

DXO 数据交换输出

DXT data extract 数据分离

DYB dynamic breaking 动态制动, 动态中断

└

2×E 双启动, 2 倍启动

E/A 差错/放大

E/D enhancement and depletion 增强与耗尽; **enhancement/depletion inverter** 增强与耗尽换流器

E/DC, EDC electronic desk calculator 台式电子计算器; **enable-disable control** ; 允许-禁止控制; **error detection and correction(equipment)** 检错与纠错 (设备); **error detecting circuitry** 检错电路

E/Z equal zero 等于零

E(N) enable 允许, 使能

E_A, E_B 输出发射极 A, B 端

E_P 编程许可

E-E electronics to electronics 调制器-解调器信号通道 (磁带录像)

E, e earth 地, 地球; 接地, 地线

EA 扩展 (RAM) 地址; extended addressing 扩充编址

EAIN error amplifier in 差错放大输入

EAO(ut) error amplifier out 差错放大输出

EB electron beam 电子束, 电子柱; encoder buffer 译码缓冲器; error burst 错误段, 错误群

EBCLK 参见 EB, CLK

EBI 允许

EBN 混合平衡电路输入

EBU European Broadcasting Union 欧洲广播联盟

EC emission control 发射控制; end chain 链结束; echo 回波, 反射波, 回声

ECC electron-coupled control 电子耦合控制; error checking and correction 错误检验和校正, 查错和纠错

ECL emitter coupled logic 发射极耦合逻辑 (电路)

ECM electric cipher machine 电密码机; electric coding machine 电编码器; electron-contrast modulating 电子对比调制; emergency changeover message 应急转换信息

ECT echo cancellation technique 回波抑制技术, 回波消除法; electronic circuit technique 电子电路技术

EDAC error detection and correction 检错与纠错

EDGE/LEVE (锁存器) 边沿/电平控制

E/DS encode/decode select 编码/译码选择

EDTV enhanced-definition television 增强电视清晰度, 提高电视清晰度

EE edge effect 边缘效应; echo equalizer 回波均衡器; electron emission 电子发射

EEPROM erasable and electrically programmable read only memory 电可擦和可编程序只读存储器

EF 空标志

EFI 外接频率输入

EFM enable finish mark 允许结束标志

EGA enhanced graphics adapter 增强图形适配器

EI 输入允许; 扩展输入

EIA Electronic Industry Association 电子工业协会 (美国); **extended interaction amplifier** 扩展交互作用放大器

EIA interface 电子工业协会标准接口

EISA extended industry standard architecture 扩充式工业标准结构

EL electroluminescence 电致发光; **enhancement logic** 增强逻辑; 电压比较器关闭输入控制

EMA extended memory area 扩充存储区

EMI electromagnetic impulse 电磁脉冲; **electromagnetic interference** 电磁干扰

EMIP emitter pulse 发送 (输出) 脉冲

EMIT emitter 发射极, 发送, 发送 (输出)

EMP electromagnetic protection 电磁防护

EMPH 扩展

EMPTY 堆栈空; 缓冲器状态: 空、未滿、滿等; 存储器空状态

EMTR emitter 发射极

Emtrfol EMitter-follow(er) 发射极输出器

EN_R 读允许 (寄存器)

EN_w 写允许 (寄存器)

ENAB, ENBL enable 允许

ENBL/DSBL enable/disable 允许/禁止

ENC/DECD encode/decode 编码/译码器

ENCFREG 参见 EN, CF, REG

ENETV_n 以太网版本 n, 0

ENG 参见 EN, G

ENI(N) enable in 允许输入

ENIA 参见 EN, IA

ENIM 参见 ENI, M
ENIR 允许 IR
ENM 参见 EN, M
ENO 允许输出
ENOFREG 参见 EN, OF, REG
ENP 计数允许, 控制, 允许并行
ENPHAC 参见 EN, PH, AC
ENPHREG 参见 EN, PH, REG
ENPOREG 参见 EN, PO, REG
ENPR 参见 EN, PR
ENRA, ENRB 允许接受 A, B 端
ENTA, ENTB 允许发送 A, B 端
ENTIREG 参见 EN, TI, REG
ENTR 允许 TR
ENV 外接电阻, 电容
EO 输出允许; 输出的终端 (End of); 扩展输出
EOC end of conversion 转换端 (输出), 变换终端, 转换结束; 控制终端; 转换周期控制端
EOI end of input 输入结束; 结束和识别
EOP, EOPSS end of process 过程结束
Ep 编程许可
EP editing program 编辑程序; end of program 程序结束; entry point 进入点, 入口点; error processor 差错处理器
EPCI 增强型可编程通信接口
EPL early programming language 早期程序设计语言
EPLD erasable programmable logic devices 可擦可编程逻辑器件
EPROM electrically programmable read only memory 电可编程序只读存储器; erasable programmable read only memory 可擦可编程序存储器
ER effective resistance 有效电阻; erase relay 擦除继电器; error rate 差错比, 出错率; external register 外寄存器; external resistance 外电阻

ERCC error checking and correcting 检错与纠错; error correction 纠错, 错误校正

ERDET error detection 错误检测

ERR error 错误, 差错 (输出)

ERRAMP error amplifier 差错放大器

ES error signal 错误信号; extra segment 补充段, 附加段

ESC escape 漏失, 逃逸; 换码

ESCK ES 时钟

ESD energy storage device 储能器件

ESDI enhanced small device interface 增强小型设备接口, 增强小型计算机接口; extended small disk interface 扩展小型磁盘接口

ESF electrostatic focusing 静电聚焦

EST 早期引导传送

ET 允许传送; edge-triggered 边缘触发的; 扩展

EV 鉴定器信号; effective value 有效值

EV PAR even parity 偶数校验

EVEN/ODD 奇/偶校验

EVN, EVEN 偶数端 (偶控制输入)

EVR electronic video recording 电子录像; electronic video reproduction 电子放像

EWA effective word address 有效字地址

EWR early write strobe 初期写入选通

EWRS enable write/read status 允许写/读状态

EX 扩展, 外接, 外部

EXa 与扩展端; 外部; excess 过剩, 超过, 过度

EXC excitation 激励; external control 外部控制

EXCH external channel 扩展; 通道, 外部通道; exchange 交换

EXCLU exclusive 排它的, 不相容的, 禁止的

EXDC external data controller 外部数据控制器

EXEC execute 执行

EXFcomp 外部频率调整（补偿）
EXOR exclusive OR “异”，“异”操作
EXP electronic crosspoint 电子转换元件电子交叉点
EXP_C 扩展（极电极）
EXP_E 扩展（发射极）
EXPND expander 扩展器
EXRO exterior out 扩展输出
EXT exterior 外面的，外部的；外部中止；extract 挤出，分离，抽出，抽象；外接
EXTACK 外部响应
EXTAL 外部时钟/晶振输入
EXTERNAL LOOPBACK 外部环回
EXTND extended 扩展的，延长的
EXTR exterior resistance 外部电阻
EXTRN external reference 外部引用，外部访问
EXTSN extension 扩展，伸长
ExTst exterior test 外测试
EXTSt CHStI 外测试通道选择
EXWR extension write 扩展写
EZ electrical zero 电零点

└

F/C 频率/晶体选择
F/R 正向/反向
F/V frequency-to-voltage (converter) 频率-电压（转换器）
F, f filter 滤波器，过滤器；flag 标志，特征；frequency 频率
F_{A>B}, F_{A=B}, F_{A<B} 数据比较器（A<B, A=B, A>B 时输出）
Fcp 时钟脉冲频率
Fdi 液晶显示频率输入
Fdo 液晶显示频率输出
F0, F1... Fn 第 0, 1...n 路运算器输出

FA failure access 存取失效; **final address** 最终地址; **fixed assignment** 固定分配 (通道或资源); **flat-gain amplifier** 平坦增益放大器; **frequency adjustment** 频率调整; **full adder** 全加器; **fully accessible** 全存取的; **fully automatic** 全自动的; **function address** 功能地址

FACL final address clear 最终地址清零

FAD first address 第一地址; **floating add** 浮点加法

FALD FA load FA 装入 (负载)

FAST facility for automatic sorting and testing 自动分类与测试设备; **Fairchild advanced Schottky** 飞兆公司先进肖特基工艺; **fast automatic shuttle transfer** 快速自动开关发送

FAX facsimile 传真通信, 摹写; **facsimile device** 传真机

FB feedback 反馈

FB_{AF} 音频 F_B

FB_S 同步分离反馈

FBDC feedback decouple 反馈去耦

FBE 参见 Force Byte EN

FBI 反馈输入

FBP 行回扫描脉冲

FBR feedback resistance 反馈电阻

FC 进位输出 (运算器); 频率控制; 内容补偿 (标准); 频率调整 (补偿); **functional code** 功能码, 操作码

Fcomp 频率调整 (补偿)

FCS 软件芯片选通; **frame checking sequence** 帧检查序列

FD feed 馈电, 供给; **flag detect** 标志检测; **field** 字段, 区段, 场, 域; **frequency detector** 鉴频器; **frequency divider** 分频器

FD 进位传送函数输出 (放运器)

FDB(K), FDB(C)K feedback 反馈

FDC floppy disk controller 软磁盘控制器

FD 控制

FDD fixed disk device 固定磁盘机; **floppy disk drive** 软磁盘机, 软盘驱

动器

FDDI Fiber Distributed Data Interface 光纤分布数据接口

FE 奇偶检验器偶数输出; 堆栈允许

FEC forward error correction(coding) 前向纠错 (译码)

FED STD federal standard 联邦标准

FED feed 馈送

FER format error 格式错误; forward error recovery 正向错误修正, 正向
出错恢复

FET field effect transistor 场效应晶体管

FEV 奇偶校验器偶数输出

FEX 场发射, 格式控制符, 帧效率频率错误

FEXC FEX 控制

FEXT far-end crosstalk 远端串话

FF, F/F flip-flop 触发器; full field 满场, 满空间; 满标志

FFC flip-flop counter 触发计数器

FFO 触发器输出

FFT fast Fourier transform 快速傅里叶变换

FG field gain 场增益, 场放大系数; figure 数字, 图形; 进位产生函数
输出; 频率发生器; function generator 函数发生器

FHOLD frequency hold 频率保持

FI false information 假信息; flow indicator 流量指示器

FIFO first in-first out 先进先出; floating input, flating output 浮点输入,
浮点输出

FIG figure 数字, 图形

FIL fill 装满, 注满

filter 滤波器; 过滤器

FIL_{AGC} 中频 AGC 滤波

FIN 频率输入

FINS(T) final instruction station 最终指令站; final station 最终站

FIP (vacuum) fluorescent indicator panel (真空) 荧光指示板

FIR finite impulse response 有限脉冲响应
FIRQ fast interrupt request 快速中断请求
FIT 故障隔离端
FL fault localization 故障定位; feedback loop 反馈环路; full load 满负荷
FL/RT 先行负载/中断转发
FLD field 场, 区; 域; 字段
FLF flip-flop 触发器
FLG flag 标记, 标识, 特征
FLL frequency locked loop 频率同步环路
FLLP filter low pass 低通滤波器
FLP floating point 浮点
FLT fault (location test) 故障 (定位检验); filt 滤波
FLTR filter 滤波器, 过滤器;
Filt 滤波
FM feedback memory 反馈存储器; field memory 现场存储器, 字段存储;
frequency modulation 调频; frequency multiplexing 倍频; functional memory
功能存储器
Fm 最高工作频率
FM/C frequency modulation/continuous 调频/连续信号
FMADDR FA address FM 地址
FMCW, FM-CW, FM/CW frequency modulation/continuous wave (radar
signal) 调频连续波 (雷达信号)
FMF(B) frequency-modulated feedback 调频反馈
FMLD FM 装入 (负载)
FMOD 频率模数控制
FMSYNC FM 同步
FMX frequency modulated transmitter 调频发射机
FN finish 完成, 结束; 终止; foot note 脚注; frequency noise 频率噪声;
function 功能, 函数
FNuLL 频率零位

FO(ut) 频率输出

FOD 奇偶校验器，奇数输出

FRCBYTEN force byte enable 强制字节允许

FORTTRAN formula translation language 公式翻译语言（IBM）

FP 进位传递函数输出；feedback positive 正反馈；flat-pack package 扁平封装；floating point 浮点；frequency pulse 频率脉冲

FPA Floating Point Accelerator 浮点加速器

FPAC flight path analysis and command 航迹分析与指令控制

FPE positive feedback enable 正反馈允许

FPGA field programmable gate array 现场（用户）可程序门阵列

FPR 优先频率运算

FPU floating point unit 浮点计算部件

FR 逐位进位输出；failure report 故障报告；fast release(relay) 快放（继电器）；flow recorder 流量记录器；fragment（文件或程序的）段；frequency response 频率响应；full rate 全速率；反馈电阻

F/R 正向/反向

FR(=FL_t RST)/STP 故障复位/步进

FRCK FR 时钟

FRD(ATA) 数据段

FREQ frequency 频率

FREQADJ frequency adjust 频率调整

FREQComp 频率补偿（调整）

FRF free-running frequency 本振频率，非同步频率

FRLD fast load 可负载，快速

FRM form 形态；frame 帧

FRsel fast select 快速选择

FRSTB 可选通，快速选通

FRT failure rate test 故障率测试

FS 频率选择；帧同步；fail-safe 可靠的，不出故障的；feature size 特征尺寸；full scale 满度；全部的；全标度；full size 总尺寸，实物尺寸

FSR 用于接受 PCM 通道输入帧的同步脉冲
FSX 用于发送 PCM 通道输入帧的同步脉冲
FSC fail-safe concept 可靠的, 不出故障的观念; 帧同步控制; **finite state channel** 有限态通道
FSI frame synchronization indicator 帧同步指示器; 频率选择输入
FSK frequency shift keying 频移键控
FSM forward set-up message 正向连接信息
FSO full-scale output 全幅输出 (信号); 频率选择输出
FSR field strength ratio 场强比
FST frequency shift transmission 频移传输; **fast** 快速; **first** 第一, 首先
FT forward transfer 正向传递; **frame transfer(imager)** 帧传送 (图像发生器); **requey tracker** 频率跟踪装置; **full time** 全部时间; **functional test** 功能测试
FT 频率发送流入推进
FTA 馈通调节
FTC 快速测试控制
FTI 正向传送输入
FTO 正向传送输出
FTPL 参见 FT, PL
FTPR 参见 FT, PR
FTS forward transfer signal 正向传送信号; 频率传送 (发射)
FTX 频率发送
FULL 堆栈满
FUO 仅为 I, T 使用
FW full-wave 全波
FWD forward 向前, 正向
FX fast cross-talk 快速串话; 频率传送
FXACK FX 响应

┌

G, g gain 增益; **gate** 门, 门电路, 选通脉冲; 栅, 栅极, 控制极; **generator**

发生器, 发送器; **ground** 接地, 地

G₀, G₁...G_n 进位产生输入

GA GADJ gain adjustment 增益调整

GAB A 至 B 增益, 门, 选通

GAL generic array logic 普通阵列逻辑

GAR 组先行接受

GAS 组先行发送; 增益调节

GBA B 至 A 增益 (门, 选通)

GBW gain-bandwidth 增益-带宽 (乘积因数)

GC gain control 增益控制; gate circuit 门电路; grounded collector 集电极接地组态, 共集电极组态; grounded condenser 接地电容器

GD gate driver 门驱动器

GDNCE guidance 制导, 引导, 控制

GDS geometry design system 几何设计系统

GE 组控制门允许

GEN 发生; generator 发生器, 发电机

GENLOCK general locking 强制同步

GF generator field 场发生器

GG 发生器组信号; ground-to-ground 地对地

GHC gating half-cycle 半周选通

GIO(C) generalized input/output(controller) 通用输入/输出 (控制器)

GL 锁存允许, 选通引线; gain loop 增益环路

GN 进位发生/符号位状态

GND ground 接地, 大地, 地面

GND_{IN} 输入接地

GND_{OUT} 输出接地

GND_{sw} 开关接地

GND_A 模拟地

GND_D 数字地

GND_P 功能地

GND_R 基准地
GNT generate 发生
GNTR generator 发生器
Golay Cell 红外线指示器
GP gain power 功率增益; grid pulse 栅极脉冲
GPA gate pulse amplifier 选通脉冲放大器
GPiB, GP-IB general purpose interface bus 通用接口总线
GPS general process simulator 通用过程模拟程序
GPSW gate pulse switch 选通脉冲开关, 通用开关
GR general register 通用寄存器; grid return 栅极回路; ground 接地, 地面, 大地; group 组, 群
GRD ground 接地; guard 保护, 防护
GRNT grant 允许, 应答, 容许
GS 增益选择; 组信号
GS(C) gate signal (circuit) 选通信号 (电路)
GS_x 芯片上独立运放的输出终端; guard time 保护时间
GSM generalized sequential machine 广义时序机
GSR 接收增益调节
GT gate 门, 选通, 准许
GUARD 保护端
GUI Graphic-User Interface 图形用户界面, 图形用户接口
GV(ID)O 缘视频输出
GWR 选通写, 产生写

┌

H, h 行 (扫描); height 高; hold 同期, 同步; 保持, 保留; 成立
HA home address 标识地址, 起始地址, 固有地址
HACK host acknowledge 主响应
HALIGN, HAL highly automated Logic 高度自动化逻辑
HALT 暂停 (控制)
HALT/BA/NMI 停机/总线可用/不可屏蔽中断

HALTI 保持响应输入

HALTO 保持响应输出

HAMP horizontal amplifier 水平放大器

HARM harmony 调和, 谐和

HAS high address select 高(位)地址选择

HAV, HBV... A, B...相脉冲输入

HB high byte 高位字节; 行缓冲

HBD high byte data 高位字节数据

HBE(N) 高位字节允许; 高位缓冲允许

HC half-cycle 半周, 半周期; handshake control 信号交换控制; heavy current 大电流, 强电流

HCI 大电流输入

HCMS high density complementary metal-oxide-semiconductor 高密度互补金属-氧化物-半导体

HCO 大电流输出

HCTR 谐波转换器, 大电流传送

HD, H/D hold 保持(请求)信号; harmonic distortion 谐波失真(控制)

HDB high density bipolar (code) 高密度双级(代码)

HDD high density data 高密度数据

HDERR 参见 HD, ERR

HDL hardware description language 硬件描述语言

HDLC high level data link control 高级数据链路控制

HDP hierarchically distributed processing 分级分布处理

HDTV high definition television 高清晰度电视

HEN 主允许

HF 半满; high frequency 高频

HG high gain 高增益

HI high 高, 大

Hi-EN high enable 高位允许

Hi-Fi high fidelity 高保真度

HINIL high noise immunity logic 抗干扰逻辑（电路）

HLD hold 同期，同步；保持，保留；成立

HLDA hold ack(knowledge) 保存响应（肯定）

HLDC high level data control 高级数据控制

HLIV high level input voltage 高电平输入电压

HLSSC 高电平级旁路

HLT halt 停止，停机，暂停；high-to-low transition 高-低变换，“1”-“0”

变换

HNIL high noise immunity logic 抗干扰逻辑电路

HO harmonic oscilllator 谐波振荡器；horizontal output 水平输出

HOG homing on offset beacon 偏移信标自动引导；high output current 大输出电流

HP X 射线保护；high pass (filter) 高通（滤波器）；high permeability 高导磁率；high pressure 高压

HP-HIL Hewlett-Packard human interface link 惠普用户接口链路

HPA high power amplifier 大功率放大器；高通

HPF high pass filter 高通滤波器

HPPI 高效并行接口

HR/W host read/write 主读/写

HR, HRst hand reset 手动复位，手动调零；high resistance 高阻

HREF hypothetical reference 假设基准

HREQ host request 主请求

HRP 高复位极性

HRQ hold request 保持请求

HRX hypothetical reference connection 假设参考连接，假设基准连接

HS 滞后设定；打点控制；接头选择；high stability 高稳定性；homing sequence 引导序列；horizontal scale 水平扫描，水平标度

HSC high speed channel 高速通道

HSD high speed data (link, channel) 高速数据（链路，通道）

HTL high threshold logic 高阈值逻辑

HVI 高电位（电平电压）输入
HVL high voltage lead 高压引线
HVO 高电位（电平电压）输出
HYS hybrid scanning 混合扫描；滞后输出
HZMP horizontal impulse 水平脉冲，行扫描

∩

I/O input/output 输入/输出

I/OA, I/OB I/O 端 OA 端 OB

I&F interface 接口，界面

I, i input 输入，输入端；**immediate** 立即；**interrupt** 中断；**internal** 内部

I_{CC} 电源电流

I_{CCL} 导通电源电流

I_{DD} 电源电流

I_{INJ} 注入电流

I_{OVR} 溢出状态输入

I_{REF} 基准电流

I_o 工作电源电流输出电流

I₀, I₁...I_n 编码器编码输入

I_C 进位状态输入

I_I 输入电流端

I_{O(on)} 输出管通时吸收电流

I_R 维持态电源电流

IA image amplifier 图像放大器，视频放大器；**immediate address** 立即地址，绝对地址；**interrupt allowed (bit)** 中断允许位

IA(C)K immediate acknowledgement 立即响应，立即确认，立即肯定回答；**interrupt acknowledgement** 中断应答

IAN input alignment network 输入调整网络

IAR instruction address register 指令地址寄存器

IAS immediate access store 直接存取存储器；**interrupt acknowledge signal** 中断应答信号

IASR interrupt address storage register 中断地址存储寄存器
IB 消隐输入; input buffer 输入缓冲器
IBC 输入缓冲器控制
IBF(ULL) in buffer full 输入缓冲器满
IBFE in buffer empty 输入缓冲器空
IBFI in buffer incomplete 输入缓冲器未滿
IC identification code 识别码; impulse circuit 脉冲电路; impulse counter 脉冲计数器; initial condition 初始条件; input current 输入电流; instruction code 指令码; integrated circuit 集成电路; internal connection 内连, 内部连接
ICDD 参见 IC, DD, I, CDD
ICMP interchannel master pulse 通道间主脉冲
ICT incoming trunk 入中继线; inspection control test 检验控制测试
ID interrupt disable 中断禁止; inversed diode 倒相二极管
IDC impulse-driven clock 脉冲驱动时钟; input control display 输入控制显示器; integrated disk controller 集成磁盘控制器
IDCP in decouple 输入去耦
IDEC-ISDN 数字交换控制器
IDES information and data exchange system 信息和数据交换系统
IE(N) instruction enable 指令允许; interrupt enable 中断允许
IEA, IEB 输入启动 A, B 线
IEC-ISDN 回波消除电路
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 电气工程师和电子工程学会(美国)
IEI 中断允许输入
IEO 中断允许输出
IES 串行输入允许; **IF** information flow 信息流; information feedback 信息反馈; infrared 红外的; intermediate frequency 中频
IF 清零; 输入频率调整(补偿)
IF_{SO} 中放负反馈
IFB input FIFO buffer 输入先进先出缓冲器; inverse feedback 负反馈

IFBR interface buffer register 接口缓冲寄存器
IFC input format control 输入格式控制
IFCL IFC 锁定
IFOL IF 输出锁定
IIC interface integrated circuit 接口集成电路；International Institute of Communications 国际通信学会
IIL integrated injection logic 集成注入逻辑（电路）
IK 清色和识别
IL idle 空载的，无效的，备用的
ILACC 集成局域通信控制器
IM impulse modulation 脉冲调制
IMIN IM 输入
IMP impulse 脉冲
IMS image motion simulator 象移模拟器
IN input 输入
IN 符号状态输入
IN+ 同相输入
IN_{SAM} 锯齿波输入
IN_{SIF} 半音中频输入
IN_{SYNC} 同步控制输入
IN₀, IN₁ 逻辑输入“0”，“1”
IN₀, IN₁...IN_n 编码器编码（指令码）输入
IN- 反相输入
INCR increment 增量，增加；increment register 增量寄存器；interrupt control; egister 中断控制寄存器
IND indicator 指示器；induction 感应
INEX 输入扩展外部输入不能实行
INH inhibit 禁止；inhibit input 禁止输入
INHOFR 不均值（非同类）输出字段；禁止过频继电器
INITPAC 参见 INIT, PAC

INITTAC 参见 INIT, TAC

INJ 注入

INP inhibit presentaion 输入 P 信号; 禁止图像, 禁止扫描

INQ inquiry 询问, 查询

INR, INREQ information request 信息请求

INS 禁(阻)止信号

INST 安置, 装入; instruction 指令, 命令

INT integral 积分

Int 内部中间

INT(R) interrupt 中断请求, 可屏蔽中断

INTA(CK) interrupt acknowledge 中断确认, 中断响应, 中断应答

INTB interrupt bus 总线中断

INTDIS 中断关闭(禁止)

INTE 置“0”, 置“1”功能控制

Integ 集成合成

INTEN(B) interrupt enable 中断允许

INTER (词头)表示“在中间”或“相互”

INTPT, INTRPT interrupt 中断, 中断信号

INTRL interal 内部

INV inverse 反相

INV(TR) inverse 相反的, 反相的; inverter 反相器

INVALO(P) 无效输出(端)

INX, INDX Index 指数, 索引, 变址, 下标

IO/B, IOB 输入-输出总线方式; input-output buffer 输入-输出缓冲器

IO/M, IOM input-output mode 输入-输出方式

IOCO 集电极开路, 反相输出

IOEN 输入-输出启动

IOP(A) input-output port (address) 输入-输出端口(地址)

IOPT 输入-输出 PT

IOR(C) input/output read 输入-输出读出(读命令)

IOR(E)Q input/output request 输入-输出请求
IOS input-output supervisor 输入-输出开关, 输入-输出切换
IOSC input-output switching channel 输入-输出交换通道
IOT input-output test 输入-输出检验; input-output transfer 输入-输出传
 送; input-output transducer 输入-输出转换器
IOW(C) input/output write 输入/输出写 (命令)
IP identification of position 位置识别; identification pulse 识别脉冲;
 interrupt priority 中断优先
IP₀, IP₁...IP_n 并行输入
IPI 中断优先输入
IPM input/output port memory data bus 输入/输出端口存储数据总线
IPO 中断优先输出
IPOINT 参见 IPO, RT, IP, ORT
IQ in-phase+quadrature 同相+正交 (通道); input queue 输入排队, 输入
 队列
IR impulse ratio 脉冲比; impulse response 脉冲响应; infrared 红外的;
 input ready 输入准备好, 输入准备就绪; instruction register 指令寄存器;
 internal register 内部寄存器; internal request 内部请求; internal resistance 内
 阻; interrupt register 中断寄存器
IR, IRQ 中断请求, 可屏蔽中断
IRF 寄存器满
IRL Infrared Line Scanner 红外线扫描器
IRLEN LR line enable IR 线允许
IRQ idle repeat request 空闲通道重复请求; IR-quenching 红外消隐;
 interrupt request 中断请求
IRQPE interrupt request parity error 中断请求奇偶错, 误中断请求
IRQR interrupt request ready 准备中断请求
IS idle signal 空闲信号; 禁(阻)止信号; interrupt status (register) 中断
 状态 (寄存器); input strobe 输入选通
ISA instruction set architectures 指令集结构, 指令系统体系结构

ISAC ISDN 用户存取控制器

ISDN intergrate service digital network 综合服务数字网络

综合服务数字网络用户部分

ISDT integrated service digital terminal 综合服务数字终端

ISIS image storage inspection system 图像存储检验系统; individual service informatio system 个人服务信息系统; integrated safeguards information system 综合信息保护系统; intelligent scheduling and information system 智能调度信息系统

ISS information storage system 信号存储系统; Instruction Set Simulator 指令集模拟程序

ITAC ISDN Terminal Adapter circuit 综合服务数字网络终端适配器电路

ITS insertion test signal 插入试验信号

IV interface vector 接口向量器; 接口矢量; inverter 反相器

IX index 索引, 下标

IZ 零状态输入

IZB 内部齐纳二极管旁路

U

J, j jack 孔, 插口; joint 连接, 接口; junction 结; 接合; 汇接点

J, K 寄存器 J 置 1 输入 K 置 0 输入; JK 型触发器 (FF) 输入其中 J: 置位侧, K: 复位侧

JA jump address 转移地址

JAN 军品级

JANS 宇航级

JANTX 特军级

JANTXV 超特军级

JC jack connection 插孔连接; jump condition 转移条件, 跳跃条件; jump on carry 进位转移; junction 结, 接合, 汇接点

JCT, J(CT)N junction 结; 接合处, 接点, 连接

JEDEC Joint Electron Devices Engineering Council 电子器件工程联合委员会

JEIA Japanese Electronic Industries Association 日本电子工业协会

JEP jump to external port 外端口转储, 转移到外端口

JFET junction field effect transistor 结栅场效应晶体管

JI junction isolation P-N 结隔离

JL jump on minus 负号转移

JMP jump to next address input 下一地址输入转储, 转移到下一个地址

输入

JNC jump on no carry 不进位转移

JP jump on positive 正号转移

JPW job processing word 作业处理字

JR jump relative 相对转储

JS jam strobe 干扰选通脉冲

JZ jump on zero 为零转移 (指令)

...

K 触发器, 锁存器, 输入 (参见 J)

K₀, K₁...K_n, K_a, K_b... 多功能门功能控制

K, k key 键, 按键

KAD 参数地址

KB keyboard 键盘; kilobit 千位; kilobyte 千字节

KC 键盘列扫描

KCLK key-board clock 键盘时钟

KDR keyboard data recorder 键盘数据记录器

KDRES key delte reset 键删除复位

KR 键盘行扫描

KRET key return 键返回

KS 键回波信号源

...

L/H low-to-high 低到高

L/M lines per minute 行/分

L(T)N 梯形网络

L&S 逻辑和电平

L, **I** label 标记; **lamp** 灯, 灯泡; **left** 左边的; **level** 电平; **line** 行, 线; 锁存器

load 负载, 负荷; **low** 低的, 弱的; 低电平 (电位电压)

L-SW, **LS(W)** limit switch 限位开关, 极限开关; **left switch** 左开关

LA level amplifier 电平放大器; **link address** 连接地址; **load address** 负载地址; **load adjuster** 负载调整器; **logarithmic amplifier** 对数放大器

LAC load accumulator 装载累加器

LALR look-ahead left-to-right 由左向右看

LAM “look at me” 中断信号; **loop adder and modifier** 循环加法器与变址数

LAMP 灯 (驱动)

LAN local area network 局部网络, 局域网络

LAO 超前选择

LAP logical access path (scheme) 逻辑存取通路 (方案)

LAPB link access protocol, balanced mode 平衡方式线路存取协议

LAPD link access procedure on the Dchannel D 通道链路存取过程

LB line buffer 线路缓冲器; 锁存器旁路; **low byte** 低字节; **lowest bound** 最低界限

LBD 低电池组指示器

LBEN 低字节允许

LBERR bus error 总线差错

LBK 环回

LBL label 标记

LBM load buffer memory 负载缓冲存储器, 装入缓冲存储器

LBT low bit test 低位检验

LC 线电流; **launch control** 发射控制; **level control** 电平控制; **liquid crystal** 液晶; **line carrying** 行移; **line circuit** 用户线电路, 行电路; **line connector** 线路连接器; **link circuit** 链路; **logical channel** 逻辑通道

LCC leadless chip carrier 无引线芯片载体

LCD liquid crystal display 液晶显示（器）

LCH load channel 负载通道；logical channel queue 逻辑通道队列

LCL limited channel logout 限定通道记录输出；low control limit 控制下限

LCN load classification number 负载分类号

LCNTR load counter 负载计数器

LCS loadness-countout selector 负载点数选择器

LCSW latch checking switch 锁存检验开关

LD load 负载，负荷，装载，装入锁定，检波

LDAC 装载数据转换

LDC load-constant-autoincrement 自增量负载常数，负载-恒定-自增量

LDS lower data strobe 低位数据选通

LDSTB load strobe 负载选通

LE leading edge 前沿；锁存控制（允许）

LEAB 锁存允许 A-B

LEBA 锁存允许 B-A

LED light-emission diode 发光二极管

LEV level 电平，水平；级，程度

LF low frequency 低频

LFD 接鉴频线圈

LFS loop feedback signal 环路反馈信号

LG 低基（组合）；line generator 行发生器；loop gain 环路增益

LGL logic left shift 逻辑左移

LGN line gate number 线门数

LGR logic right shift 逻辑右移

LI level indicator 电平指示器；location identifier 位置识别符

LIFO last in first out 后进先出

LIH 线输入高

LIL 线输入低

LIM limit 限度，极限；limiter 限制器；限幅器；linear interface module

线路接口模块

LIMAMP 参见 LIM, AMP

LIN linear integrated network 线性集成电路, 线性综合网络; link inhibit signal 链路禁止信号

LINKPO 链路 PO, 局部网 PO

LJ/RJ 左侧对齐/右侧对齐

LK link 链路

LKG linking 连接

LL low level 低电平

LLL low level logic 低电平逻辑

LLM low level modulation 低电平调制

LLN low level network 低电平网络, 低级网络

LLS long left shift 向左长移位; low level stage 低电平级

LM left margin 左边际, 左边界; line mark 行标记, 线标记

LO local oscillator 本机振荡器; lock-out 锁闭(锁定)输出; low order 低位数, 低阶

LOC 循环联机控制

LOCK 锁存, 锁定

LOG logarithm 对数; logic 逻辑, 逻辑电路

LOH 线输出高

LOL 线输出低

LOOP 回送, 返回, 回线

LOS loss-of-signal 信号损失

LP loop 环, 环路, 回路; low-pass (filter) 低通(滤波器)

LPA link pack area 线路阻塞区

LPA low-pass amplifier 低通放大器

LPBK loopback 回路返送, 反相环

LPBL 回送 BL

LPC linear power controller 线性功率控制器

LPF low-pass filter 低通滤波器

LR level recorder 电位记录器, 水位记录器, 液面记录器接收循环; **load register** 负载寄存器; **load resistance** 负载电阻; **low resistance** 低阻

LRC level-recording controller 电平记录控制器; 有限远程通信; **load ratio control** 有效载荷控制, 载荷比控制

LRCK load register clock 负载寄存时钟; **level register clock** 电平记录时钟

LReg load register 负载寄存器

LRN 梯形电阻网络

LRP, LReS(et)Poiav(ity) 低复位极性

LS laser system 激光系统; 有效位长度; **least significant** 最低有效的; 对数比例; 线性比例; 锁存选通; **locking shift** 闭锁移位

LSB least significant bit 最小有效位, 最低有效位

LSD least significant decade 最小有效十进数位, 十进制最低有效位

LSI large scale integration 大规模集成

LSS least significant slice 最低有效芯片; 电平输入

LSTTL low-power Schottky transistor-transistor logic 小功率肖特基晶体管-晶体管逻辑(电路)

LT 灯测试输入(译码器)

LTB last trunk busy 最后中继占线; **low-tension battery** 低压电池

LTCH latch 锁定

LTF ladder-type filter 梯型滤波器

LTS lateral test simulator 水平扫描模拟器, 横向测试模拟器

LUT look-up table 查表

LV low voltage 低压

LVDT linear variable differential transformer 线性可变微分变压器; **linear voltage differential transducer** 线性电压微分变换器

LVL level 水平, 电平, 能级

LVS low-velocity scanning 低速扫描

LX 极化发送循环

∴

M/D 方式控制（选择）

m/B, M-B make/break 通/断，通-断

M/IO IO 状态线；存储器 I/O

M, m 取指周期；微处理器；main 主要的；电源；maintenance 维护，保养，保持；mark 标志，标记，特征；mode 模，模式；振荡模；方式，方法，状态；modulation 调制；modulus 模数；模量；模差；模件，组件，微型组件

M-D modulation-demodulation 调制-解调；modulator-demodulator 调制器-解调器

MA memory address 存储器地址；modified address 修改地址；multiple access 多路存取

MAC microprocessor-array computer 微处理机阵列计算机；multi-access controller 多路存取控制器；multiple address code 多地址码；multiplexed analogue components 多路传输模拟量部件

MAD 存储器地址数据；memory access director 存储器存取控制器

MAG magnet 磁；magnify 放大，增强；magnitude 尺寸大小

MAGP maximum gain path 最大增益线路

MAPE 修改地址允许

MAREIV 存储器地址寄存器启动

MAX maximum 最大值，最大的

MB megabyte 兆字节；memory buffer 存储器缓冲器；modular block 模块

MBE 中位允许

MBF modulator band filter 调制器带通滤波器

MBFP 参见 MB, FP；MBF, P

MBFT 参见 MB, FT；MBF, T

MC master control 主控（方式控制选择）

MC(H) 主链路（通道回路）

MCE mutual coupling effect 互耦合效应

MCE 主逐位允许

MCG master clock generator 主时钟（脉冲）发生器； monolithic clock generator 单片时钟（脉冲）发生器

MCK 同 MCLK

MCLK master clock 主时钟，主时钟脉冲

MCLK_R 接受主时钟

MCLK_X 发送主时钟

MCLR main clear 主清零

MCP main control panel 主控制板； microchannel plate 微通道板； multichannel communications program 多通道通信程序

MCU master control unit 主控部件； memory control unit 存储器控制部件； microcomputer unit 微型计算机设备； microprocessor control unit 微处理器控制设备

MCW modulated carrier wave 调制载波； modulated continuous wave 调制连续波

MD 存储器数据； memory dump 存储器信息转储； message data 信息数据； modulator 调制器； motor drive 电机驱动

MD(IV)S(eI) master divide select 主控分配选择

MDA multiplying digital-to-analog 多重数字-模拟

MDIS M 禁止

MDS 方式选择； multiple data streams 多数据流； multichannel, multipoint ; istribution service 多通道多点分布服务

ME 多路开关（转换）允许； 存储器允许； 掩蔽允许

MECL multi-emitter coupled transistor logic 多发射极耦合晶体管逻辑（电路）

MEM memory 存储器

MEMPHAS 参见 MEM, PHAS

MEMR memory read 存储器读出

MEMW memory write 存储器写入

MEND macrodefinition end 宏定义结束

MENTOR 面向程序设计教学的程序设计语言

MES metallized semiconductor 金属化半导体
META assembler language 汇编语言
MF medium frequency 中频
MFM modified frequency modulation 变频调制; multifunctional memory 多功能存储器
MFP multifunction port 多功能端口
MHOLD memory hold 存储器保持
MI maskable interrupt 可屏蔽的中断
MIG metal in gap (head) 金属化缝隙 (磁头)
MIGP minimum gain path 最小增益线路
MIL military (norm) 军用 (标准), 军用 (规格)
MIMIL multiinput multioutput integrated injection logic 多输入多输出集成注入逻辑
MIN minimum 最小的, 最小值, 极小值
MEN(AB) master enable 总允许, 总启动, 总允许
MIPS metal-insulator-piezoelectric semiconductor 金属-绝缘体-压电半导体; million instructions per second 百万条指令/秒
MIR memory-information register 存储器信息寄存器
MIS 错误
mis, ADJ MIS 调整
MISC miscellaneous 混杂的, 各种各样的
MISO 主输入/从输出
MITP 监视器端
MIX mixer 混频器, 混合器
MK manual colck 手控时钟; mark 标志标记, 特征
ML(ink) 主连接线; 信息长度
MLC multilevel channel 多级通道
MLS main line switch 主线路开关
MM main memory 主存储器; 维护方式; 存储器管理
MMAP 存储器变址 (选择)

MMIC millimeter wave integrated circuit 毫米波集成电路; monolithic microwave integrated circuit 单片微波集成电路

MMU mass memory unit 大容量存储器部件; memory management unit 存储器管理设备

MN main 干线; 电源; 主要的; modal noise 模态噪声

MN/MX 最大/最小 (模式控制)

MOD(E) moduar 模的, 模数的; 方式 (控制); modulation 调制; modulus 模数, 模量

MODL model 模型; module 模数

MODPI 参见 MOD, PI

MON(I) monitor 监视器, 监听器

Mon(o) (词头)单; monitoring 监控、监听、监视、监测

MONBCO 参见 MON, BCO

MONLRCO 参见 MON, LRCO

MONWDC 参见 MON, WDC

MOP 主控 OP

MOPA master oscillator-power amplifier 主控振荡器-功率放大器

MOS-FET metal-oxide-semiconductor field-effect transistor 金属-氧化物-半导体场效应晶体管

MOSI 主输出/从输入

MP multi-pole 多极; multi-purpose 多用途的, 通用的

MPC microprogram control 微程序控制; multi-path channel 多路通道; multi-process controller 多过程控制器; multi-program control 多程序控制

MPCC multiprotocol communications controller 多协议通信控制器

MPR main processor 主处理机

MPU microprocessing unit 微处理部件

MPX multiplex 多路传输, 多路转换; multiplexer 多路转换器, 多路调制器; 信号连乘器, 倍增器

MPXR multiplexer 多路转换器, 多路调制器; 信号连乘器, 倍增器

MPY multiply 乘, 倍增

MR 主复位总接收器; memory register 存储器寄存器; message register 信息寄存器; message repeat 信息重复

MR/W 存储器读/写

MRD machine readable (data) 机器可读

MRD(C) 存储器读 (命令), 主控读选通

MREQ memory request 存储请求

MRES(T) main reset 主复位

MRF message-refusal signal 信息拒绝信号

MRSet, MRES(T) 总复位, 主复位

MRST master reset 主复位

MS 总发送; 主置位

MSB most significant bit 最高有效位

MSC mass storage controller 大容量存储控制器; master-slave configuration 主-从结构, 主-从配置; most significant character 最高有效字符

MSD most significant decade 最高有效十进位 (数)

MSERR ms 差错; 主串行寄存接收; 串行接收方式控制

Mset 主置位

MSI medium scale integration 中规模集成

MSK minimum shift keying 最小移位键控

MSP multi-stream processing 多数据流处理

MSPS multiphase serial-parallel-serial storage 多相串行-并行-串行存储 (器)

MSPSel MSP 选择, 主控 SP 选择

MSR magnetic shift register 磁移位寄存器, 参见 M, SR

MSRSEL 参见 MSR, SEL

MSS mode selector switch 模式选择开关

MST 参见 M, ST; master 主站, 主 (控制); microsystem tester 微系统测试器; monolithic system technology 单片系统工艺

MSTEMON master monitor 主控监视器

MSW master switch 主控开关; micro switch 微型开关, 微动开关

MSWsel 参见 MSW, Sel

MT measurement 测量; message transfer 信息传输; mode transducer 模
变换器; multiple transfer 多路传送

MTS message transfer system 信息传输系统

MULT multiplier 乘数, 乘法器, 倍增器, 扩(量)程器

MUM multi-unit message 多单位信息

MUT mute 静噪

MUX multiplex 多路传输, 多路复用; multiplexer 多路转换器, 多路调
制器; multivibrator 多谐振荡器

MV(B) multivibrator 多谐振荡器

MVTL Motorola variable threshold logic 摩托罗拉可变阈值逻辑

MWI memory write instruction 存储器写指令

MWR 主控写选通, 机器写

MWT(C) 存储器写(命令)

MX 最大; multiplex 多路传输, 多路复用

N/C numerical control 数字控制

N CLK n 倍时钟; 标记; noise 噪声; number 数, 数字; 号码, 编号;
计数

N Integ 噪音集成

N-H 半负载, 分半截

N, n navigation 导航

NA network analog 网络模拟; 下一个地址; not assigned 未指定的; not
available 得不到的, 不合用的

NABT noise abatement 噪声减除

NACK negative acknowledgement 否定应答, 否定信号, 否认

NAI no address instruction 无地址指令

NAK negative acknowledge 否定应答, 否定信号, 否认

NAM non-addressable memory 非可编址存储器

NAN 数字模拟网络

NAND inverted AND gate 反向“与”门

NAPLP North American presentation level protocol 北美图像级别协议

NB narrow band 窄带

NBC narrow band channel 窄带信道; **noise balancing control** 噪声平衡控制

NBCD natural binary coded decimal 自然二进制编码的十进制

NBDL narrow band data link (line) 窄带数据链(线)路

NBF narrow band filter 窄带滤波器

NBR number 数, 编号

NBS National Bureau of Standard 国家标准局

NC network connection 网络连接; **network control** 网络控制; **network controller** 网络控制器; **no connection** 不连接, 未连接; **numerical control** 数字控制

NCH no circuit, circuit ordered held 占线, 等待, 勿挂机

NCHN(E) no connection high number (enable) 无连接高字位(允许)

NCLK network clock 网络时钟

NCO numerically controlled oscillator 数控振荡器

ND 移位输入; 输出控制; **no detect** 未探测的, 未检测的; **non-delay** 无延迟; **nondirectional** 非定向的, 无方向性的

NDAC 未接收数据, 无准备数字

NE negative edge (信号脉冲) 负沿; 非易失允许, 永久允许(存储/取消控制)

NEG negative 负的; 否定的

NENE NEXT, Near 下一个临近信号

NET 发送启动; **network** 网络; 电路; 回路

NETCON network control 网络控制

NF negative feedback 负反馈; 噪声抑制

NFB negative feedback 负反馈

NFBL negative feedback loop 负反馈环路

NFE network front end 网络前端

NHPV 反相手动脉冲（输入）

NIAT non-indexable address tag 非变址地址标记

NICE normal input/output control executive 正规输入/输出控制执行程序

NIN name index number 名字索引编号；不可逆（反相）

NIO network input/output 网络输入/输出

NIPO negative input-positive output 负输入-正输出（设备）

NIU network interface unit 网络接口设备

NJ network junction 网络连接

NLC negative-logic-circuit 负逻辑电路

NLS negative-logic signal 负逻辑信号

NMI nonmaskable interrupt 非屏蔽中断

NMOS n-channel metal-oxide-semiconductor N 沟道金属-氧化物-半导体

NMT Nordic mobile telephone (system) 北欧移动式电话（系统）

NO PIN 无引脚

NO(O)P no operation 无操作指令，无操作

NON-INV 同相

NOR NOT OR “或非”

NORM 标准，定额

NOVRAM nonvolatile random access memory 永存随机存取存储器

NP nonprint 禁止打印，不打印

NPC 无极性电路

NPM negative-positive-metal n-p 金属（结构）

NPN n-p-n structure n-p-n 结构

NPS non-powered storage 非用电存储

NPX, N-PSK N-phases pulse-shift keying N 相脉（冲）移（位）键控；
N-ary phase shift keying N 元相移键控，N 状态相移键控

NQ 未指定输出，网络输出，反相输出

NR noise reduction 降噪，噪声减少，噪声处理；nonreversible 不可逆的，
不反转的

NRFD 数据未准备好

NRI network radio interface 无线电网络接口

NRZ non-return-to-zero 不归零制

NRZ-C non-return to zero change 不归零-变换（记录）

NRZ-M non-return-to-zero mark signal 不归零标记信号

NRZI, NRZ-L non-return-to-zero level signal 不归零电平信号

NRZI, NRZ-I non-return-to-zero information code 不归零信息码

NS not specified 未规定的，未指定的

NSN National Stock Numbers 国内标准编号

NT network terminal 网络终端； network termination 网络终端； no transmission 无发送，无传输

NTDS naval tactical data system 海军战术数据系统

NTL non-threshold logic 非阈值逻辑

NTS network transport service 网络传递服务

NTSC National Television System Committee 国家电视系统委员会，国家电视体制委员会

NU 无用

NUL null character 零字符，空字符； null 零，无，调零，失调（电压）

NUM numerical 数字的；用户不使用； numerator （分数的）分子；计数器

NV 非冒失性允许

NVRAM nonvolatile random access memory 永存随机存取存储器

NVS nonvolatile storage 永存存储器

∴

EODD 累加奇数（校验输出）

O/C open-circuit 开路，断路

O/E optical-to-electric 光-电（变换）

O/I 输出/输入（双向口）

O/P operation/program 操作/程序

O/R originater/recipient 发送者/接收者

O, o output 输出，输出（信号），输出功率，输出端； operation 操作，运算

OA 失调调整 (运放器); 调零端; operating assembly 功能组件;
operational amplifier 运算放大器

OAEN OA 允许

OAV 输出可用值

OB output buffer 输出缓冲器

OBF 输出缓冲器满

OBFI 输出缓冲器未滿

OBO output balk off 输出偏移

OC open collector (circuit) 集电极开路 (电路) (输出形式); 输出控制;
optical communication 光 (纤) 通信; overcurrent 过电流

OCL open-circuit (primary) inductance 开路 (初级) 电感; operational
control level 操作控制级; outgoing correspondence log 输出对应记录

OCTERM over current terminal 过荷终端

OD 数据输出禁止控制; 漏极开路 (输出形式); 检波输出; output data 输
出数据

ODD 奇数 (控制)

ODL optical data link 光数据链路; optical delay line 光延迟线

OE 输出允许; operational efficiency 工作效率

OE_Y Y 输出允许端

OEA, OEB... 输出启动 A 端, B 端...

OEC odd-even check 奇偶校验

OEF opposing electromotive force 反电动势

OEI overall efficiency index 总有效系数, 总有效指标, 总效率指数

OEI 输出电零点 (位)

OEI(C) opto-electronic integrated (circuit) 光电子集成 (电路)

OEIEXT 参见 OEI, EXT

OEIM 输出交换接口模块, 参见 OE, IM

OEL 允许输出锁定 (锁存)

OEM OEM microcomputer OEM (配套) 微计算机

OEM product OEM (配套) 板

OEN 输出允许

OEQ 输出允许请求

OER operational equipment requirement 设备操作要求，运算设备要求；
输出允许寄存；输出有效电阻；输出错误恢复

OEREXT 参见 OER，EXT

OES open-ended system 串行输出允许

OEST OE 传送

OEXP out expander 扩展输出

OF oil-filled 油浸的，充油的；偏移补偿；overflow 溢出，上溢

OFB output FIFO buffer 先进先出输出缓冲器

OFC 输出频率调整（补偿）

OFF 截止态；offset H 补偿（偏差）保持

OFSTNL off-set null 失调（偏置）零

OFL overflow 溢出

OFLP off-line processing 脱机处理

OFR operational failure report 操作故障报告；ordering function register
排序函数寄存器

OFS off-set 偏置

OGFA on-chip gated feedback arrangements 芯片上选通反馈电路

OGL outgoing line 引出线

OHC(ap) 补偿保持电容

OHV output high voltage 输出高压

OHW output highway 输出总线

OI operating instruction 操作指令；输出集成

OL open loop 开环，开路；overload 过载

OLP overload protection 过载保护

OLR overall loudness rating 总响度级；overload relay 过载继电器

OLRCK overall loudness rating clock 总响度级时钟

OLSC open loop sync channel 开环同步通道

OMP output make-up 输出形成（器），输出补偿，输出连接

OMT orthomode transducer 直接式收发转换器
OMUX output multiplexer 输出多路转换器
ON 异通态
OP 运放; operation 操作, 工作; 运算
OP CODE operation code 操作码
OP(AMP), OP-AMP operational amplifier 运算放大器
OPC odd-parity check 奇数奇偶校验; operational control 操作控制
OPCD operation code 操作码
OPI(N) 运放输入
OPN open 开, 开路
OPO 运放输出
OPS operations 操作, 运算
OPT 运算传送; optimum 最佳的, 最优的(模式); optional 任意的, 任选的; optical 光
OR 同 OVR; operation ready 工作就绪, 工作准备好; output ready 输出就绪, 输出准备好; output register 输出寄存器
ORA output register address 输出寄存器地址
ORD order 级, 位; 指令
ORE 输出寄存已空, 输出寄存允许
ORM 输出就绪标志; 输出右边限; 输出路径选择矩阵
ORT operational readiness test 操作准备测试
OS one-shot 单稳; operating system 操作系统; 输出段; output strobe 输出选通
OS(M) one-shot multivibrator 单稳多谐振荡器
OSC oscillator 振荡器
OSCH 行振荡
OSE 本振
OSEL out select 输出选择
OSR output shift register 输出移位寄存器
OT 输出发送; 输出

OTC 加重音输出

OTP Office of Telecommunication Policy 电信政策管理局（美国）；
operational test procedure 运行测试程序

OTR 衰减时间控制

OTS 打音信号

OUT output 输出，输出（信号）

outP out positive 输出正

outN out negative 输出负

OUT+ 正相输出

OUT_{X-Y} X-Y 色差信号输出

OUT- 反相输出

OUTREG output register 输出寄存器

OV(L) overflow 溢出；overflow flag 溢出标志

OVL overload 过载

OVR overrun 溢出状态

OVV overvoltage 过压

OX 输出外部

||

P/S parallel/series 串行/并行（选择）

P; P₀, P₁...P_n, P_A, P_B... 进位传送，函数输入，并行存储地址数据 I/O 和最高地址输出

P_A, P_B P 功能 A, B...端

P-N positive-negative 正-负（相位指示极性开关）

P-P peak-to-peak 峰-峰；point-to-point 点对点，定点

P, p positive 正的，阳性的；pulse 脉冲，脉动

PA physical addr 实际地址；phase angle 相角，相位角；pilot amplifier 控制
制导频放大器；图像信号地址；power amplifier 功率放大器；program address
程序地址；编程地址；pulse amplifier 脉冲放大器；pulse amplitude 脉冲幅度；
Pre Amp 预放

PABX private automatic branch exchange 专用自动小交换机

PAC pacing request/response 定步请求/应答; phase automatic control 相位自动控制

PACER project and case evaluator routine 设计和实例评价程序

PACK positive acknowledgement 肯定应答

PAF 可编程近于满

PAL phase alternation line 逐行倒相制(彩色电视制式); 相位变化线;
programmable array logic 可编程序阵列逻辑(电路)

PAM polar amplitude modulation 极性调幅; pulse amplitude modulation 脉冲调幅

PAR page address register 页面地址寄存器; parallel 并行的; parity 奇偶性; program address register 程序地址寄存器

PARCOR partial autocorrelation 部分自相关, 局部自相关

PARERR parity error 奇偶性错误

PAT parity test 奇偶测试; pattern 模式, 型板, 图形, 型式

PATN pattern 模型, 型板, 图形, 型式

PB playback 还音, 放音; 读出, 读数; 反演, 重演; 端口总线; 端口位; pulse beacon 脉冲信标; push button 按钮

PBM pulse burst modulation 脉冲猝发调制

PBRST push button reset 按钮复位

PBX private branch exchange 专用小交换机, 专用转移交换机

PC 极性电路; parity control 奇偶校验控制(复位); personal computer 个人计算机; phase comparator 相位比较器; power circuit 电源电路; preclear 预清零; pulsating current 脉动电流; pulse comparator 脉冲比较器; pulse controller 脉冲控制器; pulse counter 脉冲计数器

PC 预先计算

PCD plasma-coupled (semiconductor) device 等离子体耦合(半导体)器件; power control and distribution 功率控制与分配; program-controlled device 程控设备

PCE(N) 预先计算允许(允许)

PCHN 脉冲电流高字节允许; P 功能通道

PCI programmable communication interface 可编程序通信接口

PCLK 外设时钟

PCM pulse code modulation 脉码调制

PCP parallel cascade processor 并行级联处理机；相位比较脉冲； pulse comparator 脉冲比较器

PD 并行数据；并行禁止；检波； phase detector 鉴相器，相位检波器；脉冲断开（去耦）； pulse driver 脉冲激励器，脉冲驱动器

PDEN 外部数据允许

PDI parameter dependent instruction 参数相关指令；紧急功率下降； payload data interleaver 有效载荷数据； postdetection integrator 检波后积分器

PDIP plastic dual-in-line package 塑料双列直插式封装

PDN 漏极开路输出；备有掉电模式的控制输入；脉冲下降

PDP plasma display panel 等离子体显示板

PE parity error 奇偶校验错；计数允许（控制）；并行允许（控制）；预置（允许）；启动上拉； phase encoded 相位编码的； photoelectric 光电的； pilot equalizer 控制均衡器 positive edge 正边沿

PEACK 处理器扩展响应

PEB program element breakdown 程序单元破坏

PEG 正沿边

PEREQ 处理器扩展请求

PERR 错误信号脉冲

PF 锁相回路滤波器； pilot-stop filter 控制中止滤波器； positive feedback 正反馈；电源故障； pulse feedback 脉冲反馈； pulse former 脉冲形成器； pulse frequency 脉冲频率

PFLT FLJ 段驱动器

PFM pulse frequency modulation 脉冲频率调制

PG page 页；传送组信号； pattern generation 模式生成，图形生成；状态（定位，负载）发生器； pattern generator 模式发生器，图形发生器； pilot generator 控制导频发生器； power gain 功率增益； processing gain 处理增益； pulse generator 脉冲发生器

PGA Pin-Grid Array 引线-栅极阵列(管脚); power generator assembly 功率发生器部件; programmable gate array 可编程程序门阵列

PGM programmable 可编程序的, 程序控制的, 编程(脉冲)

PH packet handler 包处理程序; packet handling 包处理; 正半载; 全负载; phase 相位; phone 电话机, 电话; 外设

PHA pulse height analyzer 脉冲高度分析器, 脉冲幅度分析器; phase 相位

PHAS 参见 PH, AS

PHD phase shift driver 相移驱动器; pulse-height discriminator 脉冲幅度鉴别器

PHLD phase load 相位负载

PHM(OD) phase modulation 调相, 相位调制(选择)

PHPV 正相手动脉冲

PHS(TB) 相位选通

PI 奇偶性输入; power input 输入功率; primary input 初始输入

PI/SO parallel input/serial output 并行输入/串行输出

PIA peripheral interface adapter 外围接口适配器

PIB pulse interference blanker 脉冲干扰消除器

PIC picture 图像; phase-inverter circuit 倒相器电路; priority interrupt control 优先中断控制

PIF process information file 过程信息文卷

PIM pulse interval modulation 脉冲间隔调制

PIN positive-intrinsic-negative(diode, generator) PIN 结(二极管), PIN 结(发生器)

PIND 功率指示

PINO positive input-negative output 正输入-负输出

PIO parallel input-output 并行输入-输出; port input/output 输入输出口

PIX parallel interface extender 并行接口扩展器图像

PIXEL picture element 像元, 像素

PL party line 合用线路, 团体用户线路; peak loss 峰值损耗并行装入; 功率电平; plate 阳极, 板极, 板; 电镀; power line 电源线

PLA pipeline architecture 流水线体系结构; **programmable logic array** 可编程程序逻辑阵列

PLCC plastic leaded chip carrier 有引线塑料芯片载体; **plastic leadless chip carrier** 无引线塑料芯片载体

PLCD LCD 段驱动器

PLD payload 有效载荷; **phase-locked demodulator** 锁相解调器; **phase-locked discriminator** 锁相鉴别器; **programmable logic device** 可编程逻辑器件

PLE 流水线允许

PLL phase-locked loop 锁相环

PLL LOCK 锁相环锁定

PLM pulse length modulation 脉宽调制

PLO phase-locked oscillator 锁相振荡器

Plt plate 板, 阳极, 极板; **plot** 曲线, 图

PM parallel memory 并行存储器; **phase matching** 相位匹配; **phase modulation** 相位调制; **processor module** 处理机模块; **programmable module** 可编程序模块; **pulse modulation** 脉冲调制

PMBUB 参见 PM, BUB

PMCHK 参见 PM, CHK

PME 相位调整允许; 脉冲调制允许

PMOS, P-MOS p-channel metal-oxide-semiconductor P 沟道金属-氧化物-半导体; **power metal-oxide-semiconductor** 功率金属-氧化物-半导体 (器件)

PMS 可编程存储器选择

PMsel 参见 PM, sel

PMW pulse modulated wave 脉冲调制波

PN part number 零件编号, 部件编号; **positive-negative** 正-负

PNM pulse number modulation 脉冲数调制

PNP positive-negative-positive (structure) p-n-p (结构)

PO parallel output 并行输出; **parking orbit** 暂停轨道, 驻留轨道; 奇偶输出 **polarity** 极性; **power oscillator** 功率振荡器; **power output** 输出功率;

power supply 电源; primary output 原始输出; 初级输出; pressure oscillation 压力振荡; pull-out 拉出, 使不同步; pulse oscillator 脉冲振荡器

PODA priority-oriented demand assignment 面向优先的按需分配;
prioriry oriented demand access 面向优先的按需存取

POE point of entry 输入点; 配对发射极开路输出

POL 极性; polarization 极化, 偏振, 偏置

POR 脉冲振荡接收

PORT 漏极开路双向 I/O, 准反向 I/O

POS position 位置; positive 正的, 阳性的, 正(边沿)

POW power 功率

PP parallel processing 并行处理; **peak power** 峰值功率; **plate pulse** 阳极脉冲; **presentation position** 表示位置; **pulse pair** 脉冲对; **push-pull** 推挽(式的)

PPC point-to-point communication 定点通信, 点对点通信; **Portable Professional Computer** 便携专用计算机

PPG primary pattern generator 原始模式发生器, 初始图形发生器;
programmable pulse generator 可编程序脉冲发生器

PPGA 塑料封装引线-栅极阵列(管脚)

PPM(ppm) parts per million 百万分之(几), 百万分率; **pulse phase modulation** 脉冲相位调制; **pulse position modulation** 脉位调制

PPO push-pull output 推挽输出

PPP parallel pattern processor 并行模式处理机, 并行图像处理机; **parallel push-pull** 并联推挽; **peak pulse power** 峰值脉冲功率; 组件位置引脚;
push-pull power 推挽功率

PR pulse rate 脉冲速率; **preset** 预置; **pair** 对, 双, 线对; **pattern recognition** 模式识别, 图形识别; **periodic reversal** 周期改变符号, 周期反转; **prepare** 准备, 编制; **program register** 程序寄存器; **pulse late** 脉冲重复频率

PRC 极性反向修正

PRD 存有检波(整流); 端口读选通

PRE preset 前置, 预置; 保护寄存器允许

PREAMP preamplifier 前置放大器

PRECOMPEN 预编允许预补偿

PREPN preparation 准备, 制备

PRES Preset 预置; present 在(到)场的, 出席(现)的, 现(当)今的, 目前的, 现存的, 本, 此, 该; pressure 压力, 压强, 电压, 大气压(力), 压缩, 压迫, 挤压, 按, 榨

PRES(ET) 预置, 信息仓复位

PRG, PRG(M), PROG pseudorandom generator 伪随机发生器; program 程序, 编程

PRI priority 优先权, 优先级

PRITY parity 奇偶性

PRM phase reversal modulation 倒相调制; pulse rate modulation 脉冲重复频率调制

PRO 处理器

Pro 赞成(者, 票, 意见), 正面; 前, 前进; 代(理, 替), 副; 支持; 按照; 公开; procurement 获(取)得, 代理(权); professional 职业(性, 上)的, 业务, 专业的, 专业人员, 内行

PROCLK processor clock 处理器时钟

PROG program(me) 程序

PROM programmable read only memory 可编程序只读存储器

PROP propagation 传送

PROT, PRT protection 保护

PS 并行串行; 相位选择; phase shift 相移, 移相; polarity selector 极性选择器; 端口选择; 外接引出比例; power supply 电源; preset 预置, 预先调整; processor status 处理器状态; pulse shaper 脉冲形成器; pulse stretcher 脉冲展宽器, 脉冲加宽器

PSART 可编程同步-异步接收器-发送器

PSB 奇偶选择总线

PSC parallel-to-serial converter 并(行)-串行转换器; phase sensitive converter 相敏转换器

PSD 引导（遥控）同步

PSDFilteV 引导（遥控）同步滤波器

PSE(N) program store enable 编程存入允许； program strobe enable 编程选通允许

PSF power supply filter 电源滤波器

PSG pulse signal generator 脉冲信号发生器

PSI Picture Signal Improvement 图像信号改进（电路）

PSK phase shift keying 相移键控

PSLPF phase-shift low-pass filter 相移低通滤波器； pulse slope modulation 脉冲斜率调制

PSS packet switching service 包交换服务； personal signaling system 个人信号设备系统，个人信号传输系统

PT packet transmission 分组传输，包传输； packet-type (byte) 压缩（式）字节，包型（字节）； pattern transfer 图形传送； point 点，位置； pulse train 脉冲列，脉冲系列； pulse transformer 脉冲变压器

PTC packet transmission channel 可编程定时控制； pulse time code 脉冲时间码

PTL 脉冲收听； 增压（按压）收听； phase tracking loop 相位跟踪环

PTM phase time modulation 相位时间调制； pulse time modulation 脉冲时间调制

PTP point-to-point (control) 点对点（控制） 定点（控制）

PTT 脉冲-通话； 增压（按压）通话

PU pluggable unit 插件功率增大； power unit 电源部件

PUL pull 拉； pulse 脉冲

PUMP 可保护的使用方式端口

PUP 堆栈控制

PVT 可编程视频传送

PW pulse width 脉冲宽度（控制）

PWD pulse-width discriminator 脉宽鉴别器

PWE pulse-width encoder 脉宽编码器

PWL power level 功率电平
PWM pulse width modulation 脉宽调制
PWR 功率（驱动放大），电源
PWR SUP power supply 供电电源
PX private exchange 专用交换器

∴

Q₀, Q₁, Q_n 触发器，寄存器，计数器，锁存器，分频器等电平输出；ECL 输出

Q_n 时钟跳变前触发器状态

Q, q quadded 四线的；**quality** 质量，品质，性质；音色质，色品；参数量；身份，地位；**quantity** 量，数量，大量；值，参数；程度，大小

QA quality assurance 质量保证，质量保险；**quick acting** 快速作用，快速行动；快速动作

QCB 借位输出（计数器等）

QCC 进位输出（计数器等）

QCDD CDD 输出

QCR 行波时钟输出

QDC 级连输出

QEP 奇偶错误输出

QFP Quad Flat Package 方形扁平封装

QH 高电平值

QIO Q 寄存器双向移位输入/输出

QL 左移输出；低电平值

QOPT OPT 输出

QPL qualified product list 合格产品目录

QPSK quadrature phase shift keying 正交相移键控

QR quick response 快速响应；右移输出；最优输出

QS 排列状态，S 功能输出

QSF 数据寄存器空标志

QUAD quadrant 象限

quadruple 四倍的, 四重的

∠

R/D 地址存储器/数据传输

R/C_{EXT} 外接(计时)电阻和电容之间公共接点

R/H 转换/保持(控制)

R/T receive/transmit 接收/发送; register/translator 寄存器/转换器

R/W, RW read/write 读/写(选择)

R, r 基准; ratio 比, 比率; 变换系数; readability 读出能力; reception 接收; recovery 恢复, 收回, 回收; 回缩; register 寄存器; 记录器; relay 继电器; 中继; 无线电接力; repeater 转发器, 中继器, 增音器; res(et) 复位; 转换; 重调; 置“0”, 清零; resistor 电阻器; reverse 倒转; 反向; 反的; right 右(边)的; remote 远程

R_{EXT} 外接电阻

R_{INT} 内接电阻, 积分电阻

R_{VCO} 压控振荡器外接电阻

R₀ 复位(计数器)

R₀R₁ R_n 指令输出

R_C 范围控制

R_F 跳步逻辑控制

R_L 负载电阻

R_T 内接下拉电阻端, 外接电阻, 端接(匹配)电阻, 定时电阻, 温度电阻

R-SW, RS(W) 右开关

RA 行地址; read amplifier 读出放大器; register A 寄存器 A

Rad radian 弧度, 弧角; radical 基本的, 根本的, 根, 根式, 根号, 基, 原子团; radio 无线电, 无线电传送, 无线电通信, 无线电设备, 收音机; radiogram 射线照片, 无线电报, 收音电唱两用机; radius 半径, 范围; radix 根基, 基, 基数, 底

RA, RB (比例)电阻 A, B

RAM random access memory 随机存取存储器

RAMP 锯齿波 (斜波)

RAMRD RAM 读选通

RAMWR RAM 写选通

RAPL 寄存器地址端口选择

RAS 无源; 接收器地址选择; 行地址选通; row address strobe 行地址选通 (存储器)

RATIO ratio 比值

RAX register AX 寄存器 AX

RB read backward 反读, 反向; 读出, 倒读; read buffer 读缓冲器

RBB receive burst buffer 接收脉冲缓冲器

RBI ripple-blanking input 脉动消隐输入; 串行消隐输入 (译码器); 脉动振铃输入

RBIAS register bias 寄存器偏移

RBO 串行消隐输出 (译码器); 脉动振铃输出

RByTLD read byte load 读字节负载

RC range correction 距离校正; 串行时钟; 响应控制; 限度控制; 波段控制; 分类控制; reaction-coupled 反馈耦合的; read and computing 阅读和计算; reader code 阅读器代码, 读出器代码; receiver-base code 接收控制; 寄存器计数 (控制); resistance-capacitance 电阻-电容, 阻容的; return on carry 进位返回; reverse current 反向电流

RC(D) received 被接收的; record 记录录音; 行/列 (驱动器)

RCHO 行振动定时网络

RCv1, RCv0 场振荡定时网络

RC, RC(L)K 锁存时钟, 接收器时钟

RCEN RC 允许

RCLR 寄存器清零

RCM radiocontrolled mine 无线电操纵水雷, 无线电控制的地雷; 无线电控制采掘; radio countermeasure 无线电对抗措施

RCO 脉动 (行波) 进位输出; 脉冲时钟输出

RCR reverse current relay 反向电流继电器

RCTFR rectifier 整流器

RCSS 随机通信系统（接收控制）传感系统（串行扫描，单位位移）

RCV receive 接收，收到

RCVC(L)K receive clock 接收器时钟

RCVR receiver 接收机，收音机，受话器

RCVSYNC 与接收（时钟）同步

RD 置“0”，清零；接收器数据；行驱动；RISC 数据；ratio detector 比例检波器；read 读出；读数，读脉冲，读周期状态；readiness data 准备数据；register driver 寄存器；驱动器；ring down 振铃（方式）

RDACK 接收器 DMA 响应

RDAMP read amplifier 读放大器

RDATA read data 读出数据

RDBL readable 可读的

RDIS receive disable 接收器禁止

RDS Rapid Development System 快速开发系统；relational data system 关系数据系统

RDSR 接收器数据服务请求

RDY ready 就绪，准备好

RE 寄存器允许，零秒规则输入；reset 复位；转换；重调，置0，清零

RE(N) 接收器允许；寄存器允许；Q（输出）允许

RE(N) 接收器允许，远控允许

READ Real-Time Electronic Access and Display System 实时电子存取和显示系统；remote electronic alphanumeric display 远程电子字母数字显示器

REC receive 接收，收到；receiver 接收机；record 记录，录音

REC(D) receiving 接收

RECall 列阵重调用操作

RECT rectifier 整流器；检波器

REF reference 基准；参考；标准；基准色度

REFcomp 比较器；基准

REF_{sc} 选择控制基准端

REFH 基准高电平

REFI(N) 基准输入

REFL reference line 基准线, 参考线; 基准低电平

REFo(ut) 基准输出

REG regeneration 再生, 正反馈; register 寄存器; regulation 调节, 调整, 稳压源

REGFull register full 寄存器满

REGL(OA)D 寄存器负载

REGRD 寄存器读

REL 关系, 联系, 关系式, 关系曲线, 继电器, 中断线, 转播, 释放断路, 分离, 复原

REM remainder 余数, 余项

REMOCON remainder out control 余数输出控制

REPEAT 重复键

REQ request 请求

RES restore 恢复; response 响应; resistance 电阻

RESB rest bus 驻留总线

REST resistor 电阻器; reset 复位, 寄位总请, 接受

R(E)ST reset 停止, 复位

RET 单稳态触发控制

RET(N) return 返回; 反程; 回线, 反馈

REV reverse 倒转; 反向; 反的

RF radio frequency 射频; reference 基准; register finder 寄存选择器; resonant frequency 谐振频率; retransmission frequency 再发频率, 重新发送频率

RFA, RFB... 反馈电阻 A, B...

RFB 寄存器(接受器)反馈

RFD ready for data 准备发送数据

RFG 接受滤波器增益

RFS ready for sending 准备发送，发送就绪 RFSH refresh 恢复

RG 读允许；register 寄存器，记录器；reset gate 复位门

RGB red, green, blue (drive) 红绿蓝（激励）

RGS resistive gate sensor 电阻选通传感器；电阻控制敏感元件

Rgstr register 寄存器

RGZ recommended ground zero 推荐的接地零

RH register high 高位寄存器

RHW right-half word 右半字，右侧字

RI(N) 接收器输入；ring indicator 环形指示器；振铃指示器

RID reset inhibit driver 复位禁止驱动器

RIDC input direct current resistance 直流输入电阻

RIM read-in mode 读入方式；resource interface module 资源接口模块

RIN register IN 输入寄存器

Rin 内部电阻，输入电阻

RINT receive interrupt 接收器中断

RIP 脉动

RISC reduced instruction set computer 精简指令集计算机

RAD radiation dosage 辐射剂量(值)，辐射定量器；random access data 随机存取数据

RL 回路

RLAO 接收超前选择

RLD 寄存器负载

RLE 接收器锁存允许

RLL relocating linking loader 重新定位连接负载程序；run-length-limited code 行程长度受限码

RLSD receive line signal detect 接收线信号检测

RLT remote line testing 远程线路检测；rotate left 左旋

RLY relay 中继

RMS root mean square 均方根（函数信号）

RN(D) 环行双程往返；对 MSP 的舍入进行控制；random number 随机数；

RNDCARC CARC 随机数

RNZ return on no zero 无零值返回

RO read-out 读出; receive-only 只接收; register operation 寄存器操作;
ring oscillator 环形振荡器; ringing oscillator 振铃振荡器; 振铃输出; Rollover
翻转; 接受器输出

ROM read only memory 只读存储器

ROMC ROM 控制

ROUT register out 输出寄存器, 寄存器输出

RP revertive pulsing 反脉冲调制

RP(T) repeat 重发, 转发; 中继; 遮断

RPTR repeater 转发器, 中继器

RQ/GT request/grant 请求/准许

RRDY receiver ready 接收器准备就绪

RS 寄存器选择 (总线); 选通接收; request to sent 请求发送; reset 复
位; 转换; 重调; 置 0, 清零; resistor 电阻器; reset synchronize 重新同步;
reverse signal 反向信号; rotated string 循环字符串

RSET reset 复位

RSI 接收串行输入

RSL 基准电平标度

RSOF 输出接收器 SYNC 或 FLAG

RSOX read serial out extend 读串行输出扩展

RSR reset request 复位请求

RSSI 接受信号强度指示器

RST reset 复位; 转换; 重调; 置 0, 清零

RSUM R 功能加法器

RT 中断; 发送, 转发; reaction time 反应时间; real time 实时;
receiver-transmitter 收发机; reset trigger 复位触发器; resonant transfer 谐振
传送; reverse tracking 反向跟踪

RT/IO(C) real-time input/output (controller) 实时输入输出 (控制器)

RTC 响应时间控制; 上升时间控制; real-time clock 实时时钟; return to

control 返回控制

RTC, RTC(L)K 接收/发送时钟

RTCC 响应时间控制电容；实时时钟计数器

RTD read tape decimal 十进制；读带；round-trip delay 双向延迟，往复延迟

RTDE real-time data channel 实时数据通道

RTI return from interrupt 中断返回

RTJ return jump 回跳，返回转移

RTL real-time language 实时语言；register transfer language 寄存器传送语言，面向系统的高级语言

RTN retain 保持，保留；return 返回，反程，回线

RTS-RTS request-to-send/ready-to-send 请求发送/准备发送

RTU remote terminal unit 远程终端

RTXC, RTXC(L)K 接收/发送时钟

RTZ return-to-zero 归零制

RU reproducing unit 重现部件，重现设备，还原设备，复制设备，仿制设备

RV(ideo) O red video out 红外视频输出

RVDT rotary variable differential transformer 旋转可变差动变压器

RVI reverse interrupt 反向中断

RWC read/write continue 连续读/写

RX receiver 接收器；register-to-indexed storage 寄存器变址存储器；register X 寄存器 X

RXA 接收工作

RXC RXC(L)K 接收器时钟

RXD 接受器数据

RXDA 接收器数据可用

RXDA 通道 A 串行数据输入，接收器数据（可用或 A 端）

RXDACK 接受器 DMA 响应

RXDIS 接受器禁止

RXDRQ 接收器 DMA 请求
RXE(N) 接受器允许
RXINT 接收器中断
RXRDY 接收器准备就绪
RXSA 接收器状态可用
RXSI 接收器串行输入
RY relay 继电器；中继
RYIN 继电器输入
RZ(NP) non-polarized return-to-zero (recording) 非极化归零（记录）
RZ(P) polarized return-to-zero (recording) 极化归零（记录）
RZL return-to-zero level 归零电平
RZM return-to-zero mark 归零标记

✧

3S Tri State 三态输出
S/F 同步/标志
S/L shift/load 移位/负载（控制）；strobe/lock 选通/锁定
S/P serial/parallel 串联/并联（控制）；serial/parallel converter *串并行转换器

S/R Store/Recall Control 存储/取消控制；发送/接收选择
S/U supervisor/user 管理程序/用户
S/W stop-and-wait (protocol) 停止等待（协议）
S&R send and receive 发送和接收
S, R SR 触发器即 SR 双稳态多谐振荡器的输入，S 表示置位，R 表示复位

Sc 磁心磁动器“源”集电极
Se 偶数输入
St 引导传输
StD 延迟引导传送
S-ch, SCH 边链路；S 门；选通通道；store channel 存储器通道
S, s 同步分离；series 系列；级数；连续；串联；串行；选通；置位；

sign 符号, 标记, 标志; LCD 段; source 源; 电源; 信号源; 源 (极); store 存储, 存储器; 存入; 许多

SA 扫描地址; select address 选址; serial access 串行存取

SAB source address bus 源地址总线

SAD 源地址; 串行地址数据

SAI 二级模拟输入

SAM self-addressing memory 自寻址存储器; sequential access memory 按序存取存储器; subsequent address message 顺序地址信息; synchronous amplitude modulation 同步调幅

SARS 逐次逼近寄存状态

SAS 串行地址选通

SAW surface acoustic waves 表面声波

SB 外路地址; 选择字节

signaling bit 发信号位, 信号传输位, 通信位

SBLK SB 链路; stand-by 备用的; synchronization bit 同步位

SBSO 参见 SB, SO

SBY standby 备用的; 备用设备; 等待; 准备

SC select control 选择控制, 采样控制; 对称校正; 系统控制; 短周期控制; 串行控制; session control 预约 (使用终端) 时间控制; (分时系统用) 对话控制; 选通控制

SC(L)K 移位时钟, 串行时钟, 用户时钟, 从时钟

SCC serial communication controller 串行通信控制器; standard chip carrier 标准芯片载体; switching control center 转换控制中心

SCCT SCC 传送 (端)

SCF self-consistent field 独立场

SCI serial communications interface 串联通信接口; serial control in 串行控制输入; System Clock Input 时钟输入

SCL scale 标度, 尺度; 等级; 规模

SCLR serial clear 串联清零

SCPUCNT 选通时钟递增控制 (计数)

SCR silicon-controlled rectifier 可控硅整流器

SCS signal communication system 信号通信系统； simultaneous color system 彩色电视同时（传送）制，同时（传送）制彩色系统； single channel simplex 单路单工； subscriber channel selector 用户信道选择器

SCSI small computer system interface 小型计算机系统接口

SD 关闭（控制）； SD 置“1”直接置位输入； send data 发送数据

SD(B) 系统数据（总线）

SD(B) SCSI 数据（总线）

SDA 串行数据地址（线）

SDBE SDB 允许

SDE serial data controller 串行数据控制器； source data entry 源数据输入

SDH Synchronous Digital Hierachy； 同步数字分级结构

SDIR 用户方向信号（与帧同步）

SDLC synchronous data link control 同步数据链路控制

SDO 抑制二极管输出

SDQ 串行数据输出

SDR sender 发送器，发信机，引向器

SDS 移位定向选择； semiconductor-dielectric-semiconductor 半导体-电介质-半导体； set of distinguishing sequences 特异序列集； systems and data service 系统和数据服务

SE secondary electorn 二次电子

SECAM sequential Colour And Memory system 塞康（顺序一同时）制，顺序传送和储存彩色信号的方式

SEF 错误标志

SEG segment 段，部分

SEI 串行扩展输入

SEL select （信号，模式）选择

SELDRQ 选择 DRQ

SEL select 选择

SEN sense 方向；检测；读出；感应，抽样

SENSE 取样（集成稳压器）；移位寄存器状态控制；single end 单端

SEO 串行扩展输出

SEP separate 分开的，独立的；隔开，切断；separation 分离，分隔；间距（调节）

SEQ sequence 顺序，序列；数列；sequencer 序列发生器，定序器

SER serial 串行的，顺次的

SERNO serial number 串行数，序列号

SF safety 安全，可靠；scaling factor 标定因数，换算系数，比例因数（调节）；源输出放大器；源溢出；源跟踪（随动）器；selective filter 选择滤波器；shift forward 前移；signal frequency 信号频率；standard frequency 标准频率

SFT shifter 移位器

SFTA shifter address 移位器地址

SFTCP shifter clock pulse 移位时钟脉冲

SFTR 参见 SF, TR

SG sawtooth generator 锯齿波发生器；信号；segment 段，部分；signal generator 信号发生器；switched gain 转换增益；symbol generator 符号发生器；synchronous generator 同步发生器

SGA SODA generator of alternations 系统优化与设计算法交替生成程序

SGN(L) signal 信号

SGS 参见 SG, S

SH 行同步；移位控制；shield 屏蔽；substation harmonic 分谐波的

SH, S/H, S&H sample and hold 取样和保持（电路）

SHDN 关闭（控制）（集成稳压器）

SHF super high frequency 超高频

SHFT 参见 SH, FT

SHG second harmonic generator 二次谐波发生器；self-holding gate 自保持栅，自保持门

SHL 移位方向选择

SHLD shield 屏蔽

SHO super high output 超高输出

SHR shift register 移位寄存器

SHtdn 停机关闭; 断路

SI 串行输入; 计数输入; shift-in 移入, 移位输入

SI/PO serial input/parallel output 串行输入/并行输出

SIC systems integration contactor 系统连接接触器, 系统连接开关

SID 串行输入数据

SID/SQD serial input/output data 串联输入输出数据

SIE 串行输入允许

SIF sound intermediate frequency 中音频, 伴音中频; standard interface 标准接口

SIG signal 信号

SNK sink 下沉

SINTR signal interrupt 信号中断

SIO serial input/output 串行输入/输出; standard input/output *标准输入/输出; system input/output 系统输入/输出

SIO 串行 I/O

SIOC serial input/output controller 串行输入/输出控制器

SIPO status indication “processor outage” “处理机停机” 状态指示

SIR symbolic input routine 符号输入程序

SITU situation 状态, 情况, 位置

SK 串行数据时钟, 逻辑控制时钟

SK(I)P 指令跳步输出, 跳动方式指令

SKE seek error 查错

SKIP/Pn 参见 SKIP Pn 存储器最高位 (n) 地址输出端

SL signalling link 信号链路, 信号连接; 左移; 串行负载, 串行加载; 选择; symmetrizing line 对称线

SLAC subscriber line audio processing circuit 用户线路声频信号处理电路

SLC serial link controller 串行线路控制器, 线路群控制器; shift left and

count 左移和计数限幅

SLCT SLCT 传送（端）

SLD 用户线路数据链

SLI suppress length indicator 抑制长度指示器，控制长度指示器；串行左输入

SLIC subscriber line interface circuit 用户线路接口电路

SLPE 斜度（调整）

SLT subscriber terminal 用户终端

SLV 从动负载

SM scanning mode 扫描方式；同步匹配；发动机轴；secondary memory (device) 二级存储器（器件），辅助存储器（器件）；set mode 置方式，规定方式；step (ping) motor 步进电动机；structured memory 结构存储器

SMCS 参见 SM，CS

SMD 标准军用索引；surface montage device 表面贴装器件；存储器组件接口

SMIND 站管理指示

SMP sampler 取样器；signaling management process 信号传输管理处理

SMP service message protocol 服务信息协议

SMREQ （站管理）请求 SM 请求

SMT surface mounting technology 表面贴装技术

SN 相加点；定标网络；电脉冲转换网络

SO send (ing) only 只发送；串行输出；shift-out 移出，移位输出；stationary orbit 静止轨道，同步轨道

SOB(IN)，**SOB(LIN)** self-organizing binary (logical network) 自组织二进制（逻辑网络）

SOBE serial out bus (byte) enable 串行输出总线（字节）允许

SOBFP shift output branch-free path 移位（串行）输出无分支路

SOD 串行输出数据；漏极开路边沿

SOE 串行输出允许

SOI signal operation instruction 信号操作指令

SOIC small-outline (package) integrated circuit 小型（外壳）集成电路

SOP square Pixel 整形像素

SP sequence programmer 次序程序器, 顺序程序编制器; series-parallel 串并行方式选择; shift pulse 移位脉冲; 串行接点; single-phase 单相; single-pole 单极; spare 备用的

SPARC symbolic processing algorithm research computer 符号处理算法研究计算机

SPC shared peripheral controller 共享外围控制器; stored program control 存储程序控制

SPDT single-pole double-throw 单刀双掷

SPG synchronizing (pulse) generator 同步（脉冲）发生器

SPI serial peripheral interface 串联外围接口; 特殊中断; special position identification pulse 特殊位置识别脉冲

SPM scratch-pad memory 高速暂存存储器, 便笺存储器

SPS samples per second 每秒取样数; serial-parallel-serial (structure) 串-并-串行（结构）; 串行电源

SPS, SRPES supplementary power supply 辅助电源

SPST single-pole single-throw 单刀单掷

SQ 信号品质; squitter 间歇; square 矩形; sequence 时序, 连续性, 序列

SR series (relay) 串联（继电器）; 串行; 右移; shift register 移位寄存器; shift reverse 反向移位; slew rate 旋转速率, 转动速率, 变化率; speed regulator 速度调整器

SR/W system read/write 系统读/写

SRAM semiconductor random access memory 半导体随机存取存储器; static random access memory 静态随机存取存储器

Src source （电）源

SRCK 移时时钟

SRD 从动读（选通）

SRI 串行右输入

SRIA, SRIB 移位（串行，计数）输入 A 端，B 端
SRIN 移位（串行计数）输入
SRL shift register latch 移位寄存器锁存电路
SRLLEN SR 锁存允许
SRO single resonant oscillator 单谐振振荡器移位（串行计数）输出
SRQ service request 服务请求； status request 状态请求
SRT set-reset trigg(er) 置位复位触发（器）
SS 软启动； selective signaling 选择性信号传输； 同步分离； 复合同步； 串行数据选择； 状态线
SSB single sideband 单边带
SSF 特殊移位功能
SSG synchronizing signal generation 同步信号产生
SSI sector scan indicator 扇形扫描指示器，区段扫描指示器； 同步串行接口； small scale integration 小规模集成； standard scale integration 标准规模集成； super-scale integration 超大规模集成
SSN Standard Serial Numbers 标准顺次编号，标准连续编号，标准串行编号，光谱时滞（相差偏移网络）
SSNC SSNO 单步控制
SSO S₃SO 三态输出边沿； steady state oscillation 稳态振荡
SSR secure string identification reader 保密字符串识别读出器； stand-by supply relay 备用电源继电器； serial shadow Register 串行影存寄存器
ST 选通； 状态； start 启动，开动
STA store address 存储地址
STAB, ST(A)B stabilization 稳定，稳定化
STB, STR(B) strobe 闸门，选通脉冲
STBY stand-by 备用的，后备的； 备品
STC self-testing circuit 自测试电路； sensitive time control 灵敏度时间控制； set carry 置进位； short time current 短时电流； standard transmission code 标准传输代码
STD standard 标准，标准的

STE 软音色允许

STEN strobe enable 选通允许

STF 堆栈满

STG stage 级, 程度, 阶段; storage 存储器, 存储

STI speech transmission index 语言传输指数

STK WRN/RER 堆栈溢出, 下溢/读错误

STL Schottky transistor logic 肖特基晶体管逻辑

STOR(E) storage 存储 (操作)

STP 停止方式指定; 步进 (步跃) 分级

Str Store 存储, 积聚 (光)

STR strobe 选通

STRT start 启动

STS system test system 系统测试系统

Sub(-) (词头) 次, 低, 亚, 副, 辅助, 局部, 不足, 再, 分

SUB substitute 代用品; 代替, 取代; subtract 减; substrate 衬底; subscriber 用户

SUBST Substantive(ly) 本质 (的), 实在的; Substation 分站, 支局, 变电所, 用户话机; Substitute 代理人, 代用品

SUBSYNC 参见 SUB, SYNC

SUHL Sylvania universal high-level logic; 塞尔瓦尼亚公司的通用高级逻辑 (电路)

SUM summator 加法器, 相加点; sum 总和, 相加

SUMM summarize 相加, 总计

SUP(P) supply 供电源; suppress 抑制

SV set value 给定值, 确定值; 状态溢出; slowed-down video 延迟视频; synchronization vector 同步向量

SVCLK SV 时钟

SVO servo 伺服系统, 伺服机构

SVSW SV 开关

SW short waves 短波; switch 开关

SWALM switch alarm 警报开关
SWAP switch adress path 开关地址通路
SWI sync worthiness indicator 同步适用度指示器
SWP sweep 扫描; swap 交换
SWR 从动写 (选通)
SWT switch 开关, 转换开关; 电键; 转接
SY synchronized 同步的
SYC 系统控制
SYCOM synchronous communications 同步通信
SYLK symbolic link 符号链路
SYN(C) synchronizer 同步装置, 同步器; synchronizing 同步, 整步, 同步的; synchronising signal 同步信号
SYNDET 同步 (数据) 检测
SYS system 系统, 体系, 体制
SYSB 系统总线; 单音色禁止

T

T/H 跟踪/保持
T/C 原码/反码选择, 选中/补码
T/R 发传/接受 (方向控制)
T/RIO 发送/接收输入/输出
T(E)ST 测试 (输入)
T(X)A 发送工作
T(X)BE 发送缓冲器空
T(X)E 发送器, 数据空, 传送允许
T(X)INT 发送中断
T(X)PA 发送通道 A
T(X)RDY 发送准备就绪
T(X)SO 发送串行输出
T(X)U 发送欠载运行
T&DA tracking and data acquisition 跟踪和数据采集

T, t 输入（触发器，锁存器等），发送（输出）；temperature 温度；time 时间，时期，时代；次，回；定时的；tone 音，单音；音调；transmission 传输，传递，发送；传导；透射；trigger 触发器，启动器；触发脉冲；trunk 干线，中继线

TA 振荡电路（回路）；终端地址

TAB 定位凸缘；tape automated bonding 集成电路条带载体自动化引线键合工艺

TAC Telenet access controller 远程网络系统存取控制器；teletext data acquisition and control 电传文本数据采集和控制；terminal access controller 终端存取控制器；time-to-amplitude converter 时间-振幅转换器

TAD 目标地址

TAG transient analysis generator 瞬态分析发生器

Tagp 接头奇偶性

Tagv 接头有效

TAL 终端地址锁存

TALEN TAL 允许

TAOS 全传送单一选择；传送地址 OS

TAS Tfr 地址；test and set 测试和置位；time-addressed signal 时间-地址信号

TBG timebase generator 时基发生器

TBMT transmitter buffer empty 发射机缓冲器空

TC tank circuit 振荡回路；行波计数；temperature compensation 温度补偿；temperature controller 温度控制器；门控制；临界控制；终端计数；timing channel 计时通道；time control 时间控制；tone control；音调控制；transfer control 转移控制；transition count 转移计数；transitional control 转移控制；transport connection 传输连接

TC(AP) 计时电容

TC(L)K 发送时钟

T_{CD} 终端递减计数

T_{CU} 终端递增计数

TCAP 输入俘获

TCBC changeback control 通道返回控制

TCC transfer channel control 传送通道控制

TCD 借位输出

TCG time-code generator 时间码发生器; time-controlled gain 时间控制增益

TCI trunk cut-in 中继线接续

TCK track 径迹, 轨道; 跟踪; tack 定位

TCLD total call clearing delay 总呼叫信道清零延迟

TCM telemetry code modulation 遥测代码调制; terminal-to-computer multiplexer 终端-计算机多路转换器; tone code modulation 音调代码调制

TCMP 输出俘获

TCT 任务完成中断

TCU 进位输出

TCX(O) temperature-compensated crystal (oscillator) 温度补偿晶体 (振荡器)

TD test data 测试数据, 试验数据; time delay 时间延迟, 延时; track data 跟踪数据

TDAMP trans data amplifier 传送数据放大器

TDM time division multiplexing 时分多路转换

TDS track data simulator 跟踪数据模拟器; track data storage 跟踪数据存储

TDT transport data 传输数据

TE(N) 计数允许 (控制); 发送允许

TE, TEN(A) 发送允许; 发送进位允许

TEGAS test generation and simulation system 测试生成和模拟系统

TEMP 温度 (均衡输出, 电压-发生器)

TER 总线终端

TERM terminal 终端, 机场; 端子, 引线, 线柱

TF 发送滤波; transversal filter 横向滤波器; time-frequency 时间频率

TFR transfer 传送, 传输, 转移; transfer restricted signal 传送限制信号

TG transfer gate 转移门, 传送门; trigger 触发器

TH table handling 表处理

Threshold 临界值

TH(RES) 门限, 临界值

THC(TRL) 临界值控制

THDIODE 热散二极管, 闸流二极管

THO(UT) 临界值输出

THOLDC, TSHOICD 门控制, 临界控制

TI tuning indicator 调谐指示器; tuning inductance 调谐电感

TIC 目标识别控制; task interrupt control 任务中断控制; 跟踪启动控制; 调谐电压控制; transfer in channel 通道转换

TID terminal identification 终端识别

TIE terminal interface equipment 终端接口设备; 连接线

TIM time meter 计时器, 测時計

TIO terminal input-output 终端输入输出

TIP terminal interface processor 终端接口处理机; track information processor 轨道信息处理机

TIX 检测系统, 温度指示开关

TK trunk 干线, 中继线

TL test link 测试路线; total load 总负载; transmissiom level 传输电平, 发送电平; transmission line 传输线; trunk load 中继线负载

TLE 变换线允许; 发送电平允许; thin layer electrophoresis 薄层电泳

TLP transmission level point 传输电平点

TLS test line signal 测试线路信号

TM time modulation 时间调制

TME 时间(音调)调制允许

TMN transmission 传输, 传递, 发送; 传导; 透射

TMR timer 计时器, 定时器

TMROS 定时器禁止(输入)

TMS transmission mode selector 传输波型选择器，传输模选择器，传输方式选择器

TMT transmit 发射，发送，传输，传播，播送，传导，透射

TMUX-P type P transmultiplexer P 型电路复用转换器

TMUX-S type S transmultiplexer S 型电路复用转换器

TN tuning unit 调谐器

TND tend 趋势，倾向；tuned 调谐

TNAMP 调谐放大器

TNET trasport network 传输网络

TNO transfer on no overflow 无溢出转移

TO 计时器输出；tandem outlet 串行出口，串行输出；双引出线；音色；发送输出

TOE 三态输出允许

Tog Toggle 触发器

TOI two-operand instruction 二操作数指令

TOL tolerance 公差容差；transverse output level 横向输出电平

TON 音调

TOP 传送并行输出；transistor-outline package 晶体管外壳，晶体管封装

TOS 传送串行输出

TP test point 检查点，检验点；测试点；timing pulse 定时脉冲；true position 真位置；tunable pulsed 可调脉冲

TPt 测试 Pt

TPA tape pulse amplifier 带脉冲放大器；transfer-prohibited acknowledgement signal 禁止传送确认信号

TPD 平均传输延迟时间 (t_{pd})；time pulse distributor 计时脉冲分配器

TPG timing pulse generator 计时脉冲发生器，定时脉冲发生器

TPHL 高电平至低电平传输时间 (t_{pHL})

TPI 计时脉冲输入

TPI truns per inch 每英寸匝数

TPL transfer on plus 正号转移

TPO 计时脉冲输出

TPR top priority line 最高优先线路

TR transfer 转移, 传输, 传递, 传送; transmitter 发送器; transmit-receive 发送-接收

TR(ES) 计时电阻

TRACE tape(controlled) recording and auto; matic checkout equipment 带控制记录和自动校验设备; test equipment for rapid automatic checkout and evaluation 快速自动检验和评价测试设备; Time-shared Routines for Analysis, Classification and Evaluation 分析分类和评价分时程序 (美国 SDC 公司); transmission checking equipment 传输检验设备

TRAN transmit 发射, 发送

TRANS transfer 转移, 传输, 传递; transmission 发射, 发送; transmitter 发送器

TRE timing read error 定时读出错误; transfer error 转移错误, 传输错误

TRFRATE transference rate 传送数率

TRG 传送增益; 触发器; 触发

TRI third 三

TRI(G) 触发器

TRIAC triggera lternating current 触发器交流电流; 三端双向可控硅开关; triode alternating current semiconductor switch 三极管交流半导体开关

TRIL 触发负载

TRIM 输出电压调谐; 调整微调平衡

TRIS 三态

TRMT 差动输出驱动时, 用于驱动收发线的发送对

TRN transfer 转移, 传输, 传递

TRON 跟踪自胜 (输入)

Trp trip 切断, 脉动

TRST 参见 TR, ST

True 选中, 原码

TS 发送, 发送串行; time slot 时隙, 时间间隙; timing selector 定时选

择器；transfer set 传递装置，变换装置；tri-state (longic circuit) 三态（逻辑电路）

TSB three-state buffer 三态缓冲器

TSC 地址通道三态控制端

TSEL 发送模式选择（用选择空闭时传送正相和传送反相之间的电压）

TSEN transfer enable 传送允许

TSF through supergroup filter 通过式超群滤波器

TSG time signal generator 时间信号发生器

TSM time-sharing multiplex 分时多路传输

TSR temporary storage register 暂存寄存器

TSRC signalling routing control 信号路径控制；转速（步进速度）控制

TST test 试验，测试，检验

TSUM transfer summator 传送加法器

TSX 传输通道；transfer and set index 传送并加标记

TTL transistor-transistor logic 晶体管-晶体管逻辑

TTS 数据列堆栈

TUF 发送器下溢

TUN tune 调谐，调频

TV television 电视

TW travelling wave 行波；占空比控制

TWA traveling wave amplifier 行波放大器

TWO traveling wave oscillator 行波振荡器

Twoscomp Two 源补偿

TX transmitter 发送（器）

TX 同 T 发送，传送（TX 与 T 后符号表示传送状态性质功能）

TX, TXt, TXO 发送输出

TXC transmission control 传输控制

TXC(LK) 发送时钟

TXD 发送数据

TXDACK 发送 DMA 响应

TXDRQ transmit data request 发送数据请求

TXI, TXO 增量变址转移, 转送输入或输出

TXND 传输 ND

TxsYm transmit symbol 发送符号

U

U/D 加/减, 递增/递减 (计数控制, 可逆计数允许)

UA 未锁存地址

UART universal asynchronous receive/transmitter 通用异步收发机

UCL upper control limit 控制上限

UD unidirectional 单向的

UDC unidirectional current 单向电流

UDL up data link 上行数字链路

UDS 高位数据选通

UDT unidirectional transducer 单向转换器

UF ultrasonic frequency 超声频率

UFLO underflow 下溢, 底流

UG upward gain 向上增益

UHF ultra high frequency 超高频

UHF ultrahigh frequency 超高频

UL upper limit 上限

ULC universal logic circuit 通用逻辑电路

ULL 可用扫描线长度

ULL usable scanning line-length 可用扫描线长度

UNDFLD 去负载数据流

UNF 综合频率

UNg-c-Seg 闭塞 (截止) c 段

UNITS 用户网络接口终端用于开关

UNIX 贝尔电话实验室的分时操作系统

UNLD, UNLOD unload 去荷, 去负载, 卸载

UNP 无连接脚

UOC 用户输出控制
UP 加计数；单极型
UP/DN 上调节/下调节，递增/递减
UPCK 递增（上调）时钟
UR ultraviolet ray 紫外线
UR 欠量程端；无时钟接收（器）
USART universal synchronous/asynchronous receiver/transmitter 通用同步异步收发机
USB upper sideband 上边带
USYNRT 通用同步接收器/发送器
UV ultraviolet 紫外线的；undervoltage 电压不足，欠压
UVE PROM ultraviolet erasable programbale read only memory 紫外线可擦可编程只读存储器
UVLO upper voltage lock 过压锁止

△

V_{BATT} 备用，电池电源输入
V_{BB} 衬底电源
V_{CC} 正电源（V+）集电极
V_{CCH} 行电源
V_{CCV} 场电源
V_{CCX} 外接 VCC
V_{CM} 外接电容倍压
V_{CONT} 控制电压
V_{CP} 时钟脉冲电压，外接电容倍压
V_{CR} 译码输出
V_{DD} 正电源（V+）（漏极）
V_{ECT} 向量地址允许
V_{EE} 负电源（V-）（发射极）
V_{EXC} 激励电压
V_{FD} 电压反馈

V_{GG} 栅极电源
V_{IN} 输入电压
V_{INT} 中间（基准）电压
V_{IRB} 输入参考电压
V_{LC} LCD 电源电压
V_{LS} 逻辑位移电压
V_{MEN} 备用电源允许
V_{O(OFF)} 截止态输出电压
V_{OFF} 输出逻辑高电平
V_{OL} 输出逻辑低电平
V_{OLT}, ADJ 电压调节端
V_{OS} 失调调节电压补偿电压
V_{PP} 编程电源
V_{REF} 基准电源
V_{SIN} 信号电压输入
V_{TH} 阈值电压
V_{TR} 触发电压
V_B 参考电压
V_E 外偿（平偿）电压
V_f 系统控制
V_I 电压输入
V_L 逻辑电源（输出）锁存电压
V_M 备用电源
V_O 电压输出
V_T 电压变压器
V_Z 齐纳二极管输出（集成稳压器）
V, v variable 可变的，可调的；变量，变数
V 场激励；**voltage** 电压，伏特数
VA 增值；**video-amplifier** 视频放大器
VAC volts alternating current 交流电压

VAF Value Added Function 增值功能

VAL value 值, 数值

VAR Variable 存放地址脉冲; variable 可变的, 可调的; 变量, 变数;

varistor 变阻器

VAX virtual address extension 扩展虚拟地址; Backplane Interconnect VAX
底板互连

VBS variband structure 变带结构

VCA voltage-controlled amplifier 压控放大器

VCC(FF) 中放电源

VCD variable capacitance diode (可)变(电)容二极管; variable center
distance(axial inserter) 可变中心距(轴向插入器)

VCM voice coil motors 声圈电动机(磁盘驱动电机)声圈马达

VCO voltage-controlled oscillator 电压控制振荡器

VCR video cassette recorder 盒式录像机; voltage-controlled resistor 电压
控制电阻

VCSR voltage-controlled shift register 电压控制移位寄存器

VCXO voltage-controlled crystal oscillator 电压控制晶体振荡器, 电压控
制输出

VD voltage divider 分压器; 可变数据

VDC voltage direct current 直流电压

VDF video frequency 视频

VDS vertical display system 垂直显示系统

VEDA 视频增强型 D/A

VF variable frequency 可变频率; 视放; 可变标记; video frequency 视频

VFC video-frequency channel 视频通道; voice-frequency channel 音频通
道; voltage-to-frequency converter 电压-频率转换器

VFD vacuum fluorescent display 真空荧光显示器

VFO variable-frequency oscillator 可变频率振荡器; video-frequency
oscillator 视频振荡器

VFR(O) 模拟输出

VFT voice-frequency telegraphy 音频电报； voice-frequency (carrier-telegraph) terminal 话频（载波电报）终端

VFX 模拟输入

VFXI 独立传送运放的模拟输入

VH 场同步

VHDL VHSIC 超高速集成电路硬件描述语言

VHF very high frequency 甚高频

VHS video home system 家用录像系统

VID video 影像，视频，电视

VIF virtual interface facility 虚拟接口设备

VIGAIN video gain 视频增益

VLSI very large scale integration 超大规模集成电路

VMA valid memory address 有效存储器地址

VME virtual machine environment 虚拟机环境； voice message exchange 声音信息交换（系统）

VMOS vertical metal-oxide-semiconductor 垂直金属-氧化物-半导体；
V-groove metal-oxide-semiconductor V 形槽金属-氧化物-半导体

VMS variable message signing 可变信息符号； velocity-measuring system 速度测量系统； virtual memory system 虚拟存储系统

VO vertical output 场扫描输出，帧扫描输出，垂直输出，视频描出

VOL volume 容积，音量

VPC voltage-to-pulse converter 电压-脉冲转换器

VPRF variable pulse repetition frequency 可变脉冲重复频率

VR voltage regulation 电压调整； voltage relay 电压继电器

Vr 读放参考通道输入

VRAM video random access memory 视频随机存取存储器，电视随机存取存储器

VREF/n n 分之一基准电压

VRPS voltage-regulated power supply 稳压电源

VRT vortical 旋转； virtual 虚拟

VS 场同步；场幅

Vs 电源电压；视频区域（节段）

VSb VME Subsystem Bus VME 子系统总线

VSP EPROM 电源端

VSS 源极电源电压

VT video terminal 视频终端

VTR video tape recorder 录像机

VWL variable work length 可变字长

VWP variable width pulse 可变宽度脉冲

□

W/C wave change 波段转换，信号改变

W/DREQ wait/data request 等待/数据请求

W/R 写/读控制（选择）

W/RD 等待/准备

W/RDYA 等待/就绪 A 端

W/REQ 等待/请求

W, w writing 写（记录，选择）

WAC write address counter 写地址计数器

WACK wait before transmission positive acknowledgement 延迟发送肯定
应答等待响应

WAIT 等待

WB wide band 宽带；write buffer 写缓冲器

WBDL wide-band data link 宽带数据链路

WBNL wide-band noise limiting 宽带噪声限制

WBS 写缓冲器状态

WC word count 字计数（进位）

WCE write check error 写校验错误

WD wiring diagram 配线图，布线图，接线图；写禁止；words of groups
群字

WDATA write data 写数据

WDD 监视器（信号）输出
WDI 监视器（信号）输入
WDS write data strobe 写数据选通
WDTD 监视定时器禁止
WE write enable 写允许，写使能
WFG waveform generator 波形发生器
WG 写允许
WLE write lock error 写入封锁错误
WLI write lock in 写入闭锁
WO write out 写出
WP 写保护
WPB 写/位
WPE 写（预）编程允许
WR(T), WT 写入，写（选择，指令，传送）
WRAP 写 AP
WREQ 等待请求
WRH 写高位
WRL 写闭锁；写低位
WRN 写编号
WRS 写复位
WT/CHK write check 写校验

□

X/CLK 外部时钟
X-Y 乘数，被乘数
X_A, X_a 扩展输出

X cross（例：X-roads=crossroads）；cry-（例：X-tal=crystal）晶体；
exchange 交换（机）；experiment(-al) 实验（用，性）的；extension 伸长，
分机；extra（例：X-hry=extra-heary）；intersect(ion) 交叉；magnifications 放
大倍数（例：100X=100 倍）；trans-（例：XMTR=transmitter）发射机，发
送机

X, x 逻辑任意态; 晶体; 部分门信号和部分选通脉冲信号输出; 相交

XAMP horizontal amplifier 水平放大器

XB 外接基极

XBA external bus address 外部总线地址

XC 外接集电极

XC(H), XCHG exchange 交换, 转换

XC(TT) excitation 激励

XCLV exclusive 排它的, 不相容的, 禁止的

XCOM external communications 外部通信

XD 外接漏极

XDB external data bus 外部数据总线

XDCR transducer 换能器变换器, 传感器

XEM X-exchange memory 寄存器-存储器交换, 交叉存储器交换

XFER transfer 转移, 传输, 传递

XFMR transformer 变压器, 变量器

XFR transfer 传送, 传输, 转移

XI 外部输入扩展输入

XINTR external interrupt 外部中断

XM 方式控制

XM(I)T transmit 传送, 传递, 发射; 传热; 透光

XMIT CLK XMIT 时钟

XMIT SYNC 输入与 XMIT 时钟同步

XNOR exclusive NOR gate “同”门

XO crystal oscillator 晶体振荡器; 外部输出; 扩展输出

XP crosspoint 交叉点, 相交点

XP(D) X 射线保护; X-ray photoelectron (diffraction) X 射线光电子(衍射)

XPLD X 有效负载

XR index register 变址寄存器

XS 外接源极

XT 传送

XT(L), XTAL, XTAL(OSC) crystal 晶体; crystal oscillator 晶体振荡器

XTND extend 扩展, 伸长

XTR 外触发

XUI X User Interface X 用户接口

□

Y_i, Y₀, Y₁ Y_n 门, 译码器, 编码器, 选择器, 显示器等选通脉冲输出

Y_a, Y_b 字形显示输出 (译码器段输出)

Y_{EN} 输出允许

Y_{EX} 扩展输出

Y_{RR} 消隐输出

Y_P P 功能输出

Y_M 方式控制

Y_S 选通输出

Y_{sel} 选择输出

YUV 高质量电视信号标准格式

↗

Z₀ 零控制

Z-S zero-state 零状态

Z, z 高阻态输出; 磁心驱动器输出

Z_A zero adjuster 零位调整器

ZAP zero and add packed decimal 清零及加压缩十进制

Z_B 齐纳旁路

ZC(D) 零记数 (检测)

ZCMD 零电平控制方式

ZCS 高阻态片选

ZD zero detection 零检测

ZDTEN 零数据允许

ZEIN 高阻态允许输入

ZEN 输出允许

ZERO 高阻态允许读出

ZHRD 零状态，高阻态读
ZHWR 零状态，高阻态写
ZINT 高阻态中断
ZLD zero level detector 零电平检测器
ZP zone plate 分区隔板；上拉输出；分区位置；零功率
ZRESET 零状态复位
ZROE 零状态读出允许
ZRWE 零状态读写允许，高阻止写允许
ZS zero suppression 消零，去掉无用的零；选通输出
ZST zone standard time 区域标准时
ZSTEN 选通允许
ZVS zero voltage switching 零压转换零压开关
ZWAIT zero wait 零等待
ZX 输出传送